

목 차

분 기 보 고 서	1
【대표이사 등의 확인】	2
I. 회사의 개요	3
1. 회사의 개요	3
2. 회사의 연혁	3
3. 자본금 변동사항	3
4. 주식의 총수 등	3
5. 정관에 관한 사항	3
II. 사업의 내용	4
1. 사업의 개요	4
2. 주요 제품 및 서비스	4
3. 원재료 및 생산설비	5
4. 매출 및 수주상황	8
5. 위험관리 및 파생거래	9
6. 주요계약 및 연구개발활동	13
7. 기타 참고사항	15
III. 재무에 관한 사항	29
1. 요약재무정보	29
2. 연결재무제표	31
2-1. 연결 재무상태표	31
2-2. 연결 포괄손익계산서	32
2-3. 연결 자본변동표	33
2-4. 연결 현금흐름표	34
3. 연결재무제표 주석	35
1. 회사의 개요 (연결)	35
2. 중요한 회계정책 (연결)	38
3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)	39
4. 영업부문 (연결)	39
5. 금융상품의 범주별 분류 (연결)	40
6. 금융위험관리 (연결)	42
7. 매출채권 및 기타수취채권 (연결)	67
8. 채고자산 (연결)	69
9. 기타유동자산 및 기타비유동자산 (연결)	69
10. 관계기업 및 공동기업투자 (연결)	70
11. 유형자산 (연결)	72
12. 리스 (연결)	73
13. 무형자산 (연결)	74
14. 차입금 (연결)	74
15. 기타유동부채 및 기타비유동부채 (연결)	76
16. 충당부채 (연결)	77
17. 종업원급여 (연결)	78
18. 파생상품거래 (연결)	80
19. 자본금, 자본잉여금, 기타자본 및 기타포괄손익누계액 (연결)	82
20. 이익잉여금 (연결)	84
21. 매출액 (연결)	85

22. 판매비와관리비 (연결).....	86
23. 비용의 성격별 분류 (연결).....	87
24. 금융수익 및 금융비용 (연결).....	88
25. 기타영업외수익과 기타영업외비용 (연결).....	89
26. 법인세비용 (연결).....	89
27. 주당이익 (연결).....	89
28. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래 (연결).....	90
29. 우발부채와 약정사항 (연결).....	97
30. 분기연결현금흐름표 (연결).....	101
31. 주식기준보상 (연결).....	103
32. 보고기간 후 사건 (연결).....	105
4. 재무제표.....	106
4-1. 재무상태표.....	106
4-2. 포괄손익계산서.....	107
4-3. 자본변동표.....	108
4-4. 현금흐름표.....	108
5. 재무제표 주식.....	109
1. 회사의 개요.....	109
2. 중요한 회계정책.....	110
3. 중요한 회계추정 및 가정.....	111
4. 금융상품의 범주별 분류.....	111
5. 금융위험관리.....	113
6. 매출채권 및 기타수취채권.....	137
7. 재고자산.....	139
8. 기타유동자산 및 기타비유동자산.....	139
9. 종속기업, 관계기업 및 공동기업.....	140
10. 유형자산.....	142
11. 리스.....	142
12. 무형자산.....	143
13. 차입금.....	144
14. 기타유동부채 및 기타비유동부채.....	145
15. 충당부채.....	146
16. 종업원급여.....	148
17. 파생상품거래.....	150
18. 자본금, 자본잉여금, 기타자본 및 기타포괄손익누계액.....	151
19. 이익잉여금.....	153
20. 매출액.....	154
21. 판매비와관리비.....	155
22. 비용의 성격별 분류.....	156
23. 금융수익 및 금융비용.....	157
24. 기타영업외수익과 기타영업외비용.....	158
25. 법인세비용.....	158
26. 주당이익.....	159
27. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래.....	160
28. 우발부채와 약정사항.....	170
29. 현금흐름표.....	173
30. 주식기준보상.....	175

6. 배당에 관한 사항	177
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항	178
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적	178
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적	183
8. 기타 재무에 관한 사항	184
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	193
V. 회계감사인의 감사의견 등	194
1. 외부감사에 관한 사항	194
2. 내부통제에 관한 사항	196
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	197
1. 이사회에 관한 사항	197
2. 감사제도에 관한 사항	197
3. 주주총회 등에 관한 사항	197
VII. 주주에 관한 사항	201
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	213
1. 임원 및 직원 등의 현황	213
2. 임원의 보수 등	223
IX. 계열회사 등에 관한 사항	224
X. 대주주 등과의 거래내용	225
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	227
1. 공시내용 진행 및 변경사항	227
2. 우발부채 등에 관한 사항	227
3. 제재 등과 관련된 사항	228
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	228
XII. 상세표	230
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)	230
2. 계열회사 현황(상세)	230
3. 타법인출자 현황(상세)	230
【 전문가의 확인 】	230
1. 전문가의 확인	230
2. 전문가와의 이해관계	230

분기보고서

(제 77 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
 2024년 03월 31일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2024년 5월 16일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

곽 노 정

본 점 소 재 지 :

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) <https://www.skhynix.com>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현

(전 화) 031-8093-4801

【 대표이사 등의 확인 】


확 인 서


우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 내용이 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2024. 05. 16

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 곽 노 정 

공시 책임자 김 우 현 

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

2. 회사의 연혁

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

3. 자본금 변동사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

4. 주식의 총수 등

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

5. 정관에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 4개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다.

당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체이며, 일부 Fab(S1, M10 일부)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다. 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분되고, 메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 기능을 하며, 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 NAND Flash를 주력 생산하고 있습니다.

당사의 생산시설은 국내와 중국에 소재하고 있습니다. 국내에 소재한 Fab은 DRAM을 생산하는 M16, M14, M10(이천)과 NAND를 생산하는 M11, M12, M15(청주) 및 M14(이천)이 있습니다. 이 중 M16은 2021년 2월 준공을 완료한 최신 Fab이며, M14는 DRAM과 NAND를 혼용 생산하고 있습니다. 중국에 소재한 Fab으로는 DRAM을 생산하는 C2, C2F(중국 장쑤성 우시)와 파운드리를 하는 S1이 있습니다. 또한, 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 유포인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체의 인수 1단계 절차를 완료하면서, NAND를 생산하는 중국 다롄에 위치한 Dalian Fab이 있습니다.

당사의 연결 기준 매출액은 2024년 1분기(누계) 12조 4,296억원을 기록하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

[제77기 1분기 누계]
만원)

(단위 : 백

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, CIS 등	산업용 전자기기	SK하이닉스	12,429,598(100%)
합계					12,429,598(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

DRAM ASP는 AI 서버향 제품 판매가 확대되며 2개 분기 연속 상승했으며, 1분기에는 전 분

기 대비 20% 이상 상승하였습니다. NAND 또한 엔터프라이즈 SSD 제품 중심으로 수요가 개선세를 보임에 따라 전 제품의 가격이 회복되며 전 분기 대비 30% 이상 상승하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), Substrate, PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다.

Substrate는 Package를 만들기 위한 원재료 중 하나로 전기 신호를 연결하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 고정 및 연결하여 회로기능을 완성시키는 인쇄회로기판입니다.

그 외 가스 및 화학약품, 소자류 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

가. 주요 원재료 등의 현황

[제77기 1분기 누계]

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	투입액	비율	비고
반도체 부문	원재료	Wafer	Fab	221,234	8%	－
		Substrate	Package	88,893	3%	－
		PCB	Module	59,177	2%	－
		기타	－	1,398,879	49%	－
		소 계		1,768,183	62%	－
	저장품	S/P , 부재료		1,072,822	38%	－
	합 계			2,841,005	100%	－

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 한국, 독일, 미국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의 주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 공급받고 있습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상 점유율을 차지하고 있습니다.

웨이퍼 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. 오랜 침체기를 딛고 반도체 시장의 본격적인 회복세가 전망됨에 따라 웨이퍼 수요가 증가하는 한편, 공급사의 생산 Capa.는 증가하여 수요와 공급의 균형이 유지되고 단가 상승세는 둔화될 것으로 예상됩니다.

당사는 주요 공급업체와 중장기적 협력관계를 통해 원가 경쟁력 강화를 지속해 나갈 것이며, 급격한 수요 상승 등 불확실성을 상시 염두에 두고 시장 상황을 면밀히 모니터링할 것입니다

Substrate의 경우 당사는 한국, 일본, 중국 및 말레이시아에 생산시설을 보유한 8개사로부터 Substrate 완제품을 공급받고 있습니다. 전세계 기준 50여개 이상의 Substrate 공급사가 있으며, 당사와 거래하는 8개사는 품질 및 공급 Capacity 측면에서 당사가 요구하는 수준을 만족하는 공급사들입니다.

Substrate 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. 특히 Substrate는 다품종 제품으로 당사가 생산하는 반도체의 Type, Density 등에 따라 개별적인 Design이 적용되는 Customized 품목입니다. Package의 경박 단소화 추세에 따라, Substrate 제작 난이도 역시 상승하고 있는 추세입니다. Substrate 공급사의 지속적인 품질 개선 및 다변화 활동을 통해 Supply Chain 경쟁력 강화 진행 중에 있으며, 긴장한 협력 관계를 이어 나갈 것입니다.

PCB는 한국 및 중화권(중국, 대만 등) 소재 6개사로부터 공급받고 있습니다. 당사와 거래하고 있는 PCB 공급사는 동산업 내 주요 공급업체이며, 품질과 Capacity 등 당사와 산업내의 다양한 요구 수준을 만족하고 있습니다.

PCB 가격은 최종 반도체 제품의 수급에 영향을 받을 뿐 아니라 원소재 비중이 높은 제품 특성상 주요 원자재의 거래 가격에 영향을 받습니다. 최근 경기 불확실성에 따라 원소재 가격 변동성이 높고, 최신 신제품의 고신뢰성, 고속도, 고용량 요구 추세에 따라 조달 비용에 변동성이 있으나 생산지 다변화와 함께, 제품 설계 최적화, 품질 개선, 재고 조정 등 선제적 활동을 통해 PCB 원가 경쟁력 강화와 품질 안정, 생산 안정성을 동시에 높여나가고 있습니다. 이외에 최근 미-중 무역 분쟁 등 공급 불확실성에 대응하기 위하여 동남아로의 생산 지역 다변화가 진행되고 있습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조 3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2024년 1분기 총 가동일은 91일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동률을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 21,451,248시간입니다.

생산능력은 "해당 연간 최대생산 일의 생산량 x 누적일수 x 평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2024년 1분기 생산능력은 8,461,289백만원입니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	제77기 1분기	제76기	제75기
반도체	8,461,289	34,806,295	33,326,132

2. 생산실적 및 가동률

당사의 2024년 1분기 생산실적은 8,461,289백만원으로 집계되었으며,
동 기간의 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	제77기 1분기	제76기	제75기
반도체	8,461,289	34,806,295	33,326,132

(2) 가동률

(단위 :시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
반도체	64,353,744	64,353,744	100%

※ 가동률은 각 지역별 FAB별 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함

3. 생산설비의 현황

당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 53,163,891백만원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계
2024.01.01								
취득원가	1,207,988	13,018,599	4,245,060	109,027,339	49,107	2,568,873	6,018,787	136,135,753
감가상각누계액	-	(2,638,316)	(1,144,631)	(77,189,690)	(18,062)	(2,014,497)	-	(83,005,196)
손상차손누계액	-	(23,226)	(18,853)	(325,469)	-	(13)	-	(367,561)
정보보조금	-	(15,814)	(1,333)	(40,655)	(1)	(339)	-	(58,142)
기초순장부금액	1,207,988	10,341,242	3,080,243	31,471,525	31,044	554,024	6,018,787	52,704,853
기중변동액								
취득	2	43,795	43,564	522,024	-	20,738	2,313,243	2,943,366
사업결합으로 인한증가	-	-	-	-	-	-	-	-
감액(손상차손)	-	-	-	-	-	-	-	-
처분 및 폐기	-	(24)	-	(3,874)	-	(24)	-	(3,922)
감가상각	-	(125,264)	(55,758)	(2,677,224)	(775)	(65,147)	-	(2,924,168)
대체(*)	85	18,420	13,067	1,332,818	-	(1,991)	(1,396,961)	(34,562)
환율변동 등	2,396	108,203	26,417	361,841	7	4,545	(25,085)	478,324
기말순장부금액	1,210,471	10,386,372	3,107,533	31,007,110	30,276	512,145	6,909,984	53,163,891
2024.03.31								
취득원가	1,210,471	13,214,857	4,321,976	111,709,173	49,145	2,585,764	7,000,155	140,091,541
감가상각누계액	-	(2,789,166)	(1,197,764)	(80,432,399)	(18,868)	(2,073,305)	-	(86,511,502)

손상차손누계액	-	(23,226)	(15,339)	(233,403)	-	(13)	(90,171)	(362,152)
정보보조금	-	(16,093)	(1,340)	(36,261)	(1)	(301)	-	(53,996)
순장부금액	1,210,471	10,386,372	3,107,533	31,007,110	30,276	512,145	6,909,984	53,163,891

4. 투자계획(현황)

2024년 1분기 말 기준 당사의 투자집행 현황은 다음과 같습니다.

[유형자산 취득 기준]

(단위 : 십억원)

구 분	투자대상자산	투자효과	투자 기간	기투자액(누적)	비 고
보완투자 등	기계장치 외	생산능력증가 등	2024.01.01~2024.03.31	2,943	누적실적
합 계				2,943	-

4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항

1. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제77기 1분기	제76기	제75기
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, CIS 등	12,429,598	32,765,719	44,621,568
합 계			12,429,598	32,765,719	44,621,568

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

2. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매 조직

국내에서는 GSM 내 영업 관할 하에 대리점을 운영하고 있습니다. 해외 판매법인은 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등의 국가에 소재하고 있으며 산하에 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매 경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을 통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매 방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.

(4) 판매 전략

당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별

포지셔닝' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 있습니다. 고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다. 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

DRAM의 경우, 세계 유수의 Mobile 및 Computing 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있습니다. NAND Flash는 IT 컨슈머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에 세계적인 모바일 디바이스 및 IT 제품 제조업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

나. 수주상황

당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화, 위안화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	17,063	22,980,954	21,529	28,995,885
JPY	539	4,791	89,449	795,632
CNY	1,741	323,344	3,754	697,219
EUR	25	36,240	41	59,112

또한, 연결회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 주석 18에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	(387,571)	387,571
JPY	(79,084)	79,084
CNY	(37,387)	37,387
EUR	(2,287)	2,287

(2) 이자율위험

연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융자산 등으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결회사는 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의차이를 결제하게 됩니다.

연결회사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 연결회사는 변동금리부 외화차입금 462,963백만원에 대해 통화이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 변동금리부 원화차입금 568,600백만원에 대해 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당분기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.

한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 1년간 연결회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자수익과 이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 24,794백만원(전분기: 28,182백만원) 만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(3) 가격위험

연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

나. 회사의 위험관리 정책

(1) 위험관리의 일반적 전략

[주요 시장위험요소]

당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 당사는 영업 측면에서 매출의 90% 이상이 USD로 발생되어 USD 수입이 지출보다 많은 구조를 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름을 환리스크 관리의 주 대상으로 하고 있습니다.

[위험관리규정]

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 필요시 환노출을 최소화 하도록 관리하고 있습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황

당사는 외환거래 실행을 주관하는 부서에서 환위험을 관리하고 있으며, 관리부서 주요 업무는 다음과 같습니다.

- ① 외환관리정책 / 전략의 확정
- ② 외환관리규정의 제정 및 개정
- ③ 외환 거래 및 관련 업무
- ④ 외환리스크 측정 및 분석 / 보고
- ⑤ 환 Exposure 및 외환리스크 관리방안 수립 / 시행
- ⑥ 국제금융시장 및 환율 동향 Monitoring
- ⑦ 이사회 또는 감사위원회 지시 사항 이행 및 점검

다. 파생상품 거래 현황

(1) 통화스왑 및 이자율 스왑

① 당분기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용한 통화스왑 및 이자율스왑 거래내역은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 백만원, 외화단위: 외화 천단위)					
위험회피대상			위험회피수단		
차입일	대상항목	대상위험	계약종류	체결기관	계약기간
2019.09.17	고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)	환율변동위험	통화스왑계약	국민은행 등 2개은행	2019.09.17 ~ 2024.09.17
2019.10.02	변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 343,750)	환율변동위험 및 이자율위험	통화이자율스왑계약	산업은행	2019.10.02 ~ 2026.10.02
2023.01.17	고정금리외화사채 (액면금액 USD 750,000)	환율변동위험	통화스왑계약	국민은행 등 4개은행	2023.01.17 ~ 2026.01.17
2023.04.04	변동금리시설대출 (액면가액 KRW 100,000)	이자율위험	이자율스왑계약	우리은행	2023.04.04 ~ 2028.04.04
2024.03.07	변동금리시설대출 (액면가액 KRW 468,600)	이자율위험	이자율스왑계약	신한은행	2024.03.07 ~ 2027.10.18

② 연결회사가 보유하고 있는 파생금융상품의 당분기말 공정가치는 연결재무상태표의 기타 금융자산 및 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)			
구분	위험회피대상항목	현금흐름위험회피 회계적용	공정가치
통화스왑	고정금리외화사채 (액면금액 USD 1,250,000)	158,108	158,108
통화이자율스왑	변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 343,750)	72,232	72,232
파생금융자산 합계			230,340
이자율스왑	변동금리시설대출 (액면금액 KRW 568,600)	1,503	1,503
파생금융부채 합계			1,503

당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.

(2) 내재파생상품

연결회사가 보유하고 있는 내재파생상품은 연결채무상태표의 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
파생금융부채	당분기말	전기말
내재파생상품(*)	1,543,398	1,477,619

(*) 연결회사가 2023년 4월 11일 발행한 교환사채에 부여된 교환권 및 콜옵션, 풋옵션입니다(연결채무제표 주석 14 참조).

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요 계약

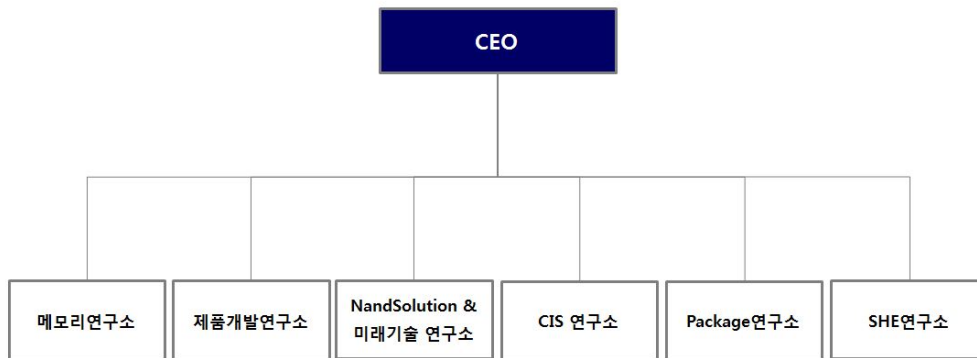
계약 상대방	항목	내용	비고
Rambus Inc.	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	-
	계약 기간	2013년 7월 1일 ~ 2034년 6월 30일	
	목적 및 내용	라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소	
	기타 주요내용	-	
Intel Corporation	계약 유형	영업양수도	-
	계약 체결일	2020년 10월 20일 체결	
	목적 및 내용	Intel의 NAND 사업 영업양수	
	기타 주요내용	계약금액은 US\$90억이며, 2차에 걸쳐 지급될 예정 * 관련 공시 : 2020년 10월 22일 주요사항보고서(영업양수결정)	

※ 최근 5년간의 주요계약 기준

나. 연구개발활동

1. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 제출일 현재, 메모리연구소 및 제품개발연구소, NAND Solution & 미래기술 연구소 등에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.



2. 연구개발비용

(단위:백만원)

과 목		제77기 1분기	제76기	제75기	비 고
연구개발비용	원 재 료 비	25,110	100,174	123,839	-
	인 건 비	361,127	877,633	1,332,187	-
	감 가 상 각 비	138,739	597,198	572,380	-
	위 탁 용 역 비	89,671	307,279	341,454	-
	기 타	494,360	2,306,121	2,535,473	-
	연구개발비용 합계	1,109,007	4,188,404	4,905,334	-
회계처리	연구개발비(비용)	1,028,586	3,837,907	4,576,383	-
	개발비(무형자산)	80,420	350,497	328,951	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		8.9%	12.8%	11.0%	-
매 출 액		12,429,598	32,765,719	44,621,568	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

2024년 중 당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
--------	---------------

HBM DRAM	<p>[HBM3E]</p> <ul style="list-style-type: none"> ·HBM3의 확장버전인 초고성능 AI 메모리로, 세계 최초로 본격 양산하여 고객 납품 시작 – 초당 최대 1.18TB(테라바이트) 이상의 데이터를 처리하며, 이는 FHD(Full-HD)급 영화(5GB) 230편 분량이 넘는 데이터를 1초만에 처리하는 수준임 – 어드밴스드(Advanced) MR-MUF** 공정을 적용해 제품의 열 방출 성능을 이전 세대 대비 10% 향상 <p>(*) HBM(High Bandwidth Memory): 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가가치, 고성능 제품. HBM은 1세대(HBM)–2세대(HBM2)–3세대(HBM2E)–4세대(HBM3)–5세대(HBM3E) 순으로 개발됨. HBM3E는 HBM3의 확장(Extended) 버전</p> <p>(**) MR-MUF: 반도체 칩을 쌓아 올린 뒤 칩과 칩 사이 회로를 보호하기 위해 액체 형태의 보호재를 공간 사이에 주입하고, 굳히는 공정. 칩을 하나씩 쌓을 때마다 필름형 소재를 깔아주는 방식 대비 공정이 효율적이고, 열 방출에도 효과적인 공정으로 평가 받음. 특히, SK하이닉스의 어드밴스드 MR-MUF는 기존 공정보다 칩을 쌓을 때 가해지는 압력을 줄이고, 휨 현상 제어(Warpage control)도 향상해 HBM 공급 생태계 내에서 안정적인 양산성을 확보하는 데 핵심이 되고 있음</p>
PC용 SSD	<p>[PCB01]</p> <ul style="list-style-type: none"> ·온디바이스(On-Device) AI* PC에 탑재되는 PCIe** 5세대 SSD(Solid State Drive) 제품 – 업계 최고 속도가 구현된 제품으로, 연속 읽기속도는 초당 14GB(기가바이트), 연속 쓰기속도는 초당 12GB로 이전 세대 대비 2배 향상 – 이전 세대 대비 전력 효율이 30% 개선되어 대규모 AI 연산 작업 시 효율성을 높이는 데 기여 – SLC*** 캐싱 기술을 적용하여, 낸드의 저장 영역인 셀 일부를 처리속도가 빠른 SLC로 동작하게 해 필요한 데이터만 신속하게 읽고 쓸 수 있게하여 AI 서비스 외 일반 PC 작업 속도 개선에도 도움을 줌 <p>(*) 온디바이스(On-Device) AI: 클라우드 기반 AI 서비스와는 달리, 스마트폰이나 PC와 같은 단말 내에서 바로 AI 연산과 추론을 수행하는 개념</p> <p>(**) PCIe(Peripheral Component Interconnect Express): 디지털 기기의 메인보드에서 사용하는 직렬 구조의 고속 입출력 인터페이스</p> <p>(***) 낸드는 한 개의 셀(Cell)에 몇 bit(비트)의 데이터를 저장하느냐에 따라 SLC(Single Level Cell, 1bit)–MLC(Multi Level Cell, 2bit)–TLC(Triple Level Cell, 3bit) 등으로 규격이 나뉘며, 정보 저장량이 늘어날수록 같은 면적에 더 많은 데이터를 저장할 수 있지만 속도와 안정성은 떨어지며, SLC는 필요한 데이터에 한해 처리 속도를 높여주는 기능을 함</p>

7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신 시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다. 시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2024년 3월 금액기준)에 따르면, 지난 2023년도 세계 반도체 시장규모는 US\$5,300억에 달하며, 이 중 메모리 제품은 전체 반도체 시장의 약 17.3% 수준에 달하는 US\$919억을 기록하였습니다. 메모리 제품 중 DRAM은 전체 메모리 반도체 시장의 54%를 차지하는 US\$499억을 기록하였으며, 그 뒤를 이어 낸드플

래시가 US\$371억으로 40%, 기타 메모리가 US\$49억으로 5%의 비중을 차지하였습니다.

아래 표에 나타난 바와 같이 반도체 산업은 우리나라 2023년 전체 수출의 15.6%를 차지하는 매우 중요한 기간산업 중 하나입니다. 2023년 반도체 수출은 미-중 갈등 및 우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 공급망 불안과 세계 경기 및 개인 소비심리 위축에 따른 IT 제품 수요 급감으로 불황을 겪었습니다.

※ 전체 수출 중 반도체 비중

(단위: 백만 USD, %)

구분	2023	2022	2021	2020	2019
총수출	632,226	683,585	644,400	512,498	542,233
반도체	98,631	129,229	127,980	99,177	93,930
전년비 증감률	-23.7%	1.0%	29.0%	5.6%	-25.9%
비중	15.6%	18.9%	19.9%	19.4%	17.3%

* 출처 : 한국무역협회, 2024년 4월

이러한 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분됩니다.

(가) 메모리 반도체

정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]

DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한, AI 수요가 폭발적으로 증가하면서 프리미엄 DRAM 제품의 채용량이 급증하고 있으며, 글로벌 데이터센터 투자가 지속되면서 Server향 DRAM의 수요도 유지될 것으로 전망하고 있습니다.

[플래시메모리(Flash Memory)]

플래시메모리는 전원이 차단되더라도 저장된 데이터를 유지할 수 있는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이 중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 다양한 종류의 정보를 안정적으로 저장하는 데에 적합합니다.

낸드플래시가 적용되는 분야는 USB드라이브, SSD(Solid State Drive)와 같은 디지털 저장 매체와 차량용 내비게이션, 디지털 카메라 및 스마트폰, 태블릿 PC등의 모바일 기기 그리고 데이터센터 입니다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인

제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품개발 및 고객과의 제품 협업의 중요성이 커지고 있습니다.

(나) 시스템 반도체

시스템 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분류가 되며, 당사는 이 중 CMOS 이미지 센서를 생산하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

계산과 추론 등 정보처리기능을 담당하는 시스템 반도체 중에서도, 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두 가지 타입으로 나뉘며 최근에는 디지털 촬영 기기가 소형화됨에 따라 당사가 사업 영위 중인 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서(CIS)가 시장의 99.9%를 차지하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

반도체 산업은 기술 혁신을 통해 시장의 급격한 변화에 대응하고 있으며 일상생활에 사용되는 전자제품뿐만 아니라 첨단기술의 신산업에서도 중요한 부품으로 사용되어 사용처가 다양한 산업 분야로 확장되고 있습니다. AI, IoT, 자율주행 자동차, 바이오 등 신기술 발달에 힘입어 반도체 시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다.

2019년 메모리 반도체 시장은 글로벌 경기 침체, 스마트폰 판매량 감소, 수요 감소, 공급 과잉 등으로 Downturn에 돌입한 이후 한동안 재고증가, 가격하락 등의 영향으로 전체 반도체 시장의 성장률은 약 -11%, 메모리 반도체는 약 -33%로 하락세를 보였습니다. 2020년은 COVID-19 사태에 따른 글로벌 팬데믹과 미-중 무역 갈등의 격화로 인해 글로벌 금융위기 이후 처음으로 세계 경제 성장률이 마이너스로 전환되며 메모리 시장 환경도 당초 기대 대비 부진했으나, 연말로 갈수록 업계 재고가 정상화되고 수급도 안정을 찾아가기 시작하면서 반도체 시장은 +10.4%, 메모리 시장은 +13.5%의 상승을 기록했습니다. 2021년 반도체 시장은 오미크론 확산으로 인한 글로벌 공급망 불안과 확산세가 여전히 꺾이지 않은 팬데믹 상황 등 불확실한 시장 환경이 지속되었습니다. 이에 따른 2020년의 연장선상에서 Server, PC, 모바일 수요가 크게 증가하여, 반도체 시장은 +25.0%, 메모리 시장은 +33.2%의 성장을 보였습니다. 2022년은 지정학적 위기와 글로벌 공급망 이슈, 글로벌 금리 인상에 따른 경기 침체에 대한 우려로 하반기부터 상황이 악화됨에 따라 반도체 시장은 +1.1% 성장에 그쳤고, 메모리 시장은 -13.7%로 규모가 감소한 모습을 보였습니다. 2023년은 글로벌 공급망 불안과 세계 경제 성장 둔화 등 대내외 불확실성이 지속되어 반도체 수출은 유례없는 불황을 겪었습니다. 2023년 반도체 시장은 업계 메모리 재고가 증가한 상태에서 PC, 모바일 등 IT제품의 수요 감소와 가격 하락으로 인해 반도체 시장은 -11.7%, 메모리 시장은 -35.8%로 역성장 흐름을 보였습니다. (Gartner, 2024년 3월 금액 기준)

[DRAM]

시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2024년 3월 금액기준)에 따르면, DRAM 시장 규모는 2019년 글로벌 경기 침체, CPU 공급 부족으로 인한 수요감소와 가격하락, 중국과 미국 스마트폰 판매량 감소로 인한 모바일향 일시적 공급 과잉 등의 영향으로 \$622억(-37.7%)을 기록하며 큰 폭으로 하락하였습니다. 2020년에는 COVID-19의 확산에 따른 시장의 혼란과 봉

과 등의 영향으로 반도체 산업도 영향을 받았습니다. 중국 내수 부진, 글로벌 시장 불확실성 증대에 따른 신제품 출시 시기 조정 등으로 Mobile 수요가 약화 되었으나, 비대면 경제 활성화, Cloud Service 이용 증가로 PC 및 Server 수요가 Mobile 부진을 상쇄하여 \$659억(+5.9%)를 기록했습니다. 2021년은 COVID-19 회복 및 5G 전환 확대와 고사양 스마트폰 출시, 데이터센터 업체의 투자 재개로 인해 모바일과 Server 수요가 크게 증가하였으며, COVID-19 이후 WFH(Working From Home), 재택교육 등과 같은 근무 환경 및 교육 문화의 변화로 PC 수요도 증가하여 \$929억(+40.9%)를 기록했습니다. 2022년은 중국 Lock-down으로 인한 모바일 수요 감소, Server업체들의 재고 정리로 인한 Server 수요 약세, PC 시장 포화 등 수요 감소로 인해 \$787억(-15.4%)을 기록하며 역성장을 기록했습니다. 2023년은 미-중 갈등, 우크라이나 전쟁에 따른 글로벌 공급망 불안과 세계 경기 및 개인 소비심리 위축으로 업계 메모리 재고가 증가한 상태에서 IT 제품의 수요가 급감하여 AI 수요 급증에 따른 HBM 등 프리미엄 제품 판매 확대에도 불구하고 \$499억(-36.5%)을 기록하며 역성장 기조를 이어갔습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

가트너(Gartner, 2024년 3월 금액기준)의 전망에 따르면, 낸드플래시 시장은 모바일 및 SSD 등 스토리지 분야 적용 확대를 통해 꾸준한 성장을 이어가고 있었으나, 2019년에는 DRAM과 마찬가지로 글로벌 경기 침체, 과잉 공급과 스마트폰 판매 부진으로 NAND 가격이 큰 폭으로 하락하며 -26.4%(\$426억)의 성장률을 보였습니다. 2020년은 Mobile의 수요는 감소했으나, Corporate PC 수요, Cloud 도입 확산에 힘입은 SSD 수요의 강세가 이를 상쇄하여 25.2%(\$534억)의 성장을 기록했습니다. 2021년에는 고용량 스마트폰의 출시로 데이터 저장소 역할을 하는 NAND 콘텐츠 수요가 증가했으며, PC와 게임 콘솔 수요의 증가, 데이터센터 고객들의 투자 확대로 eSSD 수요도 크게 증가 하여 +24.0%(\$659억)의 성장을 기록했습니다. 2022년은 매크로 악화 및 IT 제품 수요 감소로 전 응용 제품의 수요가 약세를 보이며 -12.4%(\$579억)로 역성장했습니다. 2023년은 대내외 불확실성 증대와 전 응용 제품의 수요 약세가 지속되어 -35.9%(\$371억)의 마이너스 성장률을 기록했습니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지센서는 1990년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 PC카메라, 자동차 블랙박스, 휴대폰카메라, 감시카메라뿐 아니라 스마트TV, AR, VR, 자율주행 자동차 등 4차 산업혁명 기술의 핵심 부품으로도 활용되어 시장 규모도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 자율주행 Level 상향에 따라 Automotive 이미지센서 수요가 지속 증가할 것으로 보입니다. 가트너(Gartner, 2024년 3월 금액기준)는 이미지센서 시장이 2023년 US\$188억에서 2028년 US\$290억 규모로 연평균 9.1%의 성장할 것으로 전망하였으며, 특히 당사가 생산 중인 CMOS 이미지센서 시장은 다양한 응용기기로의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지센서 시장에서의 비중이 2023년 98.0%에서 2028년 99.0%으로 확대되며 연평균 9.3% 가량 성장할 것으로 전망하였습니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 반도체 산업은 단기간에 공급량 조절이 어려워 수급 불균형에 의한 가격과 공급 안정성의 변동으로 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 최근에는 AI 활용 분야가 다양해지면서 새로운 기술의 수요가 늘어나고 있으며, 시장이 확대됨에 따라 지정학적 리스크 및 매크로 거시 경제 악화 등 시황 변화에 따른 수요 변동

성이 높아지고 있습니다.

[DRAM]

DRAM은 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 모바일 기기와 를 중심으로 성장하고 있으며데이터센터 자동차 등으로 수요처가 다변화되면서 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다. 한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다. PC는 COVID-19 팬데믹 이후 재택근무, 화상회의 등의 문화가 정착되면서 일시적 수요 급증이 나타나기도 했습니다. Server는 지속적인 투자와 성장으로 글로벌 상황에 따른 소폭의 변동에도 꾸준한 수요를 보여왔으며, 최근 AI시장의 폭발적 성장에 따라 딥러닝 실행과 양질의 데이터를 다룰 수 있는 고성능, 저전력 반도체인 HBM(High Bandwidth Memory)의 수요가 급증하였습니다. AI시대가 본격적으로 개막되면서 새로운 시장이 창출될 것으로 기대됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 과거 MP3플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 또한 최근에는 IT 기기가 스마트화되고 고성능화됨에 따라 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 UFS, SSD 등으로 바뀌었으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 아울러, 이들 eMMC와 SSD 제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, PC, Server, Storage, Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다. 2017년까지 모바일이 가장 높은 점유율을 차지하고 있었으나 모바일 대비 대용량을 요구하는 클라우드 서버의 등장으로 eSSD(enterprise-Solid-State-Drive)가 점유율을 역전하고 NAND 시장의 성장을 견인하는 추세입니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

CIS 시장은 스마트폰과 노트북, 태블릿 분야가 출하량과 매출 모두 70% 이상 높은 비중을 차지하고 있으나, Automotive와 AR/VR 시장이 성장함에 따라 응용처가 확대되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1.기술 및 원가 경쟁력, 2.시장 대응 능력(고객 확보, 제품 포트폴리오), 3.설비투자 능력 등이 있습니다.

최근 대량생산이 용이한 표준 제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화 됨에 따라 시설 투자와 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다.

과거에는 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 핵심 경쟁 요소였지만, 최근에는 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화하였습니다. 따라서, 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합 제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 아울러 DRAM 분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 기술 경쟁력 확보와 New Memory의 원활한 초기시장 진입 및 eMMC나 SSD

제품의 시장확대를 위한 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

이외에도 적기에 시장 요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1분기는 계절적 영향에 따라 PC와 모바일 수요는 약세를 보였지만, 메모리 업황 개선을 이끌고 있는 AI 서버향 제품의 수요 강세는 지속되었습니다. 한편, DRAM, NAND 가격이 큰 폭으로 상승하며 메모리 시장은 완전한 회복세에 접어들었습니다.

가격 상승에 기반하여 당사의 1분기 매출은 지난 분기보다 10%, 전년 동기보다 144% 증가한 12.4조원을 기록했습니다. 매출 증가와 수익성 중심 제품 판매, 지속적인 비용 효율화, 그리고 재고평가손 환입 효과가 더해지며 당사의 1분기 영업이익은 전 분기 대비 2.54조원 증가한 2.89조원, 영업이익률은 23%를 기록했습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제77기 1분기 (2024년 1분기)	제76기 4분기 (2023년 4분기)	전분기 대비 증감	제76기 1분기 (2023년 1분기)	전년 동기 대비 증감
매출액	12,429,598	11,305,504	+10%	5,088,111	+144%
누계실적	12,429,598	32,765,719	-	5,088,111	-
영업이익	2,886,029	346,034	+734%	-3,402,302	흑자전환
누계실적	2,886,029	-7,730,313	-	-3,402,302	-
당기순이익	1,917,039	-1,379,450	흑자전환	-2,585,491	흑자전환
누계실적	1,917,039	-9,137,547	-	-2,585,491	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[제77기 1분기]

(단위: 백만원)

구 분	매출액	매출액 비중 (%)	주 요 제 품
반도체 부문	12,429,598	100.0%	DRAM, NAND Flash, CIS 등
합계	12,429,598	100.0%	-

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자 부품 제조업'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재함.

(2) 시장점유율

구 분	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년
DRAM	29.9%	27.7%	28.3%	28.6%	27.4%
NAND Flash	19.2%	19.0%	13.7%	11.7%	11.0%

※ 출처: IDC 2024년 3월, 매출액 기준

※ 2022년부터 Solidigm 포함

(3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

[DRAM]

PC 메모리는 2020년 이후 증가한 기업/교육용 PC의 Refresh 및 2025년 예정된 Windows 10 OS 기술 지원 종료에 따른 교체 수요로 Commercial PC 중심의 수요 회복이 될 것으로 전망됩니다. 또한, 평균 메모리 탑재량이 높은 울트라북(Ultrabook)과 고사양 게이밍 PC(Gaming PC)가 확고한 제품 지위를 갖고 영역을 넓혀가고 있으며, 성능이 대폭 개선된 ARM CPU를 채용한 PC 시장이 확대되고 있어 지속적인 PC 메모리 수요 증대가 예상됩니다.

AI 시장 확대에 따라 On-demand PC 역할을 위한 신경망처리장치(NPU)를 탑재한 CPU 출시가 보편화되며, 향후에는 AI PC로의 세대 교체와 메모리 수요의 확대가 예상됩니다. 당사는 이러한 시장 변화에 대해 모바일 및 고용량 제품 확대를 통해 적극 대응하고 있습니다.

서버 메모리는 컴퓨팅 서비스 수요 증가에 따라 향후 지속적인 수요 확대가 전망됩니다. 클라우드 컴퓨팅의 도입이 진행되고, 데이터의 양이 증가함에 따라 보다 고용량, 고성능인 서버에 대한 요구가 높아지고 있습니다. Hyperscaler 업체 등의 인터넷 서비스 사업자들은 빅데이터 분석, IoT 애플리케이션 등 클라우드 관련 서비스 수요 증가에 대응하기 위해 데이터센터 확장에 투자하고 있습니다. 또한, VM(Virtual Machine)의 진전이나 SoC 플랫폼의 업그레이드 흐름도 서버당 메모리 Contents 증가에 기여하고 있습니다. 1대의 서버에서 보다 많은 VM이나 Application을 지원할 필요성이나, 대용량의 데이터를 처리할 필요성 때문에, 서버 개당 메모리 증설의 요구가 높아지고 있는 것입니다. 나아가 Digital Transformation과 5G 보급에 따라 중장기 적으로도 견조한 수요가 예상됩니다. 모바일 Device의 확대와 IoT 기기의 증가로 실시간 및 Low Latency 데이터 처리 요구가 높아져 대용량 메모리를 탑재한 고성능 서버의 수요가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 추가로, AI와 ML(Machine Learning) 등을 기반으로 한 고차원 분석 애플리케이션의 성장이 고대역폭 메모리에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

최근 GPT와 같은 대규모 언어 모델(Large Language Models, LLM)에 대한 관심 증가는 서버 메모리 시장의 중요한 성장 요소로 작용할 것으로 예상되며, 이는 다양한 산업 및 Application에서 AI 모델의 Training/Inference 지원을 위해 고용량/성능 메모리 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 최근 GPT의 이용자 수 증가와 함께 많은 조직/기업에서 자연어 처리, 코딩, 콘텐츠 생성, 챗봇 개발 등 다양한 Application을 위해 LLM을 도입하고 있습니다. 미래에는 특정 도메인 및 산업에 맞게 LLM을 세부 조정하는 데 대한 관심이 높아질 것으로 보이며, 이에 따라 추가 Training 데이터와 컴퓨팅 자원을 효율적으로 처리할 수 있는 고성능 메모리 시스템에 대한 Needs가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 더 나아가, LLM이 더욱 복잡하고 정교한 구조로 발전하면서 Text뿐만 아니라 비디오 및 Health Care관련 등 고차원 데이터를 처리하는 멀티모달 AI로 진화하는 미래에는 더욱 강력한 메모리 솔루션에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다.

한편, 인터넷 시대인 Cloud Era에 이어 Data Era 진입으로 Data가 복잡하고 다양해짐에 따라 효율적인 Data Processing을 위해 xPU 기반의 Heterogeneous Computing Architecture 도입에 대한 시장 Needs가 증가하고 있습니다. 이를 위해 CXL이라는 기술이 등장하여 Computing, 가속, 메모리 활용을 극대화할 수 있게 해주고 있으며, 현재 CXL의 Ecosystem이 본격적으로 구축되기 시작하고 있습니다. CXL 메모리는 초기에는 2nd Tier 메모리로 사용되기 시작하여 향후에는 Memory Pooling 방식으로 진화할 것으로 예상되며, 이를 통해 비용효율적인 Solution 보급이 되면서 시장이 급격하게 팽창할 것으로 예상됩니다. 따라서 CXL 2.0을 지원하는 CPU가 출시되는 2025년경부터 시장이 본격적으로 확대되기 시작할 것으로 전망됩니다. 더불어 AI Era의 개화로 서버 DRAM시장은 클라우드 컴퓨팅 등 첨단 기술의 수요가 증가함에 따라 앞으로도 지속 견조하게 성장할 것으로 예상되며, 당사는 이러한 시장의 니즈에 부합하는 고대역폭/고용량 서버 모듈(Module) 제품의 선행 개발과 양산 공급을 통해 시장 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다.

그래픽스 메모리 시장은 고사양/고화질 게임 증가, 4K/8K 미디어 영상 콘텐츠 확산, 3D 그래픽 기술 발전에 따라 상위 스피드를 지원하는 GDDR6를 메인으로 채용 중입니다. 2023년 글로벌 시장 침체로 GPU/GDDR 판매가 저조하였으나, 최근 관심이 높아지고 있는 생성형 AI 산업향으로도 GDDR6를 채용한 GPU가 출시되고, AI PC에 대한 관심도 상승으로 PC GPU 채용률이 향상되며 수요 회복이 전망됩니다. 특히, 금년 하반기부터는 Speed와 Power Efficiency가 향상된 GDDR7의 출시로 그래픽스 메모리 시장의 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

이와 같이 AI를 강화한 신규 GPU, 그래픽카드 시장의 성장과 더불어 하반기에는 콘솔용 게임 기대작들의 출시로 게임 콘솔 시장 또한 견조한 수요가 지속될 것으로 전망됩니다. 당사는 주요 GPU/PC OEM업체 및 게임 콘솔 업체들과의 전략적 협업과 관계 강화를 통해 PC 그래픽스와 게임 콘솔 시장에 대해 적극적으로 대응하고 있습니다.

HBM(High Bandwidth Memory)은 AI / Deep Learning 분야의 Workload 증가로 워크스테이션(Workstation)과 고성능 컴퓨팅(High Performance Computing) 시스템 가속화를 위해 탑재되며, 이와 같은 고사양 Accelerator 수요는 지속 증대될 것으로 전망됩니다.

대표적으로 Generative AI 시장에서 GPT와 같이 연구 단계를 넘어서 산업적 가치를 창출할 수 있는 신기술들이 등장하고 있습니다. Infrastructure 기업 중 Big-3 cloud(AWS, MS Azure, Google Cloud), NVIDIA GPU의 시장 영향력이 커질 것으로 전망되며 장기적으로는 차별화된 Generative AI 서비스를 위해 독자적인 추론용 가속기 적용과 시스템 최적화로 Data Center와 HPC향으로 고성능의 가속기 (GPU/FPGA/ASIC) 수요가 크게 증가할 것입니다.

이에 고성능/고용량 메모리 솔루션인 HBM에 대한 Needs는 더욱 증가할 것으로 예상됨에 따라 당사는 Memory Bandwidth와 Density/Core Die 적층 단수의 상향 등 1등 특성/품질 구현 및 Time to Market을 실현하기 위해 역량을 집중하고 HBM 신기술을 Lead 하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

컨슈머 메모리는 AI & Connectivity 활용 기반의 Home Appliance 발전/확대 기조를 중심으로 Digital TV/Set-top Box/AI Speaker/AR/VR/Game 등 많은 응용에서의 Tech Level Up 전개 진행이 전망됩니다. 또한, Global 경기 침체로 위축하였던 소비 심리가 회복되면서 컨슈머 시장에 긍정적인 바람이 불 것으로 예상합니다. 업계는 현재의 시황에 대응하기 위해 고수익 중심의 프리미엄(고화질/대화면) Segment 확대, Connectivity를 기반으로 한 AI 기능 추가와 기기 편의성 제고를 통하여 고객의 구매를 꾀하고 있습니다.

Digital TV의 Computing Performance 상향 지원과 In-Home Activity (ex. 게임), NFT 거

래 플랫폼 등의 탑재로 확장성을 도모 중이며, 화면 회전, 공간 효율성 제고를 통하여 차별화된 가치 제공으로 편의성을 추구하고 있습니다. OTT/AI Speaker 등은 Home connectivity를 기반으로 Media 시장의 발전/확대를 추구하고 있습니다. Big Tech 기업들이 Metaverse 활용에 필수 접속 기기인 AR/VR의 Reality 고도화를 추진하면서 채용 메모리 Contents 확대가 요구되며 이는 중장기 메모리 수요의 주요 견인 요인으로 작용하고 있습니다. 아울러 Home Security 등 성장 분야로 Big Tech 기업들의 참여와 대중화는 컨슈머 시장 Pie 확장을 이끌고 있습니다. 또한, 차량 내 계기판의 Integrated Digital Cluster화 및 Infotainment System의 고사양화에 따라 고성능 SoC 적용과 함께 메모리의 중요성이 확대되고 있으며, ADAS 적용 가속화와 자율주행 기술/환경 발전은 중장기 고용량/고품질 메모리 시장을 확대 견인할 것으로 예상됩니다.

당사는 범용 제품(DDR3/4)과 저전압/고속 제품(LPDDR4/5)은 물론, Specialty 제품 (Industrial Temp, Automotive grade & HBM) 등 다양한 Portfolio와 Longevity 정책 제시 등 시장에서의 입지를 공고히 하며 사업을 확대해 나가고 있습니다.

모바일 메모리는 Low-power 및 High Bandwidth를 필요로 하는 Mobile Device인 스마트폰 등을 중심으로 채용되고 있습니다. 2023년 스마트폰 Set는 전년에 이어 지속 역성장 하였으나, 잠재적 교체수요에 기반하여 2024년은 다소 성장이 기대되며, Segment 양극화로 Flagship과 Low-end 비중 증가 및 Midrange 감소의 형태로 전개 예상됩니다.

Set 성장은 제한적이지만 온디바이스 AI 스마트폰 출시에 따른 메모리 탑재량 증대로 Contents 상향을 동반한 메모리 TAM 성장은 지속 전망됩니다. 특히 작년말부터 Flagship향 16GB 이상 LPDDR5X/T를 필두로 고용량 제품 채용이 늘어나는 추세이며 Flagship 모델 차별화 및 On device AI 구현 위한 초고용량/초고속 메모리 채용 Needs는 지속 확대될 것으로 전망됩니다. 아울러 중장기적으로 AI 관련 기능이 더 고도화/지능화 요구되며 초연결 AI 사회 핵심 Hub 역할을 하는 Device로 점점 더 고성능 Computing Power가 요구될 것입니다. 당사는 업계 선도 첨단 기술력을 바탕으로 최신 시장 Trend와 고객 Needs에 기반한 다양한 Mobile 제품 Line up을 구축하여 고용량/고성능/저전력 구현을 위한 미래 제품 개발에 최선을 다하고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 기술 산업의 빠른 진화와 함께 성장해왔습니다. 특히 최첨단 IT 기기 및 다양한 생활가전에서의 제품 채용률 및 채용량 증가가 지속되는 추세입니다.

과거에는 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기 스토리지와 노트북, 데스크탑 등 개인/사무용 PC의 저장 매체인 HDD 대체재로서의 SSD 채용이 주요 사용처였습니다. 현재는 스마트폰, 스마트시티와 같은 공간의 IoT 영역화와 COVID-19로 촉발된 디지털노마드 흐름과 함께 폭발적으로 증축된 데이터센터에 채용되는 eSSD가 각광받고 있습니다. 특히 폴더블폰으로 대표되는 플래그십 스마트폰의 차별화 정책과 클라우드 컴퓨팅 강세에 따른 고용량 낸드플래시 채용 증가 등이 성장을 이끌고 있으며, 전기차/자율주행 차량의 확산, 그리고 생성형 AI의 개화 및 온디바이스 AI의 잠재력이 미래 성장 동력으로 주목받고 있습니다. AI 기술은 학습(Training)에서 추론(Inference)으로 진화하고 있으며, 처리 데이터도 텍스트 위주의 정형적 데이터에서 음성, 이미지, 비디오 등 비정형 데이터로 확장되었습니다. 이러한 기술 진화 속에서 용량 증대와 데이터 워밍(warming), 그로 인한 전력 이슈 등에 따른 고객 요구는 SSD의 장점을 더욱 부각시키고 있습니다.

당사는 다양한 인터페이스와 용량의 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용 분야별 선택과 집중을 통해 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장

에서의 위상을 굳건히 하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

CIS는 모바일 폰, 노트북, 태블릿, 디지털 카메라 등 다양한 디지털 기기에서 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2024년부터 2027년까지 연평균 약 4%의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. (출처: Techno-Systems Research 2024. 1H, 출하량 기준)

현재 CIS 화질과 기능이 크게 향상되면서 자동차, 보안, VR/AR, 의료 등으로 응용 범위가 점차 확대되고 있습니다. 수량 및 매출 비중이 가장 큰 모바일의 경우, 전후면에 이미지센서가 장착되고 있으며, 2016년부터는 광학줌 및 포커싱(보케) 등의 카메라 기능 확대를 위해 후면에는 듀얼 카메라가 채용되기 시작했습니다. 2018년 이후에는 초광각, 폴디드줌 등으로 카메라 기능이 더욱 확장되면서 트리플, 쿼드러플 카메라가 상용화되기 시작했으며 이로 인해 기기당 탑재량이 지속 증가하는 추세입니다. 최근 스마트폰 카메라 시장은 멀티 카메라 및 48MP 이상 고화소 채용 증가로 카메라 성능이 어느 때보다도 중요한 마케팅 요소가 되고 있습니다.

당사는 이미지센서 시장 중 가장 많은 비중을 차지하고 있는 모바일 시장과 이와 유사한 성능을 요구하고 있는 노트북 시장에 집중하고 있습니다. 2017년부터 고화소 시장으로 진입하기 위해 300mm 공정을 구축하여 1.0um Pixel을 우수한 성능으로 개발하였고, 2019년 하반기에는 1.0um Pixel 기반의 제품을 고객에 인증 받아 고화소 시장 확대를 위한 발판을 마련하였습니다. 2021년 0.7um Pixel 제품 출시에 이어 2022년에는 0.64um Pixel 제품을 출시하며 미세 Pixel 기반의 다양한 제품 Line up 구축을 통한 경쟁력을 강화하고 있습니다.

향후 점유율 확대를 위하여 시장의 니즈에 맞추어 제품을 개발하는 것 이외에도, 보안 카메라와 바이오 등과 같이 새로운 시장 진입을 통한 애플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

다. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 매출기여도가 높고, 당사 판매 전략에 부합하는 각 응용 분야별 전략 고객 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론, 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

라. 지식재산권 보유현황

2024년 3월 31일 현재 당사는 총 18,429건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록 권리는 해마다 증가하나, 존속기간 만료 또는 기 등록된 권리의 평가를 통해 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동될 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 출원/등록, 사후관리 및 분쟁 대응을 포함한 관련 업무 전반을 담당하고 있습니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호됩니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기간이 연장될 수 있습니다.

마. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

산업 기술의 유출 방지 및 보호에 관한 법률 제11조에 의하여 국가 핵심기술로 지정되거나, 국가첨단 전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법 제12조에 의해 전략기술로 지정된 반도체 제조기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부의 승인을 받거나, 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 제품개발 경쟁력 강화를 위한 해외 생산공장 및 기술센터에 반도체 기술 이전 시 관련 법 및 절차를 준수 이행하고 있습니다.

바. 환경보호 정책 및 현황

(1) SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 ISO45001(안전보건경영시스템), ISO14001(환경경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA MS (안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리 하고 있으며, 이를 위해 SHE경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다. SHE담당 조직에서는 내부심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 안전보건환경 영향요인을 모니터링하고, 국내외 인증규격에 따라 선행적/체계적인 SHE경영 관리를 실시하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인 개선을 추구하며, 환경영향을 최소화하고 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나갈 것입니다.

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

[Net Zero 달성을 위한 노력]

당사는 탄소관리위원회를 중심으로 공정가스 배출량 저감, 에너지 효율 제고 등 온실가스 직·간접 배출량(Scope1,2) 감축 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이와 함께 가치사슬 배출량(Scope3)에 대한 배출량 산정방식을 개선하고 협력사 참여를 강화하고 있습니다. 향후 2050년 Net Zero 달성을 위한 세부 로드맵과 이행 방안을 고도화하여 기후변화 대응을 위한 당사의 노력과 세부 실천 방안을 이해관계자와 투명하게 소통해 나갈 예정입니다.

[RE100(Renewable Energy 100) 선언]

당사는 친환경 에너지 사용 확대를 통해 Net Zero 달성 및 글로벌 기후변화 대응에 적극 기여하고자 합니다. 2020년 RE100 선언을 통해 2050년까지 글로벌 사업장 재생에너지 100% 사용을 약속하였으며, 이를 위한 중간 목표로 2030년 재생에너지 33% 사용을 공표한 바 있습니다. 성공적인 재생에너지 조달을 위해서는 국가별 정책/제도 및 조달 인프라에 대한 심도 있는 이해가 필요하며, 이에 기반한 국가별 맞춤형 전략 수립이 필수적입니다. 이를 위해 당사는 탄소관리위원회를 운영하여 2050 Net Zero 계획 및 정부 에너지 정책과 연계한 중장기 RE100 이행 전략과 재생에너지 조달 방안 등에 대해 면밀히 검토하고 있습니다. 특히, 2024년 2월에는 태양광 직접전력거래계약(PPA, Power Purchase Agreement)을 당사 최초로 체결하는 등 안정적인 재생에너지 조달 기반 확대를 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 재생에너지 생태계 내 다양한 이해관계자와 협업을 확대해 RE100 이행 수단을 점진적으로 다변화하여 재생에너지 전환을 위한 실행력을 지속적으로 높여 나가겠습니다.

※ RE100: 사용하는 전력을 100% 재생에너지(Renewable Energy)로 조달하겠다는 선언

[온실가스 배출권거래제 대응]

온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다.

당사는 '기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되어 2015년부터 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리/감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다

'온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제24조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재내용을 기준으로 2023년 온실가스 예상 배출량은 4,782,107톤 CO₂e (tCO₂e)입니다.

[CDP 탄소경영 최우수기업 명예의 전당 10년차 유지]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초로 명예의 전당에 입성, 2023년 명예의 전당 10년차를 유지하고 있습니다.

[온실가스 배출량 및 에너지 사용량]

당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다.

구분	2023년(제76기)	2022년(제75기)	2021년(제74기)
온실가스 배출량(tCO ₂ eq)	4,782,107	4,979,251	4,388,175
에너지 사용량(TJ)	94,552	98,028	87,063

※ 대상은 국내 사업장 기준이며, 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량입니다.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

(3) 친환경 제품 및 사업장 구축을 위한 노력

[화학물질 전과정 평가를 위한 SHE CHEMs 운영]

당사는 국내외 법규 및 협약을 기반으로 자체규제물질을 설정하고 화학물질 입고 관리 시스템 'SHE CHEMs (SHE Chemical Hazard Evaluation Management system)' 을 운영함으로써 유해화학물질에 대한 사전 검토 및 사후 관리를 지속적으로 진행하고 있습니다. MSDS, 화학물질보증서, LoC 와 같은 문서들을 안전/보건/환경 각 분야의 전문가가 검토를 진행하며, 모든 분야의 검토가 완료된 화학물질만 당사 내에서 사용이 가능합니다. 뿐만 아니라, 당사는 협력사와의 상생협력을 위하여 당사의 화학물질 정책이 담긴 SK hynix RSC(Regulated Substances for Chemical management)를 발간 하였으며, 매년 화학물질 공급사 설명회를 진행하고 있습니다.

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/물발자국/탄소성적/ZWTL인증/순환자원인정]

당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 회사는 2013년 환경부로부터 20나노급 4G DDR3 제품에 대하여 업계 최초 환경성적표지 인증을 획득하였으며, 2014년에는 20나노급 64Gb NAND Flash 제품까지 인증을

확대 하는 등 지속적으로 LCA 평가결과에 대한 제 3자 인증을 확대하고 있습니다. 특히 2016년에는 국내 최초로 20나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 미국 UL社로부터 물발자국 인증을 획득하였습니다. 2017년에는 환경부로부터 당사가 생산하는 10나노급 8Gb LPDDR3 제품에 대하여 업계 최초 물발자국 인증을 획득하였으며, 2019년에는 10나노급 8Gb LPDDR4 DRAM 제품에 대하여, 2021년에는 10나노급 6Gb LPDDR4 DRAM 제품과 3D-V4 NAND Flash 256Gb TLC 제품에 대한 물발자국, 탄소발자국 인증을 획득하였습니다. 2022년에는 eSSD 및 cSSD 제품에 대한 해외 카본트러스트 탄소발자국 인증을 완료하였으며, 2023년에도 10나노급 16Gb DDR5 DRAM 제품과 3D-V7 NAND Flash 512Gb TLC 제품에 대한 탄소발자국 및 물발자국 환경성적표지 인증을 획득하는 등 지속적으로 환경성적표지 인증을 확대하고 있습니다.

또한 기업의 탄소중립을 지원하기 위해 대한상공회의소가 설립한 탄소감축인증센터 감축인증표준 절차에 따라 HBM 제품과 eSSD 제품에 대해 탄소감축성과 크레디트를 인증받아 자발적 탄소감축시장(VCM)에도 선도적으로 대응하고 있습니다.

2018년 국내 기업 최초로 '폐기물 매립 제로화(ZWTL)' 인증을 획득하였으며, 2019년에는 중국 사업장을 포함하여, 전사업장 인증 획득을 완료하였습니다. 2021년 국내 사업장 및 우시 사업장의 경우 '폐기물 매립 제로화(ZWTL)' Gold 등급(재활용률 95% 이상), 충칭 사업장은 Silver 등급(재활용률 90% 이상)을 획득하였습니다. 2022년의 경우, 폐기물 재활용 Item 적용을 통해 국내사업장은 ZWTL 최고 등급인 Platinum 등급(재활용률 100%)을 획득, 2023년에도 Platinum 등급 재인증을 받았으며, 우시 사업장도 2023년 Platinum 등급을 획득하여 선도적인 폐기물 관리 능력을 보유하고 있음을 인정받았습니다.

또한, 정부의 폐기물 정책 패러다임 변화에 맞춰 2019년 '순환자원인정제도'를 대기업 최초로 적용하였으며, 폐기되는 IC-Tray를 자원화하는 선순환 체계를 구축하여 '순환자원인증'을 획득하였습니다. 2023년에는 Wafer, Wafer Carrier, Target 등 총 5종의 순환자원 인증 품목을 추가하였습니다.

회사는 향후에도 지속적으로 친환경 인증을 확대하고, 이해관계자들에게 친환경 정보를 제공할 계획입니다.

(4) 기타 환경보호 정책

2009년 5월, 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여, 당사 환경경영성과에 대한 검증을 진행하여 환경경영검증위원회 보고서를 발행하였습니다. 2010년도부터는 검증위원회를 자문위원회로 변경, 환경경영자문위원회를 개최하고 있으며, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략 관련 의견을 수렴하여 경영활동에 반영하고 있습니다.

2015년에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 당사의 작업환경 및 복지제도 등 보건분야 진단을 통해 127개 개선과제를 도출하고 개선하였습니다. 2017년 11월부터 산업보건검증위원회 주관 하에 각 개선과제에 대한 이행수준을 평가하였고 검증결과보고서를 2018년 8월에 최종 수취 완료하였습니다.

또한 당사는 선도적이고 지속 가능한 산업보건 선진화를 달성하기 위하여 2017년 6월 'SK하이닉스 산업보건 선진화지속위원회'를 발족하였습니다. 현재 선진화의 핵심 가치인 '구

성원의 건강, 안전한 환경, 정의로운 사회를 조화롭고 지속적으로 추구'의 취지에 맞게 건강-환경-정의 분과 별 세부 과제를 추진 중에 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

(단위 :백만원)

구 분	제77기 1분기	제76기	제75기
[유동자산]	33,026,065	30,468,100	28,733,332
• 현금및현금성자산	8,381,395	7,587,329	4,977,007
• 단기금융상품	817,910	472,617	415,625
• 단기투자자산	1,119,597	860,972	1,016,360
• 매출채권	7,178,507	6,600,273	5,186,054
• 재고자산	13,844,639	13,480,659	15,664,707
• 기타	1,684,017	1,466,250	1,473,579
[비유동자산]	70,171,450	69,862,065	75,138,180
• 관계기업 및 공동기업투자	1,433,263	1,367,348	1,352,845
• 장기투자자산	4,018,479	4,105,704	5,733,544
• 유형자산	53,163,891	52,704,853	60,228,528
• 무형자산	3,829,941	3,834,567	3,512,107
• 기타	7,725,876	7,849,593	4,311,156
자산총계	103,197,515	100,330,165	103,871,512
[유동부채]	23,401,233	21,007,810	19,843,696
[비유동부채]	24,288,880	25,818,603	20,737,274
부채총계	47,690,113	46,826,413	40,580,970
[지배기업 소유주지분]	55,510,235	53,504,285	63,266,355
• 자본금	3,657,652	3,657,652	3,657,652
• 자본잉여금	4,405,860	4,372,559	4,336,170
• 기타포괄손익누계액	1,293,592	1,014,055	898,682
• 기타자본항목	(2,238,579)	(2,269,294)	(2,311,409)
• 이익잉여금	48,391,710	46,729,313	56,685,260
[비지배지분]	(2,833)	(533)	24,187
자본총계	55,507,402	53,503,752	63,290,542
매출액	12,429,598	32,765,719	44,621,568
영업이익	2,886,029	(7,730,313)	6,809,417
연결총당기순이익	1,917,039	(9,137,547)	2,241,669
지배기업의 소유주지분	1,919,251	(9,112,428)	2,229,560
비지배지분	(2,212)	(25,119)	12,109

기본주당순이익	2,788원	(13,244원)	3,242 원
연결에 포함된 회사수	59개사	60개사	60개사

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

※ 제77기 1분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2024년 3월 31일 기준이며,

포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2024년 3월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였습니다.

나. 요약 별도재무정보

(단위 :백만원)

구 분	제77기 1분기	제76기	제75기
[유동자산]	18,069,804	17,751,302	17,511,130
· 현금및현금성자산	2,067,890	2,898,074	1,637,350
· 단기금융상품	272,500	272,500	272,500
· 단기투자자산	451,947	331,544	505,532
· 매출채권	3,347,301	3,899,437	3,766,707
· 재고자산	9,311,778	8,769,507	10,345,744
· 기타	2,618,388	1,580,240	983,297
[비유동자산]	76,457,233	75,198,085	74,289,103
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	13,628,272	12,694,398	11,873,138
· 장기투자자산	3,674,761	3,765,853	5,421,102
· 유형자산	39,909,977	38,974,277	43,151,324
· 무형자산	2,922,295	2,928,535	2,897,769
· 기타	16,321,928	16,835,022	10,945,770
자산총계	94,527,037	92,949,387	91,800,233
[유동부채]	15,761,440	16,197,793	14,790,337
[비유동부채]	22,279,514	22,233,272	16,847,074
부채총계	38,040,954	38,431,065	31,637,411
[자본금]	3,657,652	3,657,652	3,657,652
[자본잉여금]	4,417,743	4,389,563	4,375,998
[기타포괄손익누계액]	(2,238,579)	(2,269,294)	27,370
[기타자본항목]	259	5,790	(2,311,408)
[이익잉여금]	50,649,008	48,734,611	54,413,210
자본총계	56,486,083	54,518,322	60,162,822
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	10,401,819	27,639,997	37,878,699
영업이익	2,901,070	(4,672,124)	7,660,947
당기순이익	2,171,332	(4,836,170)	2,790,457
기본주당순이익	3,155원	(7,029원)	4,058 원

※ 한국채택국제회계기준에 따라 별도기준으로 작성되었습니다.

※ 제77기 1분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2024년 3월 31일 기준이며,
포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2024년 3월 31일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 77 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 76 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 77 기 1분기말	제 76 기말
자산		
유동자산	33,026,065	30,468,100
현금및현금성자산 (주5,6)	8,381,395	7,587,329
단기금융상품 (주5,6)	817,910	472,617
단기투자자산 (주5,6)	1,119,597	860,972
매출채권 (주5,6,7,28)	7,178,507	6,600,273
기타수취채권 (주5,6,7,28)	376,546	357,641
기타금융자산 (주5,6,7)	117,511	83,750
재고자산 (주8)	13,844,639	13,480,659
당기법인세자산	62,240	69,916
매각예정자산	29,441	29,441
기타유동자산 (주9)	1,098,279	925,502
비유동자산	70,171,450	69,862,065
관계기업 및 공동기업투자 (주10)	1,433,263	1,367,348
장기투자자산 (주5,6)	4,018,479	4,105,704
기타수취채권 (주5,6,7,28)	438,437	475,013
기타금융자산 (주5,6,18)	118,782	68,217
유형자산 (주11,29)	53,163,891	52,704,853
사용권자산 (주12,28)	2,715,955	2,694,844
무형자산 (주13)	3,829,941	3,834,567
투자부동산	208	211
이연법인세자산	2,953,150	2,989,472
종업원급여자산 (주17)	1,297,056	1,404,014
기타비유동자산 (주9,28,29)	202,288	217,822
자산총계	103,197,515	100,330,165
부채		
유동부채	23,401,233	21,007,810
매입채무 (주5,6,28)	1,747,205	1,845,537

미지급금 (주5,6,20,28)	4,874,619	3,293,308
기타지급채무 (주5,6,28)	1,986,013	1,688,631
차입금 (주5,6,14,29)	8,845,236	9,857,189
기타금융부채 (주5,6,18)	1,544,767	1,478,980
총당부채 (주16)	306,908	286,517
당기법인세부채	355,890	43,890
리스부채 (주5,6,12,28)	638,344	631,497
기타 유동부채 (주15)	3,102,251	1,882,261
비유동부채	24,288,880	25,818,603
장기미지급금 (주5,6)	499,516	3,143,636
기타지급채무 (주5,6)	102,354	96,567
차입금 (주5,6,14,29)	20,660,671	19,611,443
기타금융부채 (주5,6,18)	3,641	3,247
총당부채 (주16)	0	1,603
확정급여부채 (주17)	65,478	63,932
이연법인세부채	126,684	114,396
리스부채 (주5,6,12,28)	2,431,065	2,398,377
기타 비유동 부채 (주15)	399,471	385,402
부채총계	47,690,113	46,826,413
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	55,510,235	53,504,285
자본금 (주19)	3,657,652	3,657,652
자본잉여금 (주19)	4,405,860	4,372,559
기타자본 (주19,31)	(2,238,579)	(2,269,294)
기타포괄손익누계액 (주19)	1,293,592	1,014,055
이익잉여금 (주20)	48,391,710	46,729,313
비지배지분	(2,833)	(533)
자본총계	55,507,402	53,503,752
자본과부채총계	103,197,515	100,330,165

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 77 기 1분기		제 76 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
영업수익 (주4,21,28)	12,429,598	12,429,598	5,088,111	5,088,111
매출원가 (주23,28)	7,634,953	7,634,953	6,733,410	6,733,410
매출총이익(손실)	4,794,645	4,794,645	(1,645,299)	(1,645,299)

판매비와관리비 (주22,23,28)	1,908,616	1,908,616	1,757,003	1,757,003
영업이익(손실)	2,886,029	2,886,029	(3,402,302)	(3,402,302)
금융수익 (주24)	1,117,553	1,117,553	1,073,308	1,073,308
금융비용 (주24)	1,625,139	1,625,139	1,202,394	1,202,394
지분법투자 관련 손익 (주10)	6,161	6,161	2,745	2,745
기타영업외수익 (주25)	27,478	27,478	18,891	18,891
기타영업외비용 (주25)	39,507	39,507	15,431	15,431
법인세비용차감전순이익(손실)	2,372,575	2,372,575	(3,525,183)	(3,525,183)
법인세비용(수익) (주26)	455,536	455,536	(939,692)	(939,692)
분기순이익(손실)	1,917,039	1,917,039	(2,585,491)	(2,585,491)
법인세차감후 기타포괄손익	229,289	229,289	469,509	469,509
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
확정급여제도의재측정요소 (주17)	(50,412)	(50,412)	(4,747)	(4,747)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				
해외사업장환산외환차이	237,074	237,074	437,275	437,275
파생상품평가손익 (주18)	(5,531)	(5,531)	(7,740)	(7,740)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주10)	48,158	48,158	44,721	44,721
분기총포괄이익(손실)	2,146,328	2,146,328	(2,115,982)	(2,115,982)
분기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주지분	1,919,251	1,919,251	(2,580,409)	(2,580,409)
비지배지분	(2,212)	(2,212)	(5,082)	(5,082)
분기총포괄이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주지분	2,148,376	2,148,376	(2,111,177)	(2,111,177)
비지배지분	(2,048)	(2,048)	(4,805)	(4,805)
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 (주27)				
기본주당분기순이익(손실) (단위 : 원)	2,788	2,788	(3,751)	(3,751)
희석주당분기순이익(손실) (단위 : 원)	2,788	2,788	(3,751)	(3,751)

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본						
	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계	
2023.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,336,170	(2,311,409)	898,682	56,685,260	63,266,355	24,187
분기순이익(손실)					(2,580,409)	(2,580,409)	(5,082)
확정급여제도의재측정요소 (주17)					(4,747)	(4,747)	
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주10)				44,721		44,721	
파생상품평가손익 (주18)				(7,740)		(7,740)	
해외사업장환산				436,998		436,998	277
총포괄손익 합계				473,979	(2,585,156)	(2,111,177)	(4,805)
배당금의 지급 (주20)					(206,295)	(206,295)	
주식선택권 부여 (주31)							
주식선택권 행사 (주31)			2,597			2,597	3,939

자기주식처분 (주19,31)		10,463	23,270			33,733		33,733
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 (주19)		10,463	25,867		(206,295)	(169,965)	3,939	(166,026)
2023.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,346,633	(2,285,542)	1,372,661	53,893,809	60,985,213	23,321	61,008,534
2024.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,372,559	(2,269,294)	1,014,055	46,729,313	53,504,285	(533)	53,503,752
분기순이익(손실)					(50,412)	(50,412)		1,917,039
확정급여제도의재측정요소 (주17)				48,158		48,158		(50,412)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주10)				(5,531)		(5,531)		48,158
파생상품평가손익 (주18)				236,910		236,910	164	237,074
해외사업장환산				279,537	1,868,839	2,148,376	(2,048)	2,146,328
총포괄손익 합계								2,146,328
배당금의 지급 (주20)					(206,442)	(206,442)		(206,442)
주식선택권 부여 (주31)			3,564			3,564	188	3,752
주식선택권 행사 (주31)		5,121				5,121	(440)	4,681
자기주식처분 (주19,31)		28,180	27,151			55,331		55,331
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계 (주19)		33,301	30,715		(206,442)	(142,426)	(252)	(142,678)
2024.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,405,860	(2,238,579)	1,293,592	48,391,710	55,510,235	(2,833)	55,507,402

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 77 기 1분기	제 76 기 1분기
영업활동현금흐름	5,356,478	(2,005,488)
영업에서 창출된 현금흐름 (주30)	5,748,660	(1,335,492)
이자의 수취	74,062	44,912
이자의 지급	(416,279)	(214,216)
배당금의 수취	5,060	1,591
법인세의 납부	(55,025)	(502,283)
투자활동현금흐름	(3,797,325)	(3,127,223)
단기금융상품의 감소	192,548	324,851
단기금융상품의 증가	(531,467)	(308,946)
단기투자자산의 순증감	(229,965)	202,126
기타수취채권의 감소	11,729	23,987
기타수취채권의 증가	(28,271)	(20,137)
장기투자자산의 처분	1,756	201
장기투자자산의 취득	(1,484)	(25,418)
유형자산의 처분	8,597	5,501
유형자산의 취득	(3,102,847)	(3,152,150)
무형자산의 처분	214	272
무형자산의 취득	(105,895)	(164,783)
관계기업투자의 처분	1,100	116
관계기업투자의 취득	(13,340)	(12,843)
재무활동현금흐름	(909,670)	4,981,376

차입금의 차입	4,068,545	8,346,550
차입금의 상환	(4,849,086)	(3,288,195)
리스부채의 상환	(160,769)	(80,020)
자기주식의 처분	31,640	3,041
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	144,583	69,110
현금및현금성자산의 증가(감소)	794,066	(82,225)
기초현금및현금성자산	7,587,329	4,977,007
분기말 현금및현금성자산	8,381,395	4,894,782

3. 연결재무제표 주석

1. 회사의 개요 (연결)

(1) 지배기업의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "지배기업")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 경기도 이천시 부발읍 경춘대로 2091에 본사와경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있습니다. 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결회사")은 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing), 다롄(Dalian)에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

2024년 3월 31일 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK스퀘어	146,100,000	20.07
기타주주	542,514,914	74.52
자기주식	39,387,451	5.41
합 계	728,002,365	100.00

당분기말 현재 지배기업의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 록셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	주요영업활동	결산월	소유지분율(%)	
				당분기말	전기말
에스케이하이엔지㈜	국 내	건설공사 및 서비스	12월	100	100
에스케이하이시스템㈜	국 내	사업지원 및 서비스	12월	100	100
행복나래㈜	국 내	산업자재 유통	12월	100	100
행복모아㈜	국 내	반도체 의류 제조, 제빵 및 서비스	12월	100	100
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	국 내	반도체 연구개발 및 서비스	12월	100	100
SK hynix America Inc.	미 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Deutschland GmbH	독 일	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Asia Pte.Ltd.	싱가포르	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	홍 콩	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Japan Inc.	일 본	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix U.K. Ltd.	영 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(※1)	인 도	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(※2)	중 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	중 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	대 만	반도체 판매	12월	100	100

SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	중 국	반도체 제조	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(※3)	중 국	반도체 제조	12월	100	100
SK APTECH Ltd.	홍 콩	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.	홍 콩	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix Italy S.r.l(※2)	이탈리아	반도체 연구개발	12월	100	100
SK hynix memory solutions America Inc.(※4), (※5)	미 국	반도체 연구개발	12월	99.17	99.27
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.	대 만	반도체 연구개발	12월	100	100
SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.(※6)	벨라루스	반도체 연구개발	12월	-	100
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.(※7)	중 국	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.(※8)	중 국	해외병원자산법인	12월	100	100
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.(※8)	중 국	해외병원운영법인	12월	70	70
SK hynix cleaning (Wuxi) Ltd.(※8)	중 국	기업 건물 관리 등	12월	100	100
SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.(※9)	중 국	반도체 제조 및 판매	12월	100	100
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.(※10)	중 국	해외 산업자재유통	12월	100	100
CHONGQING HAPPYNARAE Co. Ltd.(※11)	중 국	해외 산업자재유통	12월	100	100
SK hynix (Wuxi) Education Technology Co.,Ltd(※8)	중 국	교육법인	12월	100	100
SkyHigh Memory Limited(※9)	홍 콩	반도체 제조 및 판매	12월	60	60
Gauss Labs Inc.	미 국	정보통신업	12월	98.32	98.32
SkyHigh Memory China Limited(※12)	중 국	반도체 판매	12월	60	60
SkyHigh Memory Limited Japan(※12)	일 본	반도체 판매	12월	60	60
HappyNarae America LLC(※10)	미 국	해외 산업자재유통	12월	100	100
HappyNarae Hungary Kft(※10)	헝가리	해외 산업자재유통	12월	100	100
SK Hynix (Wuxi) Education Service Development Co., Ltd.(※13)	중 국	교육법인	12월	100	100
SK hynix NAND Product Solutions Corp.(※5)	미 국	반도체 판매 및 연구개발 등	12월	99.17	99.27
SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd.(※4), (※5)	대 만	반도체 연구개발 및 판매	12월	99.17	99.27
SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd.(※4), (※5)	캐나다	반도체 연구개발	12월	99.17	99.27
SK hynix NAND Product Solutions Mexico, S. DE R.L. DE C.V.(※4), (※5)	멕시코	반도체 연구개발	12월	99.17	99.27
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.	중 국	반도체 제조	12월	100	100
SK hynix NAND Product Solutions UK Limited(※4), (※5)	영 국	반도체 판매	12월	99.17	99.27
SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd.(※4), (※5)	이스라엘	반도체 판매	12월	99.17	99.27
SK hynix NAND Product Solutions Japan G.K.(※4), (※5)	일 본	반도체 판매	12월	99.17	99.27
SK hynix NAND Product Solutions International LLC(※4), (※5)	미 국	반도체 판매	12월	99.17	99.27
SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC(※4), (※5)	미 국	반도체 판매	12월	99.17	99.27
SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd.(※4), (※5)	싱가포르	반도체 판매	12월	99.17	99.27
SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd.(※4), (※5)	말레이시아	반도체 판매	12월	99.17	99.27
SK HYNIX NAND PRODUCT SOLUTIONS POLAND sp.	폴란드	반도체 연구개발	12월	99.17	99.27

z o.o.(*)4), (*)5)					
SK hynix NAND Product Solutions (Beijing) Co., Ltd.(*)4), (*)5)	중 국	반도체 판매	12월	99.17	99.27
SK Hynix NAND Product Solutions (Shanghai) Co., Ltd.(*)4), (*)5)	중 국	반도체 연구개발	12월	99.17	99.27
에스케이이파운드리㈜(*)14)	한 국	반도체 판매 및 생산 등	12월	100	100
SK KEYFOUNDRY, INC.(*)15)	미 국	반도체 판매	12월	100	100
SK Keyfoundry Shanghai Co.,Ltd.(*)15)	중 국	반도체 판매	12월	100	100
KEY FOUNDRY LTD.(*)2), (*)15)	대 만	반도체 판매	12월	100	100
Intel NDTM US LLC(*)16)	미 국	반도체 연구개발	12월	-	-
Intel Semiconductor Storage Technology (Dalian) Ltd.(*)16)	중 국	반도체 생산 지원	12월	-	-
SK hynix America Investment Corporation(*)17)	미 국	해외투자자문	12월	100	100
MMT 특정금전신탁	국 내	특정금전신탁	12월	100	100

(*)1) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.의 종속기업입니다.

(*)2) 당분기 중 청산절차가 진행중입니다.

(*)3) 종속기업인 SK APTECH Ltd.의 종속기업입니다.

(*)4) 종속기업인 SK hynix NAND Product Solutions Corp.의 종속기업입니다.

(*)5) 당분기 중 SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 그 종속기업의 종업원에게 주식선택권을 지급하면서 지분율이 하락하였습니다.

(*)6) 당분기 중 법인 청산되어 연결대상에서 제외되었습니다.

(*)7) 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.의 종속기업입니다.

(*)8) 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.의 종속기업입니다.

(*)9) 종속기업인 에스케이하이닉스시스템아이씨㈜의 종속기업입니다.

(*)10) 종속기업인 행복나래㈜의 종속기업입니다.

(*)11) 종속기업인 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.의 종속기업입니다.

(*)12) 종속기업인 SkyHigh Memory Limited의 종속기업입니다.

(*)13) 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Education Technology Co.,Ltd.의 종속기업입니다.

(*)14) 당분기 중 ㈜키파운드리에서 에스케이이파운드리㈜로 사명을 변경하였습니다.

(*)15) 종속기업인 에스케이이파운드리㈜의 종속기업입니다.

(*)16) 당분기말 현재 법적소유권은 인텔에게 있으며 2025년으로 예상되는 인텔 NAND사업부문 인수 2차 종결을 통하여 소유권을 획득할 예정이나 당분기말 현재 지배기업이 지배력을 보유하고 있다고 판단하여 종속기업으로 편입하였습니다.

(*)17) 종속기업인 SK hynix America Inc.의 종속기업입니다.

(3) 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

구분	기업명	사유
종속기업 제외	SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.	청산

(4) 당분기말과 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기말			전기말		
	총자산	총부채	총자본	총자산	총부채	총자본
SK hynix America Inc.	3,839,448	3,097,315	742,133	4,268,773	3,548,414	720,359
SK hynix Asia Pte. Ltd.	483,851	360,149	123,702	232,316	117,859	114,457
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	482,391	286,185	196,206	535,915	350,981	184,934
SK hynix U.K. Ltd.	413,902	380,175	33,727	318,925	288,679	30,246
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	476,293	453,356	22,937	332,031	308,755	23,276
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	1,924,129	1,304,377	619,752	1,310,004	738,331	571,673
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	10,370,13	4,247,534	6,122,598	10,149,06	4,199,507	5,949,560

	2			7		
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	1,160,548	211,711	948,837	1,087,471	186,774	900,697
SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 종속회사	13,527,009	14,487,894	(960,885)	12,948,490	13,714,039	(765,549)

(5) 당분기와 전분기 중 주요 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
종속기업명	당분기		전분기	
	매출액	분기순손익	매출액	분기순손익
SK hynix America Inc.	4,530,912	(8,476)	1,693,910	(201,990)
SK hynix Asia Pte. Ltd.	492,287	4,117	201,996	(1,908)
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	595,499	3,341	224,739	(2,148)
SK hynix U.K. Ltd.	280,639	2,106	105,340	776
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	573,894	(424)	408,759	(555)
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	3,384,045	32,349	1,210,628	(148,882)
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	1,327,921	23,687	1,326,003	17,927
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	278,837	23,533	268,229	36,996
SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 종속회사	1,850,268	(149,566)	692,582	(855,976)

(6) 당분기말과 전기말 현재 연결회사에 대한 중요한 비지배지분은 없습니다.

2. 중요한 회계정책 (연결)

2.1 분기연결재무제표 작성기준

연결회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2024년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 연결회사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필

요가 없다는 경과규정에 따라 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채
판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 제정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 와 기업회계기준서 제1101호 '한

국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

2.2 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제·개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정 평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

연결회사는 글로벌최저한세(필라2) 적용대상입니다. 필라2 법률의 시행규칙이 2024년 3월 22일부로 시행되어 필라2 관련 법령이 온전히 법제화됨에 따라, 연결회사는 동 법령에 기반하여 글로벌최저한세를 산출하고, 법인세비용을 계산 및 반영할 예정입니다. 보다 전문적이고 구체적인 분석과 법인세비용 계산을 위해 연결회사의 각 기업은 외부 세무전문가와 계약을 체결하여 검토를 진행하고 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 영업부문 (연결)

각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 기술

연결회사는 반도체 제품의 제조 및 판매의 단일영업부문으로 구성되어 있습니다. 연결회사의 최고 영업의사결정권자는 영업전략을 수립하는 과정에서 검토되는 보고정보에 반도체사업부문의 성과를 검토하고 있습니다.

지역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	지역					지역 합계
	국내	외국				
		중국	아시아(중국 제외)	미국	유럽	
금융상품, 이연법인 세자산, 퇴직급여자 산 및 보험계약에서 발생하는 권리의 취 득액을 제외한 비유 동자산	46,727,225	13,915,853	21,375	540,936	3,950	61,209,339

전기말

(단위 : 백만원)

	지역					지역 합계
	국내	외국				
		중국	아시아(중국 제외)	미국	유럽	
금융상품, 이연법인 세 자산, 퇴직급여자 산 및 보험계약에서 발생하는 권리의 취 득액을 제외한 비유 동 자산	45,919,915	14,392,758	22,328	513,861	7,449	60,856,311

주요 고객에 대한 정보

당분기 및 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결회사 전체 매출액의 10%를 상회하는 고객은 없습니다.

5. 금융상품의 범주별 분류 (연결)

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가 치 측정 금융자산:	상각후원가로 측정하 는 금융자산	기타	금융자산, 범주 합계
현금및현금성자산	0	0	8,381,395	0	8,381,395
단기금융상품	222,500	0	595,410	0	817,910
단기투자자산	1,119,597	0	0	0	1,119,597
매출채권	0	644,991	6,533,516	0	7,178,507

기타수취채권	0	0	814,983	0	814,983
기타금융자산	0	0	5,618	230,675	236,293
장기투자자산	4,018,479	0	0	0	4,018,479
금융자산 합계	5,360,576	644,991	16,330,922	230,675	22,567,164

전기말

(단위 : 백만원)

	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가 치 측정 금융자산:	상각후원가로 측정하 는 금융자산	기타	금융자산, 범주 합계
현금및현금성자산	0	0	7,587,329	0	7,587,329
단기금융상품	222,500	0	250,117	0	472,617
단기투자자산	860,972	0	0	0	860,972
매출채권	0	470,808	6,129,465	0	6,600,273
기타수취채권	0	0	832,654	0	832,654
기타금융자산	0	0	5,389	146,578	151,967
장기투자자산	4,105,704	0	0	0	4,105,704
금융자산 합계	5,189,176	470,808	14,804,954	146,578	20,611,516

매출채권 양도와 인식에 대한 설명

연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 연결재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	당기손익인식금융 부채	상각후원가로 측정 하는 금융부채	기타	금융부채 합계
매입채무	0	1,747,205	0	1,747,205
미지급금	0	5,374,135	0	5,374,135
기타지급채무	0	1,200,431	0	1,200,431
차입금	0	29,505,907	0	29,505,907
리스부채	0	3,069,409	0	3,069,409
기타금융부채	1,543,398	3,171	1,839	1,548,408
금융부채 합계	1,543,398	40,900,258	1,839	42,445,495

전기말

(단위 : 백만원)

	당기손익인식금융 부채	상각후원가로 측정 하는 금융부채	기타	금융부채 합계
매입채무	0	1,845,537	0	1,845,537
미지급금	0	6,436,944	0	6,436,944
기타지급채무	0	1,192,988	0	1,192,988
차입금	0	29,468,632	0	29,468,632
리스부채	0	3,029,874	0	3,029,874
기타금융부채	1,477,619	3,210	1,398	1,482,227

금융부채 합계	1,477,619	41,977,185	1,398	43,456,202
---------	-----------	------------	-------	------------

기타지급채무에 대한 설명

기타지급채무 중 종업원급여제도에 따른 연결회사의 의무에 대응하는 미지급급여 부채는 금융상품 공시 대상이 아니므로 제외되었습니다.

6. 금융위험관리 (연결)

기능통화 외 환율 변동 위험에 노출되어 있는 금융자산 및 부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	위험					위험 합계
	시장위험					
	환위험					
	기능통화 또는 표시통화				기능통화 또는 표시 통화 합계	
	USD	JPY	CNY	EUR		
현지통화, 자산	USD 17,063,000,000	JPY 539,000,000	CNY 1,741,000,000	EUR 25,000,000		
원화환산, 자산	22,980,954	4,791	323,344	36,240		
현지통화, 부채	USD 21,529,000,000	JPY 89,449,000,000	CNY 3,754,000,000	EUR 41,000,000		
원화환산, 부채	28,995,885	795,632	697,219	59,112		
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술					또한, 연결회사는 외 회사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 주석 18에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통 화이자스왑계약을 체결하고 있습니다.	연결회사는 여러 활 동으로 인하여 시장 위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격 위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간연결채무제표는 연차연결채무제표에 서 요구되는 모든 재 무위험관리와 공시사 항을 포함하지 않으 므로 2023년 12월 31일의 연차연결채무 제표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사 의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에 는 전기말 이후 중요 한 변동사항이 없습 니다.

위험에 대한 노출 정도에 대한 기술					연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화, 위안화 및 엔화와 관련된 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.	
---------------------	--	--	--	--	--	--

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시, 환위험

(단위 : 백만원)

위험										
시장위험										
환위험										
범위										
상위범위	기능통화 또는 표시통화					하위범위	기능통화 또는 표시통화			
	USD	JPY	CNY	EUR	화 합계	USD	JPY	CNY	EUR	화 합계
시장변수 상승 시 법인세차감전손익 감소	(387,571)	(79,084)	(37,387)	(2,287)						
시장변수 하락 시 법인세차감전손익 증가						387,571	79,084	37,387	2,287	
환율변동					0.10					(0.10)

금융상품의 이자율 유형별 공시

(단위 : 백만원)

위험			
시장위험			
이자율 유형			
변동이자율			
금융상품			
차입금			
위험회피수단			위험회피수단 합계
	통화이자율스왑계약	이자율스왑 계약	
금융부채	462,963	568,600	

<p>위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술</p>			<p>연결회사는 현금흐름 이 자율위험을 변동이자수 취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습 니다. 이러한 이자율 스 왑은 변동이자부 차입금 을 고정이자부 차입금으 로 바꾸는 경제적 효과 가 있습니다. 일반적으 로, 연결회사는 변동이 자율로 차입금을 발생시 킨 후 고정이자율로 스 왑을 하게 됩니다. 스왑 계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정기간 (주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고 정이자와 변동이자의차 이를 결제하게 됩니다.</p> <p>연결회사는 당분기말 현 재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위 험에 일부 노출되어 있 습니다. 연결회사는 변 동금리부 외화차입금 462,963백만원에 대해 통화이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 변동 금리부 원화차입금 568,600백만원에 대해 이자율스왑계약을 체결 하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해 당 차입금에 대한 이자 비용 변동으로 인한 당 분기 법인세비용차감전 순이익은 변동하지 않습 니다.</p>
-------------------------------------	--	--	--

<p>위험에 대한 노출정도에 대한 기술</p>			<p>연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융자산 등으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.</p> <p>한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승 시 향후 1년간 연결회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자수익과 이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 24,794백만원(전분기: 28,182백만원) 만큼 증가 또는 감소할 것입니다.</p>
---------------------------	--	--	---

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시, 이자율위험

당분기

(단위 : 백만원)

	위험	
	이자율위험	
	범위	
	상위범위	하위범위
시장변수 상승 시 법인세차감전 손익 감소	(24,794)	
시장변수 하락 시 법인세차감전 손익 증가		24,794
이자율 변동	0.01	(0.01)

	위험	
	이자율위험	
	범위	
	상위범위	하위범위
시장변수 상승 시 법인세차감전 손익 감소	(28,182)	
시장변수 하락 시 법인세차감전 손익 증가		28,182
이자율 변동	0.01	(0.01)

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	위험		
	시장위험	신용위험	유동성위험
	기타 가격위험		
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술		<p>신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자 활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.</p> <p>연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한</p>	<p>유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.</p> <p>연결회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.</p>

		<p>연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결회사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 연결회사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.</p> <p>현금및현금성자산, 단기금융상품, 장·단기투자자산 및 장·단기대여금 등으로 구성되는 연결회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결회사는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.</p>	
--	--	---	--

위험에 대한 노출정도에 대한 기술	연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.		
--------------------	--	--	--

부채비율 및 순차입금비율에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
부 채 (A)	47,690,113
자 본 (B)	55,507,402
현금및현금성자산 등 (C)	10,318,902
차입금 (D)	29,505,907
부채비율 (A/B)	0.8592
순차입금비율 (D-C)/B	0.3457
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	<p>연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.</p> <p>주요 차입금 계약상 연결회사는 일정 수준의 부채비율, 담보채무비율 등을 준수해야 하며, 연결회사는 당분기말 현재 이러한 조건을 준수하였습니다.</p>
현금및현금성자산 등에 대한 기술	현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
부 채 (A)	46,826,413
자 본 (B)	53,503,752
현금및현금성자산 등 (C)	8,920,918
차입금 (D)	29,468,632
부채비율 (A/B)	0.8752
순차입금비율 (D-C)/B	0.3840

<p>자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보</p>	<p>연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.</p>
<p>현금및현금성자산 등에 대한 기술</p>	<p>현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.</p>

자신의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. 매출채권 및 기타수취채권 (연결)

기타 채권에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
미수금	288,624
미수수익	12,995
단기대여금	16,395
단기보증금	58,532
유동 소계	376,546
장기미수금	289
장기대여금	241,030
보증금	196,867
기타	251
비유동 소계	438,437
합계	814,983

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
미수금	274,211
미수수익	11,339
단기대여금	16,160
단기보증금	55,931
유동 소계	357,641
장기미수금	3
장기대여금	267,277
보증금	207,492
기타	241
비유동 소계	475,013
합계	832,654

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	채권액	대손충당금	장부금액 합계
매출채권	7,180,447	(1,940)	7,178,507
기타 유동채권	376,585	(39)	376,546
기타 비유동채권	439,391	(954)	438,437
합계	7,996,423	(2,933)	7,993,490

전기말

(단위 : 백만원)

	채권액	대손충당금	장부금액 합계
매출채권	6,609,990	(9,717)	6,600,273
기타 유동채권	357,680	(39)	357,641
기타 비유동채권	475,926	(913)	475,013
합계	7,443,596	(10,669)	7,432,927

8. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 백만원)

	취득원가	평가손실충당금	장부금액 합계
상품	7,763	(215)	7,548
제품	4,456,458	(903,816)	3,552,642
재공품	8,466,966	(391,444)	8,075,522
원재료	1,504,356	(83,949)	1,420,407
저장품	772,833	(92,236)	680,597
미착품	107,923	0	107,923
합계	15,316,299	(1,471,660)	13,844,639

전기말

(단위 : 백만원)

	취득원가	평가손실충당금	장부금액 합계
상품	3,523	(187)	3,336
제품	4,626,922	(1,028,168)	3,598,754
재공품	8,768,689	(1,203,637)	7,565,052
원재료	1,624,354	(119,309)	1,505,045
저장품	773,460	(75,301)	698,159
미착품	110,313	0	110,313
합계	15,907,261	(2,426,602)	13,480,659

9. 기타유동자산 및 기타비유동자산 (연결)

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
선급금	60,230
선급비용	261,366
부가세대급금	632,291
계약자산	115,460
기타	28,932
유동 소계	1,098,279
장기선급금	131,525

장기선급비용	35,581
기타	35,182
비유동 소계	202,288
합계	1,300,567

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
선급금	51,053
선급비용	218,260
부가세대급금	493,075
계약자산	136,978
기타	26,136
유동 소계	925,502
장기선급금	139,940
장기선급비용	46,311
기타	31,571
비유동 소계	217,822
합계	1,143,324

10. 관계기업 및 공동기업투자 (연결)

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구 분	회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말			전기말	
				지분율 (%)	순자산 지분금액	장부금 액	지분율 (%)	장부금액
관계기업	SK China Company Limited(*1)	중 국	컨설팅 및 투자	11.87	368,429	421,026	11.87	408,230
	SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	싱가포르	컨설팅 및 투자	20.00	368,457	368,457	20.00	351,923
	SiFive, Inc.(*1)	미 국	반도체 설계 및 제조	7.28	29,363	54,529	7.28	53,277
	우시시신파직접회로산업유한공사	중 국	과학기술단지 개발	30.00	43,369	43,369	30.00	42,458
	기타				110,784	119,216		104,203
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(*2)	중 국	반도체 부품 제조	45.00	149,563	147,977	45.00	137,655
	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(*2)	중 국	파운드리 공장 건설	50.10	225,001	226,592	50.10	220,373
	반도체성장전문투자형사모투자신탁(*2)	국 내	투자	33.33	22,128	22,128	33.33	19,283
	시스템반도체상생펀드(*2)	국 내	투자	37.50	29,852	29,852	37.50	29,779
	기타				117	117		167
합 계					1,347,06	1,433,2		1,367,34

		3	63		8
--	--	---	----	--	---

(*1) 이사회 등 참여를 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(*2) 계약에 의해 중요사항에 대해 만장일치로 의결되도록 규정되어 있어 공동기업으로 분류하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)							
구 분	기 초	취 득	지분법손익	지분법자본 변동	배 당	원금회수	분기말
SK China Company Limited	408,230	-	(297)	13,093	-	-	421,026
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	351,923	-	(36)	16,570	-	-	368,457
SiFive Inc.	53,277	-	-	1,252	-	-	54,529
우시시신파직접회로산업원유한공사	42,458	-	(240)	1,151	-	-	43,369
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	137,655	-	4,129	6,193	-	-	147,977
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	220,373	-	277	5,942	-	-	226,592
반도체성장전문투자형사모투자신탁	19,283	-	2,845	-	-	-	22,128
시스템반도체상생펀드	29,779	-	73	-	-	-	29,852
기타	104,370	13,340	(590)	3,957	(644)	(1,100)	119,333
합 계	1,367,348	13,340	6,161	48,158	(644)	(1,100)	1,433,263

② 전분기

(단위: 백만원)							
구 분	기 초	취 득	지분법손익	지분법자본 변동	배 당	원금회수	분기말
SK China Company Limited	399,116	-	750	9,997	-	-	409,863
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	352,411	-	3,936	11,147	-	-	367,494
매그너스사모투자합자회사	2,983	-	(2,721)	-	(262)	-	-
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	134,228	-	(689)	8,888	-	-	142,427
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	220,281	-	(304)	9,264	-	-	229,241
기타	243,826	12,843	1,773	5,425	(1,251)	(116)	262,500
합 계	1,352,845	12,843	2,745	44,721	(1,513)	(116)	1,411,525

(3) 당분기말과 전기말 현재 주요 관계기업과 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
SK China Company Limited	1,424,839	2,045,694	153,159	212,480
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	368,229	3,016,795	534,345	13,867
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	297,183	312,870	62,191	215,499
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	218,575	489,518	14,262	244,726

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
SK China Company Limited	1,350,607	1,998,684	352,236	-
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	217,959	3,002,468	511,291	13,783
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	302,172	314,426	78,198	234,049
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	205,206	486,625	14,617	240,522

(4) 당분기와 전분기 중 주요 관계기업과 공동기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	매출액	분기순손익	매출액	분기순손익
SK China Company Limited	14,718	(2,507)	17,336	6,317
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	201	(178)	68	19,679
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	162,143	14,250	165,477	5,317
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	13,388	552	12,729	(607)

11. 유형자산 (연결)

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	52,704,853
취득	2,943,366
처분 및 폐기	(3,922)
감가상각	(2,924,168)
대체	(34,562)
환율변동	478,324
기말장부금액	53,163,891

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	60,228,528
취득	1,747,787
처분 및 폐기	(4,703)
감가상각	(3,352,030)
대체	(3,014)
환율변동	609,073
기말장부금액	59,225,641

담보로 제공된 유형자산에 대한 기술

당분기말 현재 연결회사의 일부 기계장치 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 29 참조).

12. 리스 (연결)

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	2,694,844
증가	122,063
감가상각	(123,512)
환율변동	22,560
기말장부금액	2,715,955

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	1,779,985
증가	208,491
감가상각	(81,395)
환율변동	30,763
기말장부금액	1,937,844

리스부채에 대한 양적 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	3,029,874
증가	122,063
이자비용	27,348
지급	(167,944)
환율변동	58,031
기타	37
기말장부금액	3,069,409

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	1,797,081
증가	208,491
이자비용	12,322

지급	(83,849)
환율변동	35,968
기타	(92)
기말장부금액	1,969,921

13. 무형자산 (연결)

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	3,834,567
취득	127,985
처분 및 폐기	(13,240)
상각	(146,503)
손상차손	(250)
대체	(2,299)
기타	29,681
기말장부금액	3,829,941
기타변동에 대한 기술	기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	3,512,107
취득	435,269
처분 및 폐기	(1,569)
상각	(126,235)
손상차손	0
대체	(452)
기타	12,078
기말장부금액	3,831,198
기타변동에 대한 기술	기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

14. 차입금 (연결)

차입금 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
--	------

단기차입금	3,138,677
유동성장기차입금	2,170,345
유동성사채	3,536,214
소계, 유동	8,845,236
장기차입금	9,253,666
사채	11,407,005
소계, 비유동	20,660,671
합계	29,505,907

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
단기차입금	4,145,647
유동성장기차입금	2,012,002
유동성사채	3,699,540
소계, 유동	9,857,189
장기차입금	10,121,033
사채	9,490,410
소계, 비유동	19,611,443
합계	29,468,632

유동성사채로 분류된 교환사채에 대한 기술

전기 중 연결회사가 발행한 교환사채를 포함하고 있으며, 교환사채의 만기는 2030년이나 교환권의 행사가능성으로 인해 유동성사채로 분류하였습니다. 동 교환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

교환사채 발행 조건에 대한 공시

(단위 : 원)

	외화 해외교환사채
사채의 권면총액 (외화금액)	USD 1,700,000,000
표면이자율	0.0175
만기이자율	0.0175
만기일	2030년 04월 11일
원금상환법	1) 만기상환 : 만기까지 교환권 및 조기상환권의 미행사에 따른 잔존 사채원리금에 대해 만기 일시상환 2) 조기상환 : 회사의 조기상환권(Call Option) 및 사채권자의 조기상환권(Put Option) 존재
교환비율	사채원금의 100%
교환가액	110,033

교환대상	SK하이닉스 주식회사 발행 기명식 보통 주식(자기주식)
교환청구기간	2023년 5월 22일 ~ 2030년 4월 1일
교환가액 조정사항	무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 추가발행, 주식 배당, 현금배당, 기타 자산의 배당, 시가 미만의 신주발행 등과 같은 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정
투자자의 조기상환권(Put Option)	<ul style="list-style-type: none"> - 납일일로부터 4년 (2027. 04. 11)이 되는 날 - 당사의 지배권 변동(Change of Control)이 발생하는 경우 - 당사 발행주식이 상장폐지되거나 20 연속 거래일 이상 거래정지되는 경우
발행자의 조기상환권(Call Option)	<ul style="list-style-type: none"> - 2028년 4월 25일 부터 사채만기일 30 영업일 전까지 30 연속거래일 중 20 거래일의 종가가 교환가격의 130% 이상인 경우 - 미상환사채잔액이 총 발행총액의 10% 미만인 경우(Clean Up Call) - 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담사유가 발생하는 경우

15. 기타유동부채 및 기타비유동부채 (연결)

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
선수금	56,186
선수수익	3,060
예수금	256,865
계약부채	2,745,923
기타	40,217
유동 소계	3,102,251
기타장기종업원급여부채	209,715
비유동계약부채	0
기타	189,756
비유동 소계	399,471
합계	3,501,722

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
선수금	57,489
선수수익	3,312
예수금	198,104

계약부채	1,585,143
기타	38,213
유동 소계	1,882,261
기타장기종업원급여부채	212,233
비유동계약부채	14,015
기타	159,154
비유동 소계	385,402
합계	2,267,663

계약부채에 대한 기술

고객으로부터 받은 선수금과 반품부채가 포함되어 있습니다.

16. 총당부채 (연결)

기타총당부채에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	계약손실총당부채	판매보증총당부채	배출부채	복구총당부채	기타총당부채 합계
기초	29,656	256,402	234	1,827	288,119
전입	1,320	21,894	641	0	23,855
사용	0	(4,940)	(125)	0	(5,065)
환입	0	0	(1)	0	(1)
기말	30,976	273,356	749	1,827	306,908
총당부채의 성격에 대한 기술		연결회사는 무상 품질 보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 총당부채를 인식하고 있으며, 과거 특정 제품의 품질 저하 현상과 관련하여 제품 교환 등 연결회사가 부담할 것으로 예상되는 금액을 별도로 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.	연결회사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 총당부채로 인식하고 있습니다.		

전분기

(단위 : 백만원)

	계약손실총당부채	판매보증총당부채	배출부채	복구총당부채	기타총당부채 합계
기초		249,316	2,150	1,827	253,293
전입		72,695	1,334	0	74,029
사용		(18,107)	0	0	(18,107)
환입		0	0	0	0

기말		303,904	3,484	1,827	309,215
총당부채의 성격에 대한 기술		연결회사는 무상 품질 보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 총당부채를 인식하고 있으며, 과거 특정 제품의 품질 저하 현상과 관련하여 제품 교환 등 연결회사가 부담할 것으로 예상되는 금액을 별도로 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.	연결회사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 총당부채로 인식하고 있습니다.		

배출권 수량에 대한 공시

	공시금액
무상할당배출권 수량(단위: 만tCO ₂ -eq)	589
온실가스 배출량 추정치(단위: 만tCO ₂ -eq)	547

배출권 변동내역에 대한 공시

	2023년도분
기초(단위: 만tCO ₂ -eq)	0
무상할당 수량(단위: 만tCO ₂ -eq)	520
매입 수량(단위: 만tCO ₂ -eq)	12
기말(단위: 만tCO ₂ -eq)	532

17. 종업원급여 (연결)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
확정급여채무의 현재가치	2,589,275
사외적립자산의 공정가치	(3,820,853)
순확정급여부채(자산)	(1,231,578)
확정급여부채	65,478

확정급여자산	1,297,056
--------	-----------

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
확정급여채무의 현재가치	2,511,541
사외적립자산의 공정가치	(3,851,623)
순확정급여부채(자산)	(1,340,082)
확정급여부채	63,932
확정급여자산	1,404,014

확정급여자산 인식액에 대한 기술

당분기말과 전기말 현재 지배회사 및 일부 종속기업들의 확정급여제도의 초과적립액 1,297,056백만원과 1,404,014백만원을 중업원급여자산으로 표시하였습니다.

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산
기초금액	2,511,541	(3,851,623)
당기근무원가	61,180	
이자원가 (이자수익)	35,127	(54,831)
기여금납입액		0
관계사전출입액	3,916	(2,972)
퇴직급여지급액	(65,749)	81,282
재측정손익	43,198	
재측정요소		7,325
기타	62	(34)
기말금액	2,589,275	(3,820,853)

전분기

(단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산
기초금액	2,259,125	(3,521,426)
당기근무원가	57,344	
이자원가 (이자수익)	33,553	(54,080)
기여금납입액		(53,009)
관계사전출입액	13,533	(11,965)
퇴직급여지급액	(73,940)	95,347
재측정손익	0	
재측정요소		4,201
기타	70	(8)

기말금액	2,289,685	(3,540,940)
------	-----------	-------------

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
당기근무원가	61,180
순이자원가	(19,704)
합계	41,476

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
당기근무원가	57,344
순이자원가	(20,527)
합계	36,817

확정기여제도 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
퇴직급여비용, 확정기여제도	3,230

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
퇴직급여비용, 확정기여제도	2,514

18. 파생상품거래 (연결)

파생상품거래 위험회피수단에 대한 세부 정보 공시

	파생상품 목적의 지정				
	위험회피 목적				
	현금흐름위험회피				
	파생상품 계약 유형				
	통화 관련		통화이자율 관련	이자율 관련	
	고정금리외화사채 (액 면금액 USD 500,000천)	고정금리외화사채 (액 면가액 USD 750,000천)	변동금리외화시설대출 (액 면금액 USD 343,750천)	변동금리시설대출 (액 면금액 KRW 100,000백만)	변동금리시설대출 (액 면금액 KRW 468,600백만)
차입일	2019-09-17	2023-01-17	2019-10-02	2023-04-04	2024-03-07
대상위험	환율변동위험	환율변동위험	환율변동위험 및 이자 율위험	이자율위험	이자율위험
체결기관	국민은행 등 2개 은행	국민은행 등 4개 은행	산업은행	우리은행	신한은행

계약기간	2019.09.17 ~ 2024.09.17	2023.01.17 ~ 2026.01.17	2019.10.02 ~ 2026.10.02	2023.04.04 ~ 2028.04.04	2024.03.07 ~ 2027.10.18
------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

파생상품거래 위험회피에 대한 세부 정보 공시

(단위 : 백만원)

	파생상품 목적의 지정				
	위험회피 목적				
	현금흐름위험회피				
	파생상품 계약 유형				
	통화 관련	통화이자율 관련	파생금융자산 합계	이자율 관련	파생금융부채 합계
	고정금리외화사채 (액면금액 USD 1,250,000천)	변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 343,750천)		변동금리시설대출 (액면금액 KRW 568,600백만)	
파생상품 금융자산	158,108	72,232			
파생상품 금융부채				1,503	
공정가치	158,108	72,232	230,340	1,503	1,503
위험회피수단이 포함된 재무상태표 항목에 대한 기술			연결회사가 보유하고 있는 파생금융상품의 당분기말 공정가치는 연결재무상태표의 기타금융자산 및 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.		연결회사가 보유하고 있는 파생금융상품의 당분기말 공정가치는 연결재무상태표의 기타금융자산 및 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
위험회피의 비효과적인 부분을 포함한 포괄손익계산서의 항목을 기술			당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.		당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.

내재파생상품에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	파생상품 금융부채
내재파생상품	1,543,398
위험회피수단이 포함된 재무상태표 항목에 대한 기술	연결회사가 보유하고 있는 내재파생상품은 연결재무상태표의 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
복수의 내재파생상품을 포함한 복합금융상품에 대한 공시	연결회사가 2023년 4월 11일 발행한 교환사채에 부여된 교환권 및 콜옵션, 풋옵션입니다(주석 14 참조).

전기말

(단위 : 백만원)

	파생상품 금융부채
내재파생상품	1,477,619
위험회피수단이 포함된 재무상태표 항목에 대한 기술	연결회사가 보유하고 있는 내재파생상품은 연결 재무상태표의 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
복수의 내재파생상품을 포함한 복합금융상품에 대한 공시	연결회사가 2023년 4월 11일 발행한 교환사채에 부여된 교환권 및 콜옵션, 풋옵션입니다(주석 14 참조).

19. 자본금, 자본잉여금, 기타자본 및 기타포괄손익누계액 (연결)

주식의 분류에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	보통주
수권주식수 (단위:주)	9,000,000,000
액면가액 (단위 : 원)	5,000
보통주 발행주식수 (단위 : 주)	728,002,365
보통주자본금	3,657,652
자기주식(단위 : 주)	39,387,451
유통주식수(단위 : 주)	688,614,914
발행주식수가 감소한 사유에 대한 기술	과거 이익소각으로 인하여 발행주식수가 감소하였습니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	보통주
수권주식수 (단위:주)	9,000,000,000
액면가액 (단위 : 원)	5,000
보통주 발행주식수 (단위 : 주)	728,002,365
보통주자본금	3,657,652
자기주식(단위 : 주)	39,863,716
유통주식수(단위 : 주)	688,138,649
발행주식수가 감소한 사유에 대한 기술	과거 이익소각으로 인하여 발행주식수가 감소하였습니다.

그밖의 자본

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
자기주식	(2,245,438)

주식선택권	25,890
기타	(19,031)
합 계	(2,238,579)
자기주식(단위 : 주)	39,387,451
처분한 자기주식수 (단위 : 주)	476,265
자기주식처분이익	28,180

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
자기주식	(2,272,589)
주식선택권	22,327
기타	(19,032)
합 계	(2,269,294)
자기주식(단위 : 주)	39,863,716
처분한 자기주식수 (단위 : 주)	
자기주식처분이익	

자본잉여금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
주식발행초과금	3,625,797
기타	780,063
합 계	4,405,860

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
주식발행초과금	3,625,797
기타	746,762
합 계	4,372,559

기타포괄손익의 항목별 분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	자본			자본 합계
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분			
	지분법자본변동	해외사업장외화환 산차이	파생상품평가손익	
기타포괄손익누적 액 합계	181,056	1,112,277	259	1,293,592

전기말

(단위 : 백만원)

	자본			자본 합계
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분			
	지분법자본변동	해외사업장외화환 산차이	파생상품평가손익	
기타포괄손익누적 액 합계	132,898	875,367	5,790	1,014,055

20. 이익잉여금 (연결)

이익잉여금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
법정적립금	693,015
임의적립금	235,506
미처분이익잉여금	47,463,189
합 계	48,391,710
자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술	<p>지배기업은 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다. 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.</p> <p>2024년 3월 27일자 주주총회에서 배당금 206,442백만원이 결의되었으며, 당분기말 현재 미지급배당금은 미지급금에 포함되어 있습니다.</p>
주주총회에서 결의된 배당금	206,442

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
법정적립금	610,436
임의적립금	235,506
미처분이익잉여금	45,883,371
합 계	46,729,313
자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술	<p>지배기업은 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다. 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.</p>

주주총회에서 결의된 배당금	
----------------	--

21. 매출액 (연결)

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
제품 등의 판매	12,408,716
용역의 제공	20,882
합 계	12,429,598

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
제품 등의 판매	5,073,063
용역의 제공	15,048
합 계	5,088,111

고객과의 계약에서 생기는 수익의 품목별 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	DRAM	NAND Flash	기타	제품과 용역 합계
수익(매출액)	7,493,448	4,407,213	528,937	12,429,598

전분기

(단위 : 백만원)

	DRAM	NAND Flash	기타	제품과 용역 합계
수익(매출액)	2,918,692	1,688,034	481,385	5,088,111

지역별 매출액 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	지역					지역 합계
	국내	외국				
		중국	아시아(중국 제외)	미국	유럽	
수익(매출액)	485,931	4,091,101	1,170,251	6,312,614	369,701	12,429,598

전분기

(단위 : 백만원)

	지역					지역 합계
	국내	외국				
		중국	아시아(중국 제외)	미국	유럽	
수익(매출액)	394,307	1,546,079	711,623	2,290,112	145,990	5,088,111

고객과의 계약에서 생기는 수익인식의 시점 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	한 시점에 이행	기간에 걸쳐 이행	재화나 용역의 이전 시 기 합계
수익(매출액)	12,408,716	20,882	12,429,598

전분기

(단위 : 백만원)

	한 시점에 이행	기간에 걸쳐 이행	재화나 용역의 이전 시 기 합계
수익(매출액)	5,073,063	15,048	5,088,111

22. 판매비와관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
급여	288,357
퇴직급여	10,497
복리후생비	51,697
지급수수료	166,348
감가상각비	76,686
무형자산상각비	60,184
운반보관비	12,779
세금과공과	20,149
광고선전비	15,272
소모품비	17,926
판매촉진비	78,548
품질관리비	25,450
기타	79,922
소계	903,815
연구개발비 총지출액	1,085,221
개발비 자산화	(80,420)
경상개발비	1,004,801
판매비와관리비	1,908,616

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
급여	206,484
퇴직급여	8,978
복리후생비	59,124
지급수수료	202,734
감가상각비	72,714

무형자산상각비	54,954
운반보관비	11,662
세금과공과	23,806
광고선전비	12,958
소모품비	15,919
판매촉진비	29,291
품질관리비	55,323
기타	85,471
소계	839,418
연구개발비 총지출액	1,066,579
개발비 자산화	(148,994)
경상개발비	917,585
판매비와관리비	1,757,003

23. 비용의 성격별 분류 (연결)

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품의 변동	(464,358)
원재료, 저장품 및 소모품 사용	2,352,007
종업원급여비용	1,760,196
감가상각비 등	3,186,882
지급수수료	805,613
동력 및 수도광열비	667,311
수선비	487,316
외주가공비	425,476
기타	408,891
대체: 개발비자산화 등	(85,765)
합계	9,543,569

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품의 변동	(1,606,650)
원재료, 저장품 및 소모품 사용	2,551,800
종업원급여비용	1,442,199
감가상각비 등	3,556,847
지급수수료	899,537
동력 및 수도광열비	691,217
수선비	300,276

외주가공비	319,357
기타	490,899
대체: 개발비자산화 등	(155,069)
합계	8,490,413

성격별 비용에 대한 기술

분기연결포괄손익계산서 상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

24. 금융수익 및 금융비용 (연결)

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
이자수익	80,275
배당금수익	4,414
외환차이	1,001,353
기타	31,511
금융수익 소계	1,117,553
이자비용	402,291
외환차이	1,216,395
금융상품평가손실	5,426
기타	1,027
금융비용 소계	1,625,139
순금융손익	(507,586)
장기투자자산 환율변동효과	(92,201)

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
이자수익	49,804
배당금수익	78
외환차이	998,057
기타	25,369
금융수익 소계	1,073,308
이자비용	303,008
외환차이	898,670
금융상품평가손실	716
기타	0
금융비용 소계	1,202,394
순금융손익	(129,086)
장기투자자산 환율변동효과	156,722

외환차이에 대한 기술

당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 (-) 92,201 백만원(전분기 156,722백만원)이 포함되어 있습니다.

25. 기타영업외수익과 기타영업외비용 (연결)

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
유형자산처분이익	8,572
무형자산처분이익	13,128
기타	5,778
기타영업외수익 합계	27,478
매출채권처분손실	3,469
기부금	5,987
무형자산처분손실	6,417
운휴자산상각비	7,304
기타	16,330
기타영업외비용 합계	39,507

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
유형자산처분이익	3,505
무형자산처분이익	0
기타	15,386
기타영업외수익 합계	18,891
매출채권처분손실	2,238
기부금	4,342
무형자산처분손실	1,316
운휴자산상각비	2,816
기타	4,719
기타영업외비용 합계	15,431

26. 법인세비용 (연결)

법인세비용 산정 및 인식에 대한 기술

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

27. 주당이익 (연결)

주당이익

당분기

(단위 : 백만원)

	보통주
지배기업소유주지분 분기순이익(손실)	1,919,251
가중평균유통보통주식수 (단위 : 주)	688,306,127
기본주당이익 (단위 : 원)	2,788
발행주식수 (단위: 주)	728,002,365
자기주식 효과 (단위 : 주)	(39,696,238)
주식보상비용(세후)	1,620
보통주희석분기순이익(손실)	1,919,251
가중평균희석유통보통주식수 (단위 : 주)	688,946,675
희석주당이익 (단위:원)	2,788
주식선택권 효과	640,548
교환사채 발행에 따른 잠재적 희석효과 주식수 (단위: 주)	20,336,717
교환사채 발행에 따른 잠재적 희석효과 주식수에 대한 기술	교환사채 발행에 따른 잠재적 희석효과 20,336,717주 등이 있지만, 당기 반희석효과로 인하여 희석주당손익을 계산할 때 고려하지 않았습니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	보통주
지배기업소유주지분 분기순이익(손실)	(2,580,409)
가중평균유통보통주식수 (단위 : 주)	687,884,807
기본주당이익 (단위 : 원)	(3,751)
발행주식수 (단위: 주)	728,002,365
자기주식 효과 (단위 : 주)	(40,117,558)
주식보상비용(세후)	0
보통주희석분기순이익(손실)	(2,580,409)
가중평균희석유통보통주식수 (단위 : 주)	687,884,807
희석주당이익 (단위:원)	(3,751)
주식선택권 효과	0
교환사채 발행에 따른 잠재적 희석효과 주식수 (단위: 주)	
교환사채 발행에 따른 잠재적 희석효과 주식수에 대한 기술	

28. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래 (연결)

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
관계기업(*)	Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd., Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsources), 농업회사법인 푸르메소셜팜㈜, 우시시신파직접회로산업원유한공사, 미래에셋위반도체 제1호 창업벤처전문사모투자합작회사 엘엔에스 10호 Early Stage III 투자조합, SiFive Inc., YD-SK-KDB 소셜밸류 Ningbo Zhongxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership), 강소KVTS반도체과학기술기 술유한회사, Sapeon Inc., SK telecom Japan, SK America, Inc.
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., 반도체성장 전문투자형 사모투자신탁, 시스템반도체 상생 전문투자형 사모투자신탁, 반도체 생태계 일반 사모투자신탁
기타특수관 계자	연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK스퀘어(주) 및 그 종속기업과 SK스퀘어(주)의 지배기 업인 SK(주)와 그 종속기업

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자																									전체 특수 관계자 합계			
기타 특수관계자																												
관계기업					공동기업					기타 특수관계자																		
	SK China Compan y Limited 주	농림회사 법인 부트 telecom Co., Ltd. Japan (Wuxi) Co., Ltd.	SK Semicon ductor (Wuxi) Co., Ltd.	HYTECH Hystars Semicon ductor (Wuxi) Co., Ltd.		SK텔레콤 주	SK(주) ORE Limited	SK에코플 랜드주	SK(주)나지 주	SK네트웍 스주	SK연방스 주	충청에너지 자서비스 주	SK스플로 리온 주	SK실트론 주	SK대티리 Techdne am Co., Ltd.	SK트리플 주	SK이노비 주	SK스퀘어 주	클린인더 위탁관리 주	메트릭스 스트리얼 위탁관리 주	메트릭스 케이팔엔 주	SK E&S주	SK LING Trading Pte., Ltd.	기타				
매출 등	2	0	0	3,807	0	8,504	4,711	172,347	6,278	9,769	1,595	114	4	950	7,857	127	0	220	197	2,219	6	0	0	25	68	0	53,640	272,440
영업 등	3,535	29	961	145,362	3,603	14,267	81,147	0	0	42,811	1,435	19,977	18,382	33,899	98,468	24,623	28,998	36,803	25,081	20,742	0	1,642	7,628	10,051	7,547	74,564	59,671	759,826
자산총액	0	0	0	8,525	39,775	93	7,354	0	69,238	0	66	10	61	0	0	98,200	0	0	2,943	78	0	0	0	751	0	19,092	3,474	249,660
특수관계 자거래에 대한 기술							일본기 중 분생한 SK브랜드 사용로거 포함되어 있습니다.																					

당분기

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자																									전체 특수 관계자 합계				
기타 특수관계자																													
관계기업				공동기업				기타 특수관계자																					
	SK China	농림회사	SK	Semicon	Semicon	HITECH	Hystars	SK텔레콤	SK(주)	ORE	SK(주)코플	SK(주)나지	SK(주)나트릭	SK(주)플로스	충청에너지서비스	SK스플론	SK실트론	SK(주)타리	Techdne	SK(주)리프	SK(주)노빅	SK스케이	메스케이	스트리얼	메프메스	SK	SK LNG	기타	
	Compan	법인 부트	telecom	ductor	ductor																								
	y Limited	영소셜밸류	Japan	(Wuxi)	(Wuxi)																								
				Co., Ltd.	Co., Ltd.																								
매출 등	8	0		2,402	47	6,286	5,232	132,212	9,849	9,672	1,607	682	0	1,500	10,045	31	0	244	698	3,847	28	0			22	65	0	45,567	230,044
영업 등	2,771	20		282,107	5,745	13,265	51,452	0	0	71,379	3,341	39,645	28,017	39,321	115,280	12,657	37,185	49,797	24,880	29,674	0	1,578			13,999	4,096	0	54,126	880,295

자산책적	0	0		129,474	0	0	3,315	0	20,039	18,700	165	18	0	0	0	50,205	0	0	542	35	0	0		802	0	6,962	4,514	234,771
특수관계 자거래에 대한 기술							관문기 중 발행한 SK브랜드 사용표기 포함되어 있습니다.																					

특수관계자와의 주요 채권 채무 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자																											전체 특수 관계자 합계	
특수관계자																												
관계기업				공동기업		기타 특수관계자																						
	SK China Company Limited	농림회사 법인 두프 텔스텔 주	SK telecom Japan Co., Ltd.	HITECH Semicon ductor (Wuxi) Co., Ltd.	Hystars Semicon ductor (Wuxi) Co., Ltd.	SK텔레콤 주	SK주 주	ESSENC ORE Limited	SK메코를 주	SK메니지 주	SK네트웍 스주	SK엔솔스 주	중형에너지 서비스 주	SK스퍼센 트주	SK실트론 주	SK이디리 am Co., Ltd.	Techdre 주	SK트리플 주	SK이노비 이션주	SK스케이 주	플랜미디어 주	스트리원 주	에프엑스 케이텔 주	SK E&S주	SK LING Trading Pte., Ltd.	기타		
매출채권 등	0	0	606	3,647	0	294	4,807	52,327	3,169	1,260	139	28	0	406	141,128	76	0	206	73	585		17,330	0	4	26	0	36,696	262,807
미지급금 등	3,562	10	2,245	391,326	128,452	16,109	113,537	0	101,039	36,809	6,669	20,151	5,511	17,348	48,823	613,202	5,911	16,392	28,484	4,797		158,740	594,720	4,049	0	45,797	76,016	2,439,699
미지급금 등에 포함 된 차입금					42,382																							
특수관계 자 채권 채무 내역 에 대한 기술					미지급금 등에는 차 입금 42,382백 만원이 포 함되어 있 습니다.																							
채권하고 있는 차금 보증 외환 금액					RMB 701,000, 000																							

[illegible]

[illegible]

주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
급여	2,414
퇴직급여	439
주식보상비용	0
합계	2,853
주요 경영진에 대한 보상에 대한 기술	연결회사는 기업활동의 계획·지휘·통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사를 주요 경영진으로 판단하였습니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
급여	1,615
퇴직급여	168

주식보상비용	1,145
합계	2,928
주요 경영진에 대한 보상에 대한 기술	연결회사는 기업활동의 계획·지휘·통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사를 주요 경영진으로 판단하였습니다.

대규모기업집단소속회사거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자						
	특수관계자						
	대규모기업집단소속회사						
	SK케미칼㈜	SK바이오사이언스㈜	㈜유엔에이디지털	에스엠코어㈜	한국 벅슬렌 유한회사	기타 대규모집단 소속회사	합계
매출 등	1,802	442	2	6	751	389	3,392
매입 등	0	2	2,775	277	0	0	3,054
자산취득							

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자						
	특수관계자						
	대규모기업집단소속회사						
	SK케미칼㈜	SK바이오사이언스㈜	㈜유엔에이디지털	에스엠코어㈜	한국 벅슬렌 유한회사	기타 대규모집단 소속회사	합계
매출 등	2,035	504	0	3	1,087	381	4,010
매입 등	311	7	1,446	1,992	0	0	3,756
자산취득	0	0	0	1,320	0	0	1,320

대규모기업집단소속회사거래 중 채권 채무에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자						
	특수관계자						
	대규모기업집단소속회사						
	SK케미칼㈜	SK바이오사이언스㈜	㈜유엔에이디지털	에스엠코어㈜	한국 벅슬렌 유한회사	기타 대규모집단 소속회사	합계
매출채권 등	683	219	1	4	20	93	1,020
미지급금 등	0	0	597	518	0	0	1,115

전기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자						
	특수관계자						
	대규모기업집단소속회사						
	SK케미칼㈜	SK바이오사이언스㈜	㈜유엔에이디지털	에스엠코어㈜	한국 벅슬렌 유한회사	기타 대규모집단 소속회사	합계
매출채권 등	792	163	1	0	225	167	1,348
미지급금 등	0	1	0	1,725	0	0	1,726

특수관계자리스거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	공동기업	기타특수관계자
	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. 및 Hystars Semiconductor(Wuxi) Co., Ltd.	SK머티리얼즈 에어플러스(주) 등
사용권 자산	48,222	100,984
리스부채	48,222	100,984
지급한 리스료	22,892	41,647

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	공동기업	기타특수관계자
	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. 및 Hystars Semiconductor(Wuxi) Co., Ltd.	SK머티리얼즈 에어플러스(주) 등
사용권 자산	127,150	72,433
리스부채	127,150	72,433
지급한 리스료	15,966	21,535

특수관계거래에 대한 기술

연결회사의 당분기 중 종속기업 설립은 주석 1에 설명되어 있으며, 관계기업에 대한 취득 및 추가 출자 거래는 주석 10에 설명되어 있습니다.

특수관계자자금거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		전체 특수관계자 합계
	특수관계자		
	관계기업	기타특수관계자	
	매그너스사모투자합자회사	SK스퀘어(주)	
차입금의 상환			
배당금수익			
배당금지급		43,830	43,830

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	전체 특수관계자 합계
	특수관계자	

	관계기업	기타특수관계자	
	매그너스사모투자합자회사	SK스퀘어(주)	
차입금의 상환	0	0	0
배당금수익	262	0	262
배당금지급	0	43,830	43,830

29. 우발부채와 약정사항 (연결)

우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	법적소송우발부채
<p>유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채</p>	<p>중국 반독점법 위반 조사 2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 연결회사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.</p> <p>소송 및 특허 클레임 등 당분기말 현재 연결회사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.</p>

담보로 제공된 유형자산에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	유형자산								
	토지와 건물			기계장치			유형자산 합계		
	기능통화 또는 표시통화		기능통화 또는 표시 통화 합계	기능통화 또는 표시통화		기능통화 또는 표시 통화 합계	기능통화 또는 표시통화		기능통화 또는 표시 통화 합계
	USD	KRW		USD	KRW		USD	KRW	
담보로 제공된 유형 자산		103,328		2,947,999		3,051,327			
원화 담보설정액	95,571	14,854		4,412,974	450,000		4,508,545	464,854	
외화 담보설정액	USD 71,000,000	0		USD 3,277,000,000	0		USD 3,348,000,000	0	
원화 담보채무액	23,031	3,214		2,415,736	466,667		2,438,767	469,881	
외화 담보채무액	USD 17,000,000			USD 1,794,000,000			USD 1,811,000,000		
차입금 종류			시설자금대출관련			시설자금대출 등			

전체 특수관계자											
특수관계자											
지배기업				종속기업							
				SK hynix Semiconductor(China) Ltd.		SK hynix America Inc. 등 판매법인		국내종속기업			
거래상대방											
태나은행 등	중국농업은행 등	씨티은행 등	태나은행 등	중국농업은행 등	씨티은행 등	태나은행 등	중국농업은행 등	씨티은행 등	태나은행 등	중국농업은행 등	씨티은행 등
약칭의 종류											
상 한 Us an ce 수 0 10 · 수 0 00											

[illegible]

유형자산을 취득하기 위한 약정액에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
유형자산을 취득하기 위한 약정액	10,767,549
유형자산을 취득하기 위한 약정에 대한 설명	당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 10,767,549백만원(전기말: 12,008,592백만원)입니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
유형자산을 취득하기 위한 약정액	12,008,592
유형자산을 취득하기 위한 약정에 대한 설명	

사업결합에서 비롯된 우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	인텔 NAND
과거 사업결합 양수도금액 (외화)	USD 8,844,000,000

<p>관련된 미래사건에 대한 주요한 가정에 대한 기술, 사업결합에서 비롯된 우발부채</p>	<p>인텔 NAND 사업부문 인수</p> <p>연결회사는 2020년 중 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옵테인 사업을 제외한 NAND 사업 전체(이하 "인텔NAND사업")를 인수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 해당 사업은 해외 종속기업들을 통해 두 번에 나뉘어 이전되며, 양수도금액은 USD8,844백만으로 1차 종결 시점에 USD6,609백만을 지급하였으며, 잔금 USD2,235백만은 2차 종결이 예상되는 2025년 3월까지지급될 예정입니다. 본 거래의 2차 종결은 정부기관의 심의를 포함하여 계약에서 정한 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있으며, 특정 상황으로 계약 해지시 약정된 termination fee를 지급해야 합니다. 한편 연결회사는 2차 거래종결이 이루어지지 않을 가능성은 낮다고 판단하고 있습니다.</p> <p>연결회사는 2021년 중 완료된 인텔 NAND 사업 인수 1차 종결과 관련하여 중국 경쟁당국(중국 국가시장감독관리총국)으로부터 해당 인수거래에 대한 기업결합승인을 취득하는 과정에서 향후 5년간 중국 eSSD 시장에서 합리적인 가격정책을 유지하고 생산량을 확대할 의무 및 중국 eSSD 시장에 제3의 경쟁사가 진입하는 것을 지원해 줄 의무 등을 주요 내용으로 하는 조건들을 부과받은 바 있습니다. 따라서, 연결회사는 향후 5년간 동 의무들을 준수하여야 하며, 5년 후 동 의무들을 면제해 줄 것을 신청할 수 있습니다. 연결회사가 이와 같은 신청을 할 경우 중국 경쟁당국은 중국 eSSD 시장에서의 경쟁상황을 고려하여 동 신청을 수용할지를 결정할 것입니다.</p>
--	--

우발채무 및 약정사항에 대한 추가 정보 기술

- HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와의 후공정서비스계약
연결회사는 HITECH과 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등입니다. 연결회사는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 금액을 지급하고 있습니다.

- KIOXIA Holdings Corporation(이하 "KIOXIA") 투자
장기투자자산에 포함된 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P. 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited에 대한 투자를 통한 KIOXIA 투자와 관련하여 지분취득일 이후 일정기간 동안 연결회사의 직·간접적인 KIOXIA 보유지분이 특정비율 이하로 제한됩니다. 또한, 연결회사는 동 기간 동안 KIOXIA에 대한 이사임명권이 제한되며, 경영 및 영업 의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 없습니다.

-미국 상무부 산업안보국(BIS)은 2022년 10월 7일 고성능반도체의 중국 수출과 중국 내 반도체 생산 및 생산장비와 관련된 제한을 강화하는 신규 수출 규제를 발표하였습니다. 연결회사는 중국 내 반도체공장의 원활한 운영을 위해 미국 정부와 적극적으로 논의를 하였고, 2023년 10월 10일까지 1년 동안 위 수출규제의 적용을 유예 받았습니다. 이 후, 2023년 9월 29일 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 현재 연결회사의 중국 내 반도체 공장을 VEU(Validated End-User, 검증된 사용자)로 지정하여 지정된 품목에 대하여는 별도의 허가절차 및 유효기간 없이 수입이 가능하도록 허가하였습니다.

30. 분기연결현금흐름표 (연결)

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
분기순이익(손실)	1,917,039
법인세비용(수익)	455,536
이자비용	402,291
이자수익	(80,275)
감가상각비	3,047,683
무형자산상각비	146,503
퇴직급여	41,476
외화환산이익	(607,509)
외화환산손실	941,033
금융자산처분이익	(23,767)
기타	47,440
매출채권의 감소(증가)	(210,897)
기타수취채권의 감소	26,537
재고자산의 증가	(192,079)
기타자산의 감소(증가)	(142,454)

매입채무의 감소	(256,934)
미지급금의 감소	(1,210,284)
기타지급채무 증가(감소)	291,010
총당부채의 증가	17,630
기타부채의 증가	1,139,089
퇴직금의지급	(408)
사외적립자산 납부	0
영업으로부터 창출된 현금	5,748,660

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
분기순이익(손실)	(2,585,491)
법인세비용(수익)	(939,692)
이자비용	303,008
이자수익	(49,804)
감가상각비	3,433,428
무형자산상각비	126,235
퇴직급여	36,817
외화환산이익	(618,009)
외화환산손실	621,421
금융자산처분이익	(18,426)
기타	(5,260)
매출채권의 감소(증가)	1,202,610
기타수취채권의 감소	43,551
재고자산의 증가	(1,341,656)
기타자산의 감소(증가)	161,440
매입채무의 감소	(595,231)
미지급금의 감소	(50,775)
기타지급채무 증가(감소)	(1,075,489)
총당부채의 증가	58,982
기타부채의 증가	11,200
퇴직금의지급	(1,342)
사외적립자산 납부	(53,009)
영업으로부터 창출된 현금	(1,335,492)

주요 비현금거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
배당금 관련 미지급금 증가	206,442

	공시금액
배당금 관련 미지급금 증가	206,295

현금의 유입과 유출 항목의 순증감액 표기에 대한 설명

연결회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기투자자산 등으로 인한 현금의 유입과 유출 항목을 순증감액으로 표시하였습니다.

31. 주식기준보상 (연결)

주식기준보상액정의 조건에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	주식기준보상액정																		
	선택형 주식기준보상														주식결제형 주식기준보상			항도제한 조건	
																		부주식(RSU)	
	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차	13차	14차	선택형 주식기 준보상 합계	1-1차	1-2차	2차	SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 그 종 속기업의 종업 원, 부(여)원
총부여수량 (단 위: 주)	99,600	99,600	99,600	7,747	7,223	8,171	61,487	61,487	61,487	54,020	6,397	6,469	75,163	195,460	843,911				74,590,952
주식기준보상 액정에 따라 소 멸된 주식선택 권의 수량(단위 : 주)	-	-	-	-	-	8,171	-	-	-	10,764	-	-	29,851	59,167	107,953				
주식기준보상 액정에 따라 당 기종 소멸된 주 식선택권의 수 량														39,546					
행사수량 (단위 : 주)	99,600	99,600	99,600	7,747	7,223	0	61,487	61,487	61,487	5,193	0	0	0	0	503,424				
미행사수량 (단 위: 주)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,063	6,397	6,469	45,312	136,293	232,534				
주식기준보상 액정 중 소멸된 기타자본부자 의 수량(단위: 주)																			22,130,392
행사수량 (단위 : 주)																			13,876,532
부(여)원	2017.03.24	2017.03.24	2017.03.24	2018.01.01	2018.03.28	2019.02.28	2019.03.22	2019.03.22	2019.03.22	2020.03.20	2020.03.20	2021.03.30	2021.03.30	2022.03.30		2022.03.17	2022.04.27	2023.06.28	

악정통계제공 기간	2017.03.24 ~ 2019.03.24	2017.03.24 ~ 2020.03.24	2017.03.24 ~ 2021.03.24	2018.01.01 ~ 2019.12.31	2018.03.28 ~ 2020.03.28	2019.02.28 ~ 2021.02.28	2019.03.22 ~ 2021.03.22	2019.03.22 ~ 2022.03.22	2019.03.22 ~ 2022.03.22	2020.03.20 ~ 2023.03.20	2020.03.20 ~ 2023.03.20	2021.03.30 ~ 2023.03.30	2021.03.30 ~ 2023.03.30	2022.03.30 ~ 2024.03.30		부여일 이후 2년 이상 재직	부여일 이후 2년 이상 재직	2023년 1월 1일 이후 3년 이상 재직	
행사가능기간	2019.03.25 ~ 2022.03.24	2020.03.25 ~ 2023.03.24	2021.03.25 ~ 2024.03.24	2020.01.01 ~ 2022.12.31	2020.03.29 ~ 2023.03.28	2021.03.01 ~ 2024.02.29	2021.03.23 ~ 2024.03.22	2022.03.23 ~ 2025.03.22	2023.03.23 ~ 2026.03.22	2023.03.21 ~ 2027.03.20	2023.03.21 ~ 2027.03.20	2023.03.31 ~ 2026.03.30	2023.03.31 ~ 2026.03.30	2024.03.31 ~ 2027.03.30		2025년 3월 17일 부터 2029년 3월 17일 까지	2025년 4월 27일 부터 2029년 4월 27일 까지	2026년 1월 1일 원시 자금	
행사가격 (단위 : 원)	48,400	52,280	56,460	77,440	83,060	73,430	71,560	77,290	83,470	84,730	84,730	136,060	136,060	121,610					
주식선택권으 로 발행한 주식 의 종류에 대한 기술																기명식 보통주 식	기명식 보통주 식	기명식 보통주 식	
주식기준보상 액의 결정방 식에 대한 기술			현금결제 방식 으로 행사되었 습니다.							현금결제 방식 으로 행사되었 습니다.						자기주식 교부	자기주식 교부	자기주식 교부	
부여주식수																최초부여규모 + TSR + 조정비 율 / 행사일 추가	최초부여규모 + TSR + 조정비 율 / 행사일 추가	최초부여수량 + (조정비율 + 주 가상승률 - KOSPI200 상 승률)	
기준주가 (단위 : 원)																124,000	108,500	79,975	
부여주가																			분기

부여주식수 산정에 적용되는 변수에 대한 기술

TSR(총주주수익률)은 (행사 통지일 주가 - 기준주가 + 부여일부터 권리행사통지일까지의 회사의 주 당 총 배당금액)/기준주가로 계산되며, 조정비율은 동종업계 TSR 대비 자사 TSR을 고려합니다.

조정비율은 주가상승률을 고려하며, 최초부여규모 대비 지급수량의 상한은 2배입니다. 주가상승률 100% 상승 및 KOSPI200 상승률 대비 50%p 초과 상승 시 최초부여규모만큼의 주식을 추가로 지급 합니다.

1-1차 및 1-2차 주식기준보상 중 일부를 취소하고 2차 주식기준보상에서 대체 부여한 수량이 있습니다.

2년 이상 3년 미만 재직 시 근무기간에 비례하여 부여 수량을 조정합니다.

재무상태에 미치는 주식기준보상거래의 영향에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	공시금액
주가차액보상권 부채 총장부금액	49,382

회계기간에 부여된 주식선택권의 공정가치에 기초하여 간접측정한 제공받은 재화나 용역의 공정가치에 대한 공시

(단위 : 백만원)

주식기준보상액

	선택형 주식기준보상							주식결제형 주식기준보상			
	3차	10차	11차	12차	13차	14차	선택형 주식기준보 상 합계	1-1차	1-2차	2차	주식결제형 주식기 준보상 합계
옵션가격결정모형에 대한 기술, 부여한 주식선택권	이항모형	이항모형	이항모형	이항모형	이항모형	이항모형		이항모형	이항모형	이항모형	
주가(평가기준일 중 가) (단위: 원)	133,900	133,900	133,900	133,900	133,900	133,900		0	0	0	
기대주가변동성	0.3310	0.3310	0.3310	0.3310	0.3310	0.3310		0.3392	0.3422	0.3481	
주당공정가치(단위: 원)	77,595	59,412	59,412	28,292	28,292	39,805		52,729	42,064	155,443	
배당수익률	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008		0.000	0.000	0.015	
무위험이자율 (국공 채수익률)	0.0354	0.0360	0.0360	0.0355	0.0355	0.0360		0.0265	0.0319	0.0360	
그 밖의 특성이 공정 가치를 측정할 때 모 형 안에 반영되었는 지 여부와 반영된 경 우 그 방법에 관한 정보, 부여한 주식선 택권											1-1차, 1-2차 TSR 계산 시 행사기간까 지의 배당금액이 가 산률에 따라 배당에 따른 추가하락분이 보전된다고 보아 배 당성향은 고려하지 않았습니다.

주식보상비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
주식보상비용	13,633

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
주식보상비용	21,955

공정가치 산정에 대한 기술

이외 종속회사가 종속회사의 임직원에게 부여한 RSU는 당기말 현재 기초자산의 주가를 이용하여 공정가치를 산정하였습니다.

32. 보고기간 후 사건 (연결)

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

	지분 양도 계약
양도하기로 결의된 지분율	0.2133
양도하기로 결의된 외화금액	USD 149,300,000

수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술	연결회사는 2024년 4월 29일 이사회에서 우시산업발전집단 유한공사에 종속기업 SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.의 지분 21.33%를 USD 149,300,000에 양도하기로 결의하였으며, 이후 지분 양도 계약을 체결하였습니다.
-------------------------------	---

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 77 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 76 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 77 기 1분기말	제 76 기말
자산		
유동자산	18,069,804	17,751,302
현금및현금성자산 (주4,5)	2,067,890	2,898,074
단기금융상품 (주4,5)	272,500	272,500
단기투자자산 (주4,5)	451,947	331,544
매출채권 (주4,5,6,27)	3,347,301	3,899,437
기타수취채권 (주4,5,6,27)	1,872,103	994,095
기타금융자산 (주4,5,17)	117,511	83,750
재고자산 (주7)	9,311,778	8,769,507
당기법인세자산	25,165	25,159
기타유동자산 (주8)	603,609	477,236
비유동자산	76,457,233	75,198,085
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 (주9)	13,628,272	12,694,398
장기투자자산 (주4,5)	3,674,761	3,765,853
기타수취채권 (주4,5,6,27)	10,602,065	10,977,139
기타금융자산 (주4,5,17)	113,175	62,839
유형자산 (주10,28)	39,909,977	38,974,277
사용권자산 (주11,27)	1,965,147	1,938,361
무형자산 (주12)	2,922,295	2,928,535
투자부동산	208	211
이연법인세자산	2,217,048	2,318,089
종업원급여자산 (주16)	1,269,568	1,371,312
기타비유동자산 (주8,27,28)	154,717	167,071
자산총계	94,527,037	92,949,387
부채		
유동부채	15,761,440	16,197,793
매입채무 (주4,5,27)	2,674,619	2,410,182

미지급금 (주4,5,19,27)	3,032,562	3,057,580
기타지급채무 (주4,5,27)	1,423,876	1,127,555
차입금 (주4,5,13,28)	5,617,629	7,002,045
기타금융부채 (주4,5,17)	1,543,398	1,477,619
총당부채 (주15)	360,184	318,609
당기법인세부채	295,638	4,484
리스부채 (주4,5,11,27)	510,285	501,586
기타 유동부채 (주14)	303,249	298,133
비유동부채	22,279,514	22,233,272
장기미지급금 (주4,5)	483,007	1,678,817
기타지급채무 (주4,5,27)	37,598	34,691
차입금 (주4,5,13,28)	19,632,607	18,423,268
기타금융부채 (주4,5,17)	1,839	1,398
리스부채 (주4,5,11,27)	1,916,684	1,884,419
기타 비유동 부채 (주14)	207,779	210,679
부채총계	38,040,954	38,431,065
자본		
자본금 (주18)	3,657,652	3,657,652
자본잉여금 (주18)	4,417,743	4,389,563
기타자본 (주18,30)	(2,238,579)	(2,269,294)
기타포괄손익누계액 (주18)	259	5,790
이익잉여금 (주19)	50,649,008	48,734,611
자본총계	56,486,083	54,518,322
자본과부채총계	94,527,037	92,949,387

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	제 77 기 1분기		제 76 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
영업수익 (주20,27)	10,401,819	10,401,819	4,443,475	4,443,475
매출원가 (주20,27)	6,080,508	6,080,508	5,510,377	5,510,377
매출총이익(손실)	4,321,311	4,321,311	(1,066,902)	(1,066,902)
판매비와관리비 (주21,22,27)	1,420,241	1,420,241	1,209,639	1,209,639
영업이익(손실)	2,901,070	2,901,070	(2,276,541)	(2,276,541)
금융수익 (주23)	1,168,944	1,168,944	1,032,011	1,032,011
금융비용 (주23)	1,512,320	1,512,320	979,266	979,266
기타영업외수익 (주24,27)	45,396	45,396	17,295	17,295

기타영업외비용 (주24,27)	12,061	12,061	3,341	3,341
법인세비용차감전순이익(손실)	2,591,029	2,591,029	(2,209,842)	(2,209,842)
법인세비용(수익) (주25)	419,697	419,697	(913,633)	(913,633)
분기순이익(손실)	2,171,332	2,171,332	(1,296,209)	(1,296,209)
법인세차감후 기타포괄손익	(56,024)	(56,024)	(11,267)	(11,267)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
확정급여제도의재측정요소 (주16)	(50,493)	(50,493)	(4,362)	(4,362)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				
파생상품평가손익 (주17)	(5,531)	(5,531)	(6,905)	(6,905)
분기총포괄이익(손실)	2,115,308	2,115,308	(1,307,476)	(1,307,476)
주당손익 (주26)				
기본주당분기순이익(손실) (단위 : 원)	3,155	3,155	(1,884)	(1,884)
희석주당분기순이익(손실) (단위 : 원)	3,154	3,154	(1,884)	(1,884)

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 76 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 백만원)

	자본					
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,375,998	(2,311,408)	27,370	54,413,210	60,162,822
분기순이익(손실)					(1,296,209)	(1,296,209)
확정급여제도의재측정요소 (주16)					(4,362)	(4,362)
파생상품평가손익				(6,905)		(6,905)
총포괄손익 합계				(6,905)	(1,300,571)	(1,307,476)
배당금의 지급 (주19)					(206,296)	(206,296)
주식선택권 부여/행사 (주30)			2,597			2,597
자기주식처분 (주18)		10,463	23,269			33,732
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계		10,463	25,866		(206,296)	(169,967)
2023.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,386,461	(2,285,542)	20,465	52,906,343	58,685,379
2024.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,389,563	(2,269,294)	5,790	48,734,611	54,518,322
분기순이익(손실)					2,171,332	2,171,332
확정급여제도의재측정요소 (주16)					(50,493)	(50,493)
파생상품평가손익				(5,531)		(5,531)
총포괄손익 합계				(5,531)	2,120,839	2,115,308
배당금의 지급 (주19)					(206,442)	(206,442)
주식선택권 부여/행사 (주30)			3,564			3,564
자기주식처분 (주18)		28,180	27,151			55,331
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계		28,180	30,715		(206,442)	(147,547)
2024.03.31 (기말자본)	3,657,652	4,417,743	(2,238,579)	259	50,649,008	56,486,083

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 77 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

	제 77 기 1분기	제 76 기 1분기
영업활동현금흐름	4,151,910	(1,423,904)
영업에서 창출된 현금흐름 (주29)	4,314,952	(1,060,970)
이자의 수취	225,709	150,560
이자의 지급	(354,241)	(147,652)
배당금의 수취	1,122	80,313
법인세의 납부	(35,632)	(446,155)
투자활동현금흐름	(4,040,178)	(3,390,019)
단기투자자산의 순증감	(118,119)	160,913
기타수취채권의 감소	8,248	152,450
기타수취채권의 증가	(199)	(662,388)
장기투자자산의 처분	159	201
장기투자자산의 취득	(1,268)	(2,439)
유형자산의 처분	4,571	5,577
유형자산의 취득	(2,924,805)	(2,471,284)
무형자산의 처분	214	192
무형자산의 취득	(96,520)	(159,538)
종속기업투자(MMT)의 순증감	(901,129)	(413,703)
종속기업투자(주식)의 처분	2,010	
관계기업투자의 취득	(13,340)	
재무활동현금흐름	(958,278)	4,273,826
차입금의 차입	2,975,632	6,910,011
차입금의 상환	(3,830,795)	(2,588,268)
리스부채의 상환	(134,755)	(50,958)
자기주식의 처분	31,640	3,041
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,362	(3,546)
현금및현금성자산의 순감소	(830,184)	(543,643)
기초현금및현금성자산	2,898,074	1,637,350
분기말 현금및현금성자산	2,067,890	1,093,707

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "회사")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 회사는 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있으며, 경기도 이천시와 충청북도 청주시에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

2024년 3월 31일 현재 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK스퀘어	146,100,000	20.07
기타주주	542,514,914	74.52
자기주식	39,387,451	5.41
합 계	728,002,365	100.00

당분기말 현재 회사의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 록셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 분기재무제표 작성기준

회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2024년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 회사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용 하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비 유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다

(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 분기재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

2.2 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제·개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정 평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

회사는 글로벌최저한세(필라2) 적용대상입니다. 필라2 법률의 시행규칙이 2024년 3월 22일부로 시행되어 필라2 관련 법령이 온전히 법제화됨에 따라, 회사는 동 법령에 기반하여 글로벌최저한세를 산출하고, 법인세비용을 계산 및 반영할 예정입니다. 보다 전문적이고 구체적인 분석과 법인세비용 계산을 위해 회사와 그 종속기업은 외부 세무전문가와 계약을 체결하여 검토를 진행하고 있습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어 집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품의 범주별 분류

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가 치 측정 금융자산:	상각후원가로 측정하 는 금융자산	기타	금융자산, 범주 합계
현금및현금성자산	0	0	2,067,890	0	2,067,890
단기금융상품	222,500	0	50,000	0	272,500
단기투자자산	451,947	0	0	0	451,947

매출채권	0	30,895	3,316,406	0	3,347,301
기타수취채권	0	0	12,474,168	0	12,474,168
기타금융자산	0	0	11	230,675	230,686
장기투자자산	3,674,761	0	0	0	3,674,761
금융자산 합계	4,349,208	30,895	17,908,475	230,675	22,519,253

전기말

(단위 : 백만원)

	당기손익-공정가치 측정 금융자산	기타포괄손익-공정가 치 측정 금융자산:	상각후원가로 측정하 는 금융자산	기타	금융자산, 범주 합계
현금및현금성자산	0	0	2,898,074	0	2,898,074
단기금융상품	222,500	0	50,000	0	272,500
단기투자자산	331,544	0	0	0	331,544
매출채권	0	15,176	3,884,261	0	3,899,437
기타수취채권	0	0	11,971,234	0	11,971,234
기타금융자산	0	0	11	146,578	146,589
장기투자자산	3,765,853	0	0	0	3,765,853
금융자산 합계	4,319,897	15,176	18,803,580	146,578	23,285,231

매출채권 양도와 인식에 대한 설명

회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	당기손익인식금융 부채	상각후원가로 측정 하는 금융부채	기타	금융부채 합계
매입채무	0	2,674,619	0	2,674,619
미지급금	0	3,515,569	0	3,515,569
기타지급채무	0	766,077	0	766,077
차입금	0	25,250,236	0	25,250,236
리스부채	0	2,426,969	0	2,426,969
기타금융부채	1,543,398	0	1,839	1,545,237
금융부채 합계	1,543,398	34,633,470	1,839	36,178,707

전기말

(단위 : 백만원)

	당기손익인식금융 부채	상각후원가로 측정 하는 금융부채	기타	금융부채 합계
매입채무	0	2,410,182	0	2,410,182
미지급금	0	4,736,397	0	4,736,397
기타지급채무	0	817,969	0	817,969
차입금	0	25,425,313	0	25,425,313
리스부채	0	2,386,005	0	2,386,005

기타금융부채	1,477,619	0	1,398	1,479,017
금융부채 합계	1,477,619	35,775,866	1,398	37,254,883

기타지급채무에 대한 설명

기타지급채무 중 종업원급여제도에 따른 회사의 의무에 대응하는 미지급급여 부채는 금융상품 공시 대상이 아니므로 제외되었습니다.

5. 금융위험관리

기능통화 외 환율 변동 위험에 노출되어 있는 금융자산 및 부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	위험				위험 합계
	시장위험				
	환위험				
	기능통화 또는 표시통화			기능통화 또는 표시통	
	USD	JPY	EUR	화 합계	
현지통화, 자산	USD 12,745,000,000	JPY 316,000,000	0		
원화환산, 자산	17,165,153	2,808	0		
현지통화, 부채	USD 16,854,000,000	JPY 81,202,000,000	EUR 7,000,000		
원화환산, 부채	22,699,421	722,278	10,863		
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술				또한, 회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 주석 17에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.	회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율 변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2023년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

위험에 대한 노출정도에 대한 기술				회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.	
--------------------	--	--	--	---	--

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시, 환위험

(단위 : 백만원)

	위험							
	시장위험							
	환위험							
	범위							
	상위범위				하위범위			
	기능통화 또는 표시통화			기능통화 또는 표시통화	기능통화 또는 표시통화			기능통화 또는 표시통화
	USD	JPY	EUR	화 합계	USD	JPY	EUR	화 합계
시장변수 상승 시 법인 세차감전손익 감소	(339,504)	(71,947)	(1,086)					
시장변수 하락 시 법인 세차감전손익 증가					339,504	71,947	1,086	
환율변동				0.01				(0.01)

금융상품의 이자율 유형별 공시

(단위 : 백만원)

	위험		
	시장위험		
	이자율 유형		
	변동이자율		
	금융상품		
	차입금		
	위험회피수단		위험회피수단 합계
	통화이자율스왑계약	이자율스왑 계약	
금융부채	462,963	568,600	

<p>위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술</p>			<p>회사는 현금흐름 이자율 위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 회사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의 차이를 결제하게 됩니다.</p> <p>회사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 회사는 변동금리부 외화차입금 462,963백만원에 대해 통화이자율스왑 계약, 변동금리부 원화차입금 568,600백만원에 대해 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당분기 법인세비용차감전 순이익은 변동하지 않습니다.</p>
-------------------------------------	--	--	--

위험에 대한 노출정도에 대한 기술			회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융자산 등으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.
--------------------	--	--	---

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시, 이자율위험

당분기

(단위 : 백만원)

	위험	
	이자율위험	
	범위	
	상위범위	하위범위
시장변수 상승 시 법인세차감전 손익 감소	(10,663)	
시장변수 하락 시 법인세차감전 손익 증가		10,663
이자율 변동	0.01	(0.01)

전분기

(단위 : 백만원)

	위험	
	이자율위험	
	범위	
	상위범위	하위범위
시장변수 상승 시 법인세차감전 손익 감소	(5,885)	
시장변수 하락 시 법인세차감전 손익 증가		5,885
이자율 변동	0.01	(0.01)

금융상품에서 발생하는 위험의 성격과 정도에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	위험		
	시장위험	신용위험	유동성위험
	기타 가격위험		
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술		<p>신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.</p> <p>회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 회사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 회사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채</p>	<p>유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.</p> <p>회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부담좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.</p>

		<p>권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.</p> <p>현금및현금성자산, 단기금융상품, 단기투자자산 및 장·단기대여금 등으로 구성되는 회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래 상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험 노출 정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 회사는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.</p>	
위험에 대한 노출 정도에 대한 기술	회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.		

부채비율 및 순차입금비율에 대한 공시
당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
부 채 (A)	38,040,954
자 본 (B)	56,486,083
현금및현금성자산 등 (C)	2,792,337
차입금 (D)	25,250,236
부채비율 (A/B)	0.6735
순차입금비율 (D-C)/B	0.3976

자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	<p>회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.</p> <p>자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.</p> <p>주요 차입금 계약상 회사는 일정 수준의 부채비율, 담보채무비율 등을 준수해야 하며, 회사는 당분기말 현재 이러한 조건을 준수하였습니다.</p>
현금및현금성자산 등에 대한 기술	현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
부 채 (A)	38,431,065
자 본 (B)	54,518,322
현금및현금성자산 등 (C)	3,502,118
차입금 (D)	25,425,313
부채비율 (A/B)	0.7049
순차입금비율 (D-C)/B	0.4021
자본관리를 위한 기업의 목적, 정책 및 절차에 대한 비계량적 정보	<p>회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.</p> <p>자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.</p>
현금및현금성자산 등에 대한 기술	현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

자신의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

측정 단계																															
공정가치로 측정되는 금융자산												공정가치로 측정되지 않는 금융자산										측정 단계									
금융자산, 문본																															
단기금융상		단기투자자		매출채권		장기투자자		기타금융자		현금및현금		기타수취재		금융자산 합		단기금융상		단기투자자		매출채권		장기투자자		기타금융자		현금및현금		기타수취재		금융자산 합	
통	산	통	산	통	산	통	산	통	산	통	산	통	산	통	산	통	산	통	산	통	산	통	산	통	산	통	산	통	산	통	산
공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공	공정가	공
치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제	치 서열	제
제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가	제1의	가

[illegible]

전기말 (단위 : 백만원)

전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 125

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 134

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

기타 채권에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
미수금	73,721
미수수익	139,707
단기대여금	1,621,160
단기보증금	37,515
유동 소계	1,872,103
장기미수금	173
장기대여금	10,417,879
보증금	184,013
비유동 소계	10,602,065
합계	12,474,168

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
미수금	42,479
미수수익	136,446
단기대여금	779,197
단기보증금	35,973
유동 소계	994,095
장기미수금	89
장기대여금	10,783,256
보증금	193,794
비유동 소계	10,977,139
합계	11,971,234

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	채권액	대손충당금	장부금액 합계
매출채권	3,347,301	0	3,347,301
기타 유동채권	1,872,142	(39)	1,872,103
기타 비유동채권	10,602,065	0	10,602,065
합계	15,821,508	(39)	15,821,469

전기말

(단위 : 백만원)

	채권액	대손충당금	장부금액 합계
매출채권	3,899,437	0	3,899,437
기타 유동채권	994,134	(39)	994,095
기타 비유동채권	10,977,139	0	10,977,139

합계	15,870,710	(39)	15,870,671
----	------------	------	------------

7. 재고자산

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 백만원)

	취득원가	평가손실총당금	장부금액 합계
상품	50	0	50
제품	3,526,483	(770,562)	2,755,921
재공품	5,623,217	(308,051)	5,315,166
유동원재료	873,096	(28,112)	844,984
저장품	365,568	(38,238)	327,330
미착품	68,327	0	68,327
합계	10,456,741	(1,144,963)	9,311,778

전기말

(단위 : 백만원)

	취득원가	평가손실총당금	장부금액 합계
상품	0	0	0
제품	3,820,794	(869,481)	2,951,313
재공품	5,480,221	(1,023,860)	4,456,361
유동원재료	988,102	(46,316)	941,786
저장품	366,233	(31,826)	334,407
미착품	85,640	0	85,640
합계	10,740,990	(1,971,483)	8,769,507

8. 기타유동자산 및 기타비유동자산

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
선급금	24,164
선급비용	182,780
부가세대급금	256,743
계약자산	139,922
유동 소계	603,609
장기선급금	131,489
장기선급비용	23,228
비유동 소계	154,717
합계	758,326

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
--	------

선급금	21,167
선급비용	137,940
부가세대급금	186,959
계약자산	131,170
유동 소계	477,236
장기선급금	139,886
장기선급비용	27,185
비유동 소계	167,071
합계	644,307

9. 종속기업, 관계기업 및 공동기업

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
종속기업	12,811,584	11,889,950
관계기업 및 공동기업	816,688	804,448
합 계	13,628,272	12,694,398

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
			지분율 (%)	장부금액	지분율 (%)	장부금액
에스케이하이엔지㈜	국내	건설공사 및 서비스	100.00	7,521	100.00	7,521
에스케이하이시스템즈㈜	국내	사업지원 및 서비스	100.00	6,760	100.00	6,760
행복모아㈜	국내	반도체 의료 제조 및 서비스	100.00	37,400	100.00	37,400
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	국내	반도체 제조 및 판매	100.00	404,928	100.00	404,928
행복나래㈜	국내	산업자재 유통	100.00	63,147	100.00	63,147
에스케이이파운드리㈜(*1)	국내	반도체 제조 및 판매	100.00	572,590	100.00	572,590
SK hynix America Inc.	미국	반도체 판매	100.00	52,833	100.00	52,833
SK hynix Deutschland GmbH(SKHYD)	독일	반도체 판매	100.00	22,011	100.00	22,011
SK hynix Asia Pte. Ltd.	싱가포르	반도체 판매	100.00	52,380	100.00	52,380
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.	홍콩	반도체 판매	100.00	32,623	100.00	32,623
SK hynix U.K. Ltd.	영국	반도체 판매	100.00	1,775	100.00	1,775
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	대만	반도체 판매	100.00	37,562	100.00	37,562
SK hynix Japan Inc.	일본	반도체 판매	100.00	42,905	100.00	42,905
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.(*2)	중국	반도체 판매	100.00	4,938	100.00	4,938
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.	인도	반도체 판매	1.00	5	1.00	5
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	중국	반도체 판매	100.00	237	100.00	237
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	중국	반도체 제조	100.00	4,811,147	100.00	4,811,147
SK hynix Italy S.r.l.(*2)	이탈리아	반도체 연구 개발	100.00	-	100.00	-
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.	대만	반도체 연구 개발	100.00	7,819	100.00	7,819

SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC. (*3)	벨라루스	반도체 연구 개발	-	-	99.93	936
SK APTECH Ltd.	홍콩	해외투자법인	100.00	440,770	100.00	440,770
SK hynix Ventures HongKong Ltd.	홍콩	해외투자법인	100.00	66,762	100.00	66,762
Gauss Labs, Inc.	미국	정보통신업	98.32	63,544	98.32	63,544
SK hynix NAND Product Solutions Corp. (*4)	미국	반도체 판매	99.17	2,189,079	99.27	2,189,079
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.	중국	반도체 제조	100.00	1,045,419	100.00	1,045,419
MMT 특정금전신탁 (*5)	국내	특정금전신탁	100.00	2,847,429	100.00	1,924,859
합 계				12,811,584		11,889,950

(*1) 당분기 중 ㈜키피운드리에서 에스케이키피운드리㈜로 사명을 변경하였습니다.

(*2) 당분기 중 청산 절차가 진행 중입니다.

(*3) 당분기 중 청산이 완료되었습니다.

(*4) 당분기 중 SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 그 종속기업의 종업원이 주식선택권을 행사하면서 지분율이 하락하였습니다

(*5) 당분기 중 MMT(특정금전신탁)를 일부 처분하고 신규 취득하였습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
				지분율 (%)	장부금액	지분율 (%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc.(*1)	미국	반도체 부품 개발 및 제조	9.35	395	9.35	395
	SK China Company Limited(*2)	중국	컨설팅 및 투자	11.87	257,169	11.87	257,169
	SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	싱가포르	컨설팅	20.00	345,800	20.00	345,800
	농업회사법인 푸르메소셜팜㈜	국내	기타 작물 재배업	35.52	2,000	35.52	2,000
	엘앤에스 10호 Early Stage III 투자조합	국내	투자	24.39	5,000	24.39	5,000
	SiFive, Inc.(*1)	미국	반도체 설계 및 제조	7.28	35,709	7.28	35,709
	미래에셋위반도체 제1호창업벤처전문사모 투자 합작회사(*3)	국내	투자	29.97	16,300	29.97	17,400
	SK telecom Japan	일본	투자	34.00	2,484	34.00	2,484
	SK Americas, Inc.(*4)	미국	경영자문	20.00	13,340	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. (*5)	중국	반도체 부품 제조	45.00	92,608	45.00	92,608
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁 (*5)	국내	투자	33.33	15,633	33.33	15,633
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모투자신탁 (*5)	국내	투자	37.50	30,000	37.50	30,000
	반도체 생태계 일반 사모 투자신탁 (*5)	국내	투자	33.33	250	33.33	250
합 계					816,688		804,448

(*1) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(*2) 회사의 경영진이 이사회에 참여하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(*3) 당분기 중 1,100백만원 원금 회수하였습니다.

(*4) 당분기 중 신규 취득하였습니다.

(*5) 계약에 의해 중요사항에 대해 만장일치로 의결되도록 규정되어 있어 공동기업으로 분류하였습니다.

10. 유형자산

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	38,974,277
취득	2,802,840
처분 및 폐기	(7,813)
감가상각	(1,861,627)
대체	2,300
기말장부금액	39,909,977

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	43,151,324
취득	1,157,648
처분 및 폐기	(4,379)
감가상각	(2,139,293)
대체	(466)
기말장부금액	42,164,834

담보로 제공된 유형자산에 대한 기술

당분기말 현재 회사의 일부 기계장치는 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 28 참조).

11. 리스

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	1,938,361
증가	117,510
감가상각	(90,724)
기말장부금액	1,965,147

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
--	------

기초장부금액	968,642
증가	200,799
감가상각	(45,094)
기말장부금액	1,124,347

리스부채에 대한 양적 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	2,386,005
증가	117,510
이자비용	22,818
지급	(139,367)
환율변동	40,054
기타	(51)
기말장부금액	2,426,969

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	1,102,084
증가	200,799
이자비용	7,905
지급	(52,676)
환율변동	9,067
기타	0
기말장부금액	1,267,179

12. 무형자산

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	2,928,535
취득	118,610
처분 및 폐기	(12,775)
상각	(109,525)
손상차손	(250)
대체	(2,300)
기말장부금액	2,922,295

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
기초장부금액	2,897,769
취득	430,024
처분 및 폐기	(1,487)
상각	(113,239)
손상차손	0
대체	(381)
기말장부금액	3,212,686

13. 차입금

차입금 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
단기차입금	989,799
유동성장기차입금	1,091,616
유동성사채	3,536,214
소계, 유동	5,617,629
장기차입금	8,225,602
사채	11,407,005
소계, 비유동	19,632,607
합계	25,250,236

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
단기차입금	2,293,036
유동성장기차입금	1,009,469
유동성사채	3,699,540
소계, 유동	7,002,045
장기차입금	8,932,858
사채	9,490,410
소계, 비유동	18,423,268
합계	25,425,313

유동성사채로 분류된 교환사채에 대한 기술

전기 중 회사가 발행한 교환사채를 포함하고 있으며, 교환사채의 만기는 2030년이나 교환권의 행사 가능성으로 인해 유동성사채로 분류하였습니다.

교환사채 발행 조건에 대한 공시

(단위 : 원)

	외화 해외교환사채
사채의 권면총액 (외화금액)	USD 1,700,000,000
표면이자율	0.0175
만기이자율	0.0175
만기일	2030년 04월 11일
원금상환법	1) 만기상환 : 만기까지 교환권 및 조기상환권의 미행사에 따른 잔존 사채원리금에 대해 만기 일시 상환 2) 조기상환 : 회사의 조기상환권(Call Option) 및 사채권자의 조기상환권(Put Option) 존재
교환비율	사채원금의 100%
교환가액	110,033
교환대상	SK하이닉스 주식회사 발행 기명식 보통 주식(자기주식)
교환청구기간	2023년 5월 22일 ~ 2030년 4월 1일
교환가액 조정사항	무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 추가발행, 주식 배당, 현금배당, 기타 자산의 배당, 시가 미만의 신주발행 등과 같은 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정
투자자의 조기상환권(Put Option)	- 납일일로부터 4년 (2027. 04. 11)이 되는 날 - 당사의 지배권 변동(Change of Control)이 발생하는 경우 - 당사 발행주식이 상장폐지되거나 20 연속 거래일 이상 거래정지되는 경우
발행자의 조기상환권(Call Option)	- 2028년 4월 25일 부터 사채만기일 30 영업일 전까지 30 연속거래일 중 20 거래일의 종가가 교환가격의 130% 이상인 경우 - 미상환사채잔액이 총 발행총액의 10% 미만인 경우(Clean Up Call) - 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담사유가 발생하는 경우

14. 기타유동부채 및 기타비유동부채

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
선수수익	45
예수금	67,448
계약부채	221,137

기타	14,619
유동 소계	303,249
장기선수금	14,000
기타장기종업원급여부채	193,779
비유동 소계	207,779
합계	511,028

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
선수수익	45
예수금	74,083
계약부채	209,868
기타	14,137
유동 소계	298,133
장기선수금	14,000
기타장기종업원급여부채	196,679
비유동 소계	210,679
합계	508,812

15. 총당부채

기타총당부채에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	계약손실총당부채	판매보증총당부채	배출부채	복구총당부채	기타총당부채 합계
기초	64,131	252,651	0	1,827	318,609
전입	24,496	18,464	641	0	43,601
사용	0	(2,026)	0	0	(2,026)
기말	88,627	269,089	641	1,827	360,184

총당부채의 성격에 대한 기술	회사는 회사의 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.로부터 Wafer반제품을 구매하고 있으며, 당분기 말 현재 동 종속기업이 생산중인 재공품에 대해서 구매후 추가 가공하여 판매할 경우 예상되는 매출손실을 계약손실총당부채전입액으로 하여 매출원가에 가산하고 총당부채로 인식하고 있습니다.	회사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 총당부채를 인식하고 있으며, 과거 특정 제품의 품질저하 현상과 관련하여 제품 교환 등 회사가 부담할 것으로 예상되는 금액을 별도로 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.	회사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 총당부채로 인식하고 있습니다.		
-----------------	--	---	--	--	--

전분기

(단위 : 백만원)

	계약손실총당부채	판매보증총당부채	배출부채	복구총당부채	기타총당부채 합계
기초	64,555	239,475	1,864	1,827	307,721
전입	102,437	66,119	1,334	0	169,890
사용	0	(8,359)	0	0	(8,359)
기말	166,992	297,235	3,198	1,827	469,252
총당부채의 성격에 대한 기술	회사는 회사의 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.로부터 Wafer반제품을 구매하고 있으며, 당분기 말 현재 동 종속기업이 생산중인 재공품에 대해서 구매후 추가 가공하여 판매할 경우 예상되는 매출손실을 계약손실총당부채전입액으로 하여 매출원가에 가산하고 총당부채로 인식하고 있습니다.	회사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 총당부채를 인식하고 있으며, 과거 특정 제품의 품질저하 현상과 관련하여 제품 교환 등 회사가 부담할 것으로 예상되는 금액을 별도로 추정하여 총당부채로 계상하고 있습니다.	회사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 총당부채로 인식하고 있습니다.		

배출권 수량에 대한 공시

	공시금액
무상할당배출권 수량(단위: 만tCO2-eq)	542
온실가스 배출량 추정치(단위: 만tCO2-eq)	505

배출권 변동내역에 대한 공시

	2023년도분
기초(단위: 만tCO ₂ -eq)	0
무상할당 수량(단위: 만tCO ₂ -eq)	475
매입 수량(단위: 만tCO ₂ -eq)	12
기말(단위: 만tCO ₂ -eq)	487

16. 종업원급여

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
확정급여채무의 현재가치	2,333,553
사외적립자산의 공정가치	(3,603,121)
순확정급여부채(자산)	(1,269,568)
확정급여부채	0
확정급여자산	1,269,568

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
확정급여채무의 현재가치	2,260,225
사외적립자산의 공정가치	(3,631,537)
순확정급여부채(자산)	(1,371,312)
확정급여부채	0
확정급여자산	1,371,312

확정급여자산 인식액에 대한 기술

당분기말과 전기말 현재 확정급여제도의 초과적립액 1,269,568백만원과 1,371,312백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산
기초금액	2,260,225	(3,631,537)
당기근무원가	54,897	
이자원가 (이자수익)	33,005	(53,094)

사용자 기여금		0
관계사전출입액	4,026	(3,014)
퇴직급여지급액	(61,798)	77,229
보험수리적손익	43,198	
재측정요소		7,295
기말금액	2,333,553	(3,603,121)

전분기

(단위 : 백만원)

	확정급여채무의 현재가치	사외적립자산
기초금액	2,032,555	(3,327,486)
당기근무원가	51,785	
이자원가 (이자수익)	31,374	(52,334)
사용자 기여금		50,000
관계사전출입액	14,536	(12,967)
퇴직급여지급액	(71,455)	90,921
보험수리적손익	0	
재측정요소		4,362
기말금액	2,058,795	(3,347,504)

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
당기근무원가	54,897
순이자원가	(20,089)
합계	34,808

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
당기근무원가	51,785
순이자원가	(20,960)
합계	30,825

확정기여제도 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
퇴직급여비용, 확정기여제도	3,169

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
--	------

퇴직급여비용, 확정기여제도	2,499
----------------	-------

17. 파생상품거래

파생상품거래 위험회피수단에 대한 세부 정보 공시

	파생상품 목적의 지정				
	위험회피 목적				
	현금흐름위험회피				
	파생상품 계약 유형				
	통화 관련		통화이자율 관련	이자율 관련	
	고정금리외화사채 (액 면금액 USD 500,000천)	고정금리외화사채 (액 면가액 USD 750,000천)	변동금리외화시설대 출 (액면금액 USD 343,750천)	변동금리시설대출 (액 면금액 KRW 100,000백만)	변동금리시설대출 (액 면금액 KRW 468,600백만)
차입일	2019-09-17	2023-01-17	2019-10-02	2023-04-04	2024-03-07
대상위험	환율변동위험	환율변동위험	환율변동위험 및 이자 율위험	이자율위험	이자율위험
채결기관	국민은행 등 2개은행	국민은행 등 4개은행	산업은행	우리은행	신한은행
계약기간	2019.09.17 ~ 2024.09.17	2023.01.17 ~ 2026.01.17	2019.10.02 ~ 2026.10.02	2023.04.04 ~ 2028.04.04	2024.03.07 ~ 2027.10.18

파생상품거래 위험회피에 대한 세부 정보 공시

(단위 : 백만원)

	파생상품 목적의 지정				
	위험회피 목적				
	현금흐름위험회피				
	파생상품 계약 유형				
	통화 관련	통화이자율 관련	파생금융자산 합계	이자율 관련	파생금융부채 합계
	고정금리외화사채 (액 면금액 USD 1,250,000천)	변동금리외화시설대 출 (액면금액 USD 343,750천)		변동금리시설대출 (액 면금액 KRW 568,600백만)	
파생상품 금융자산	158,108	72,232			
파생상품 금융부채				1,503	
공정가치	158,108	72,232	230,340	1,503	1,503
위험회피수단이 포함 된 재무상태표 항목에 대한 기술			회사가 보유하고 있는 파생금융자산 및 파생 금융부채의 당분기말 공정가치는 재무상태 표의 기타금융자산 및 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같 습니다.		회사가 보유하고 있는 파생금융자산 및 파생 금융부채의 당분기말 공정가치는 재무상태 표의 기타금융자산 및 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같 습니다.

위험회피의 비효과적인 부분을 포함한 포괄손익계산서의 항목을 기술			당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.		당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.
-------------------------------------	--	--	--	--	--

내재파생상품에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	파생상품 금융부채
내재파생상품	1,543,398
위험회피수단이 포함된 재무상태표 항목에 대한 기술	회사가 보유하고 있는 내재파생상품은 재무상태표의 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
복수의 내재파생상품을 포함한 복합금융상품에 대한 공시	회사가 2023년 4월 11일 발행한 교환사채에 부여된 교환권 및 콜옵션, 풋옵션입니다(주석 13 참조).

전기말

(단위 : 백만원)

	파생상품 금융부채
내재파생상품	1,477,619
위험회피수단이 포함된 재무상태표 항목에 대한 기술	회사가 보유하고 있는 내재파생상품은 재무상태표의 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
복수의 내재파생상품을 포함한 복합금융상품에 대한 공시	회사가 2023년 4월 11일 발행한 교환사채에 부여된 교환권 및 콜옵션, 풋옵션입니다(주석 13 참조).

18. 자본금, 자본잉여금, 기타자본 및 기타포괄손익누계액

주식의 분류에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	보통주
수권주식수 (단위:주)	9,000,000,000
액면가액 (단위 : 원)	5,000
보통주 발행주식수 (단위 : 주)	728,002,365
보통주자본금	3,657,652
자기주식(단위 : 주)	39,387,451
유통주식수(단위 : 주)	688,614,914

발행주식수가 감소한 사유에 대한 기술	과거 이익소각으로 인하여 발행주식수가 감소하였습니다.
----------------------	-------------------------------

전기말

(단위 : 백만원)

	보통주
수권주식수 (단위:주)	9,000,000,000
액면가액 (단위 : 원)	5,000
보통주 발행주식수 (단위 : 주)	728,002,365
보통주자본금	3,657,652
자기주식(단위 : 주)	39,863,716
유통주식수(단위 : 주)	688,138,649
발행주식수가 감소한 사유에 대한 기술	과거 이익소각으로 인하여 발행주식수가 감소하였습니다.

그밖의 자본

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
자기주식	(2,245,438)
주식선택권	25,890
기타	(19,031)
합 계	(2,238,579)
자기주식(단위 : 주)	39,387,451
처분한 자기주식수 (단위 : 주)	476,265
자기주식처분이익	28,180

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
자기주식	(2,272,589)
주식선택권	22,327
기타	(19,032)
합 계	(2,269,294)
자기주식(단위 : 주)	39,863,716
처분한 자기주식수 (단위 : 주)	
자기주식처분이익	

자본잉여금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
--	------

주식발행초과금	3,625,797
기타	791,946
합 계	4,417,743

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
주식발행초과금	3,625,797
기타	763,766
합 계	4,389,563

기타포괄손익의 항목별 분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
	파생상품평가손익
기타포괄손익누적액 합계	259

전기말

(단위 : 백만원)

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
	파생상품평가손익
기타포괄손익누적액 합계	5,790

19. 이익잉여금

이익잉여금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
법정적립금	700,967
임의적립금	235,506
미처분이익잉여금	49,712,535
합 계	50,649,008

자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술	회사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다. 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다. 2024년 3월 27일자 주주총회에서 배당금 206,442백만원이 결의되었으며, 당분기 말 현재 미지급배당금은 미지급금에 포함되어 있습니다.
주주총회에서 결의된 배당금	206,442

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
법정적립금	618,395
임의적립금	235,506
미처분이익잉여금	47,880,710
합 계	48,734,611
자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술	회사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다. 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.
주주총회에서 결의된 배당금	

20. 매출액

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
제품 등의 판매	10,367,505
용역의 제공	34,314
합 계	10,401,819

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
제품 등의 판매	4,406,536
용역의 제공	36,939
합 계	4,443,475

고객과의 계약에서 생기는 수익의 품목별 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	DRAM	NAND Flash	기타	제품과 용역 합계
수익(매출액)	7,481,860	2,705,339	214,620	10,401,819

전분기

(단위 : 백만원)

	DRAM	NAND Flash	기타	제품과 용역 합계
수익(매출액)	3,213,116	1,102,866	127,493	4,443,475

고객과의 계약에서 생기는 수익인식의 시점 구분에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	한 시점에 이행	기간에 걸쳐 이행	재화나 용역의 이전 시 기 합계
수익(매출액)	10,367,505	34,314	10,401,819

전분기

(단위 : 백만원)

	한 시점에 이행	기간에 걸쳐 이행	재화나 용역의 이전 시 기 합계
수익(매출액)	4,406,536	36,939	4,443,475

21. 판매비와관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
급여	165,757
퇴직급여	8,039
복리후생비	31,375
지급수수료	92,847
감가상각비	47,885
무형자산상각비	49,283
광고선전비	12,756
소모품비	15,470
품질관리비	22,223
수도광열비	7,769
기타	48,237
소계	501,641
연구개발비 총지출액, 판관비	999,020
개발비 자산화	(80,420)
경상개발비	918,600

판매비와관리비	1,420,241
---------	-----------

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
급여	86,507
퇴직급여	7,461
복리후생비	35,270
지급수수료	109,875
감가상각비	49,810
무형자산상각비	48,219
광고선전비	8,717
소모품비	13,303
품질관리비	42,316
수도광열비	8,147
기타	43,560
소계	453,185
연구개발비 총지출액, 판관비	905,447
개발비 자산화	(148,993)
경상개발비	756,454
판매비와관리비	1,209,639

22. 비용의 성격별 분류

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품의 변동	(663,412)
원재료, 저장품 및 소모품 사용	2,724,320
종업원급여비용	1,273,868
감가상각비 등	2,046,451
지급수수료	587,304
동력 및 수도광열비	488,056
수선비	283,456
외주가공비	453,962
기타영업비용	392,509
대체: 개발비자산화 등	(85,765)
합계	7,500,749

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
제품 및 재공품의 변동	(1,402,131)

원재료, 저장품 및 소모품 사용	2,885,590
종업원급여비용	850,092
감가상각비 등	2,296,212
지급수수료	619,556
동력 및 수도광열비	515,205
수선비	194,322
외주가공비	431,288
기타영업비용	484,951
대체: 개발비자산화 등	(155,069)
합계	6,720,016

성격별 비용에 대한 기술

분기포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

23. 금융수익 및 금융비용

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
이자수익	230,360
배당금수익	9,752
외환차이	923,697
기타	5,135
금융수익 소계	1,168,944
이자비용	336,671
외환차이	1,174,623
기타	1,026
금융비용 소계	1,512,320
순금융손익	(343,376)
장기투자자산 환율변동효과	(92,201)

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
이자수익	165,819
배당금수익	93,326
외환차이	766,891
기타	5,975
금융수익 소계	1,032,011
이자비용	223,790
외환차이	754,761

기타	715
금융비용 소계	979,266
순금융손익	52,745
장기투자자산 환율변동효과	156,722

외환차이에 대한 기술

당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 (-) 92,201백만원(전분기: 156,722백만원)이 포함되어 있습니다.

24. 기타영업외수익과 기타영업외비용

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
유형자산처분이익	6,789
무형자산처분이익	13,128
종속기업및관계기업투자처분이익	21,441
기타	4,038
기타영업외수익 합계	45,396
무형자산처분손실	5,952
기부금	3,762
기타	2,347
기타영업외비용 합계	12,061

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
유형자산처분이익	2,638
무형자산처분이익	0
종속기업및관계기업투자처분이익	13,807
기타	850
기타영업외수익 합계	17,295
무형자산처분손실	1,314
기부금	253
기타	1,774
기타영업외비용 합계	3,341

25. 법인세비용

법인세비용 산정 및 인식에 대한 기술

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정
 정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조
 정사항이 포함되어 있습니다.

26. 주당이익

주당이익

당분기

(단위 : 백만원)

	보통주
보통주분기순이익(손실)	2,171,332
가중평균유통보통주식수 (단위 : 주)	688,306,127
기본주당이익 (단위 : 원)	3,155
발행주식수 (단위: 주)	728,002,365
자기주식 효과 (단위 : 주)	(39,696,238)
주식보상비용(세후)	1,620
보통주회석분기순이익(손실)	2,172,952
가중평균회석유통보통주식수 (단위 : 주)	688,946,675
회석주당이익 (단위:원)	3,154
주식선택권 효과	640,548
교환사채 발행에 따른 잠재적 회석효과 주식수 (단위: 주)	20,336,717
교환사채 발행에 따른 잠재적 회석효과 주식수에 대한 기술	교환사채 발행에 따른 잠재적 회석효과 20,336,717주 등이 있지만, 당기 반회석효과로 인하여 회석주당손익을 계산할 때 고려하지 않았 습니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	보통주
보통주분기순이익(손실)	(1,296,209)
가중평균유통보통주식수 (단위 : 주)	687,884,807
기본주당이익 (단위 : 원)	(1,884)
발행주식수 (단위: 주)	728,002,365
자기주식 효과 (단위 : 주)	(40,117,558)
주식보상비용(세후)	0
보통주회석분기순이익(손실)	(1,296,209)
가중평균회석유통보통주식수 (단위 : 주)	687,884,807
회석주당이익 (단위:원)	(1,884)
주식선택권 효과	0
교환사채 발행에 따른 잠재적 회석효과 주식수 (단위: 주)	

27. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
종속기업	SK hynix America Inc.외 58사(*1),(*)2)
관계기업(*3)	Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd., Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsources), 농업회사법인 푸르메소셜팜㈜, 우시시신파직접회로산업원유한공사, 미래에셋워반도체 제1호창업벤처전문사모투자합작회사, 엘엔에스 10호 Early Stage III 투자조합, SiFIVE Inc., YD-SK-KDB 소셜밸류, Ningbo Zhongxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership), 강소KVTs반도체과학기술유한회사, SAPEON INC., SK Telecom Japan, SK America, Inc.
공동기업(*4)	Hitech Semiconductor(Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., 반도체성장 전문투자형 사모투자신탁, 시스템반도체 상생 전문투자형 사모투자신탁, 반도체 생태계 일반 사모 투자신탁
기타특수관계자	회사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK스퀘어㈜ 및 그 종속기업과 SK스퀘어㈜의 지배기업인 SK㈜와 그 종속기업

(*)1) 종속기업의 종속기업 등이 포함되어 있으며, 종속기업인 MMT(특정금전신탁)는 제외하였습니다.

(*)2) 당분기 중 SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.의 청산이 완료됨에 따라 제외되었습니다.

(*)3) 종속기업의 관계기업이 포함되어 있습니다.

(*)4) 종속기업의 공동기업이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지배기업	비고
에스케이하이이엔지㈜	회사	건설공사 및 서비스
에스케이하이시스템즈	회사	사업지원 및 서비스
행복나래㈜	회사	산업자재 유통
행복모아㈜	회사	반도체 의류 제조, 제빵 및 서 비스
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	회사	반도체 연구개발 및 서비스
SK hynix America Inc.	회사	반도체 판매
SK hynix Deutschland GmbH	회사	반도체 판매
SK hynix Asia Pte.Ltd.	회사	반도체 판매
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	회사	반도체 판매
SK hynix Japan Inc.	회사	반도체 판매
SK hynix U.K. Ltd.	회사	반도체 판매
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.	SK hynix Asia Pte. Ltd.	반도체 판매
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.	회사	반도체 판매
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	회사	반도체 판매
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	회사	반도체 판매
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	회사	반도체 제조
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	SK APTECH Ltd.	반도체 제조

SK APTECH Ltd.	회사	해외투자법인
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.	회사	해외투자법인
SK hynix Italy S.r.l	회사	반도체 연구개발
SK hynix memory solutions America Inc.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.	회사	반도체 연구개발
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외투자법인
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	해외병원자산법인
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	해외병원운영법인
SK hynix cleaning (Wuxi) Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	기업 건물 관리 등
SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.	에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	반도체 제조 및 판매
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.	행복나래㈜	해외 산업자재유통
CHONGQING HAPPYNARAE Co. Ltd.	SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.	해외 산업자재유통
SK hynix (Wuxi) Education Technology Co.,Ltd	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	교육법인
SkyHigh Memory Limited	에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	반도체 제조 및 판매
Gauss Labs Inc.	회사	정보통신업
SkyHigh Memory China Limited	SkyHigh Memory Limited	반도체 판매
SkyHigh Memory Limited Japan	SkyHigh Memory Limited	반도체 판매
HappyNarae America LLC	행복나래㈜	해외 산업자재유통
HappyNarae Hungary Kft	행복나래㈜	해외 산업자재유통
SK Hynix (Wuxi) Education Service Development Co., Ltd.	SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.	교육법인
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	회사	반도체 판매 및 연구개발 등
SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발 및 판매
SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발
SK hynix NAND Product Solutions Mexico, S. DE R.L. DE C.V.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.	회사	반도체 제조
SK hynix NAND Product Solutions UK Limited	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions Japan G.K.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions International LLC	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK HYNIX NAND PRODUCT SOLUTIONS POLAND sp. z o.o.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발
SK hynix NAND Product Solutions (Beijing) Co.,	SK hynix NAND Product Solutions	반도체 판매

Ltd.	Corp.	
SK Hynix NAND Product Solutions (Shanghai) Co., Ltd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발
에스케이이파운드리㈜	회사	반도체 제조 및 판매
SK KEYFOUNDRY, INC.	에스케이이파운드리㈜	반도체 판매
SK Keyfoundry Shanghai Co.,Ltd.	에스케이이파운드리㈜	반도체 판매
KEY FOUNDRY LTD.	에스케이이파운드리㈜	반도체 판매
Intel NDTM US LLC(*)	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발
Intel Semiconductor Storage Technology (Dalian) Ltd.(*)	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 제조
SK hynix America Investment Corporation	SK hynix America Inc.	해외투자자문

(*) 당분기말 현재 법적소유권은 인텔에게 있으며 2025년으로 예상되는 인텔 NAND 사업 2차 종결을 통하여 소유권을 획득할 예정이나 당분기말 현재 회사의 종속회사인 SK hynix NAND Product Solutions Corp.가 지배력을 보유하고 있다고 판단하여 종속기업으로 편입하였습니다.

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

현재 특수관계자																									현재 특수 관계자 합계			
기타특수관계자																												
종속기업				관계기업		공동기업		기타특수관계자																				
	국내총회 기업	해외판매 법인	해외제조 법인	해외연구 개발법인	SK China Company Limited	SK telecom Japan Co., Ltd.	HITECH Semicon ductor (Wuxi) Co., Ltd.	SK텔레콤 ㈜	SK에코플 ㈜	SK에너지 스㈜	SK네트웍 스㈜	SK엔솔스 스㈜	충청에너지 지서비스 스㈜	SK스마트 타워 스㈜	SK실트론 스㈜	SK메타리 알조앤에 플라스 스㈜	Techdrea m Co., Ltd.	SK트리플 스㈜	SK윌다스 (주)	SK이노베 이션스 스㈜	에스케이 위탁관리 부동산부 지회사 지회사	스트리얼 위탁관리 부동산부 지회사 지회사	SK E&S Trading Pte., Ltd.	SK LNG 그 밖의 특수관계 자 기타				
매출 등	47,062	10,163.7 26	201,637	27	0	0	3,290	124	3,863	1	633	0	0	0	0	1,209	19	0	0	70	0	0	0	10	0	17	10,421.6 88	
매입 등	227,347	20,648	1,508,127	49,703	3,535	917	165,038	12,796	64,505	0	42,785	1,531	15,009	18,297	31,190	64,182	24,821	22,546	21,303	23,129	20,511	1,642	7,628	7,547	74,564	19,092	2,448,193	
자산취득	12,370	0	20,675	0	0	0	8,525	93	7,354	69,238	0	0	0	10	61	0	0	98,200	0	0	1,855	78	0	0	0	19,092	3,296	240,847

[illegible]

전체 특수관계자																							전체 특수 관계자 합계			
기타특수관계자																										
종속기업				관계기업		공동기업		기타특수관계자																		
기업	법인	법인	개발법인	SK China Company Limited	SK Telecom Japan	HITECH Semicon ductor (Wuxi) Co., Ltd.	SK텔레콤 ㈜	SK㈜	SK에코플 랜드㈜	SK에너지 ㈜	SK네트웍 ㈜	SK연방스 지서비스 ㈜	SK스피션 티㈜	SK실드론 ㈜	SK대리리 알츠메어 물런스㈜	Techdrea m Co., Ltd.	SK트리플 (주)	SK윌더스 미션㈜	엑스케이 위탁관리 부동산부 지회사㈜	클린인더 스트리얼 위탁관리 부동산부 지회사 주 식회사	SK E&S㈜ Trading Pte., Ltd.	그 밖의 특수관계 자 기타				
매출 등	39,364	4,370.55 2	144,031	30	0	2,239	35	3,667	1	731	0	0	0	8	2,031	8	0	0	61	0	0	0	1	4,562.75 9		
매입 등	219,993	93,136	1,560.47 6	44,168	2,771	152,633	11,830	47,670	0	71,337	3,022	32,211	27,866	38,754	79,191	12,857	34,826	31,386	23,291	29,356	1,578	4,096	8	14,749	2,536.99 7	
자산취득	8,572	116,856	3,803	0	0	129,474	0	2,713	20,039	18,700	0	18	0	0	0	50,205	0	0	0	0	35	0	0	6,962	0	357,377

[illegible][illegible]

[illegible]

	국내총생산	해외판매	해외제조	해외판매 및 해외제조	SK hynix HAND Product Solution s Corp., Limited	SK China Company Japan Co., Ltd.	HITECH Semicon ductor (Wuxi) Co., Ltd.	SK텔레콤	SK증권	SK에코	SK에너지	SK네트웍스	SK증권	충청에너지 지서비스	SK스틸	SK건설	SK(태타) 리얼즈	Techdne am Co., Ltd.	SK트리	SK윌더	SK(이노) 비이선	메스케이 스트라벨	SK Trading Pte., Ltd.	SK LNG 그 밖의 특수관계 자 기타	합계
매출차관 금	4,098	7,132,839	8,186,193	81	6	0	944	1,416	0	75	0	0	0	0	138,658	7	0	0	24	210	17,330	0	0	1,307	15,483.179
미지급금 금	94,297	334,416	1,457,828	33,763	380,520	13,567	12,606	109,166	326,831	35,750	7,093	27,820	5,887	15,470	31,902	515,618	1,979	10,698	26,877	6,324	162,557	605,333	391	35,421	4,377.460
매출차관 금에 대한 대 여금				11,319.643																					
매출차관 금에 대한 대 여금에 대한 기 타 금 부 속 금 액				매출차관 금에 대한 대 여금 11,319.643 백만원 이 모름 되어 있습니다. 니다.																					
외국환고 입 금 부 속 금 액					USD 71,000.000																				

[illegible]

주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
급여	2,414
퇴직급여	439
주식보상비용	0
합계	2,853
주요 경영진에 대한 보상에 대한 기술	주요 경영진은 회사의 계획·운영·통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가진 등기 임원입니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자
	특수관계자
	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
급여	1,615
퇴직급여	168
주식보상비용	1,145

합계	2,928
주요 경영진에 대한 보상에 대한 기술	주요 경영진은 회사의 계획 · 운영 · 통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가진 등기 임원입니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

대규모기업집단소속회사거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자				
	특수관계자				
	대규모기업집단소속회사				
	에스엠코어㈜	SK바이오사이언스㈜	SK케미칼㈜	기타 대규모집단 소속 회사	합계
매출 등	0	23			23
매입 등	276	0			276
자산취득					

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자				
	특수관계자				
	대규모기업집단소속회사				
	에스엠코어㈜	SK바이오사이언스㈜	SK케미칼㈜	기타 대규모집단 소속 회사	합계
매출 등	0		0	0	0
매입 등	1,986		311	2	2,999
자산취득	296		0	0	296

대규모기업집단소속회사거래 중 채권 채무에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	대규모기업집단소속회사		
	에스엠코어㈜	SK바이오사이언스㈜	합계
매출채권 등	0	15	15
미지급금 등	517	0	517

전기말

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자		
	특수관계자		
	대규모기업집단소속회사		
	에스엠코어㈜	SK바이오사이언스㈜	합계

매출채권 등			
미지급금 등	1,543		

특수관계자리스거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	공동기업	기타특수관계자
	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. 및 Hystars Semiconductor(Wuxi) Co., Ltd.	SK머티리얼즈 에어플러스(주) 등
사용권자산	8,447	100,789
리스부채	8,447	100,789
지급한 리스료	19,676	41,075

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자	
	특수관계자	
	공동기업	기타특수관계자
	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. 및 Hystars Semiconductor(Wuxi) Co., Ltd.	SK머티리얼즈 에어플러스(주) 등
사용권자산	127,150	68,941
리스부채	127,150	68,941
지급한 리스료	15,966	18,963

특수관계자자금거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자				전체 특수관계자 합 계
	특수관계자				
	종속기업		관계기업	기타특수관계자	
	국내종속기업	해외제조법인	매그너스사모투자합 자회사	SK스퀘어(주)	
대여금의 대여					
대여금의 회수					
배당금수익	8,630			0	8,630
배당금지급	0			43,830	43,830
특수관계자자금거래 에 대한 기술					

전분기

(단위 : 백만원)

	전체 특수관계자				전체 특수관계자 합 계
	특수관계자				
	종속기업		관계기업	기타특수관계자	
	국내종속기업	해외제조법인	매그너스사모투자합 자회사	SK스퀘어(주)	
대여금의 대여	0	641,950	0	0	641,950
대여금의 회수	124,080	0	0	0	124,080
배당금수익	93,014	0	262	0	93,276
배당금지급	0	0	0	43,830	43,830
특수관계자자금거래 에 대한 기술					전분기 중 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. 및 SK hynix Nand Product Solutions Corp에 대여하였습니다.

28. 우발부채와 약정사항

우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	법적소송우발부채
유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실 성 정도, 우발부채	<p>중국 반독점법 위반 조사 2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 회사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.</p> <p>소송 및 특허 클레임 등 당분기말 현재 회사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.</p>

담보로 제공된 유형자산에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	유형자산	
	기계장치	
	기능통화 또는 표시통화	기능통화 또는 표시통화

	USD	KRW	합계
담보로 제공된 유형자산			865,694
원화 담보설정액	1,272,726	450,000	
외화 담보설정액	USD 945,000,000	0	
원화 담보채무액	867,003	466,667	
외화 담보채무액	USD 644,000,000	0	
차입금 종류			시설자금대출 관련

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	거래상대방			
	하나은행 등			
	약정의 종류			
	Usance 등 수입금 융약정	수입 · 수출 포괄한 도약정	당좌차월	상환청구권이 없는 매출채권팩토링약 정
약정한도금액, KRW			20,000	70,000
약정한도금액, USD	USD 480,000,000	USD 1,600,000,000		

유형자산을 취득하기 위한 약정액에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
유형자산을 취득하기 위한 약정액	10,730,072
유형자산을 취득하기 위한 약정에 대한 설명	당분기말 현재 기표되지 않은 유무형자산에 대한 구매 약정액은 10,730,072백만원(전기말: 11,882,351백만원)입니다.

전기말

(단위 : 백만원)

	공시금액
유형자산을 취득하기 위한 약정액	11,882,351
유형자산을 취득하기 위한 약정에 대한 설명	당분기말 현재 기표되지 않은 유무형자산에 대한 구매 약정액은 10,730,072백만원(전기말: 11,882,351백만원)입니다.

사업결합에서 비롯된 우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	인텔 NAND
과거 사업결합 양수도금액 (외화)	USD 8,844,000,000
<p>관련된 미래사건에 대한 주요한 가정에 대한 기술, 사업결합에서 비롯된 우발부채</p>	<p>인텔 NAND 사업 인수</p> <p>회사는 2020년 중 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옴테인 사업을 제외한 NAND 사업 전체(이하 "인텔NAND사업")를 인수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 해당 사업은 해외 종속기업들을 통해 두 번에 나뉘어 이전되며, 양수도금액은 USD8,844백만으로 1차 종결 시점에 USD6,609백만을 지급하였으며, 잔금 USD2,235백만은 2차 종결이 예상되는 2025년 3월까지 지급될 예정입니다. 본 거래의 2차 종결은 정부기관의 심의를 포함하여 계약에서 정한 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있으며, 특정 상황으로 계약 해지시 약정된 termination fee를 지급해야 합니다. 한편 회사는 2차 거래종결이 이루어지지 않을 가능성은 낮다고 판단하고 있습니다.</p> <p>회사는 2021년 중 완료된 인텔 NAND 사업 인수 1차 종결과 관련하여 중국 경쟁당국(중국 국가시장감독관리총국)으로부터 해당 인수거래에 대한 기업결합승인을 취득하는 과정에서 향후 5년간 중국 eSSD 시장에서 합리적인 가격정책을 유지하고 생산량을 확대할 의무 및 중국 eSSD 시장에 제3의 경쟁사가 진입하는 것을 지원해 줄 의무 등을 주요 내용으로 하는 조건들을 부과받은 바 있습니다. 따라서, 회사는 향후 5년간 동 의무들을 준수하여야 하며, 5년 후 동 의무들을 면제해 줄 것을 신청할 수 있습니다. 회사가 이와 같은 신청을 할 경우 중국 경쟁당국은 중국 eSSD 시장에서의 경쟁상황을 고려하여 동 신청을 수용할지를 결정할 것입니다.</p>

우발채무 및 약정사항에 대한 추가 정보 기술

- HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와의 후공정서비스계약
회사는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 회사는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 금액을 지급하고 있습니다.

- KIOXIA Holdings Corporation(이하 "KIOXIA") 투자
장기투자자산에 포함된 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P. 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited에 대한 투자를 통한 KIOXIA 투자와 관련하여 지분취득일 이후 일정기간 동안 회사의 직·간접적인 KIOXIA 보유지분이 특정비율 이하로 제한됩니다. 또한, 회사는 동 기간동안 KIOXIA에 대한 이사임명권이 제한되며, 경영 및 영업 의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 없습니다.

- 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 2022년 10월 7일 고성능반도체의 중국 수출과 중국 내 반도체 생산 및 생산장비와 관련된 제한을 강화하는 신규 수출 규제를 발표하였습니다. 회사는 중국 내 반도체 공장의 원활한 운영을 위해 미국 정부와 적극적으로 논의를 하였고, 2023년 10월 10일까지 1년 동안 위 수출규제의 적용을 유예 받았습니다. 이 후, 2023년 9월 29일 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 현재 회사의 중국 내 반도체 공장을 VEU(Validated End-User, 검증된 사용자)로 지정하여 지정된 품목에 대하여는 별도의 허가절차 및 유효기간 없이 수입이 가능하도록 허가하였습니다.

29. 현금흐름표

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
분기순이익(손실)	2,171,332
법인세비용(수익)	419,697
이자비용	336,671
이자수익	(230,360)
배당금수익	(9,752)
감가상각비	1,952,354
무형자산상각비	109,525
퇴직급여	34,808
종속기업및관계기업투자처분이익	(21,441)
외화환산손실	918,465
외화환산이익	(576,106)
기타	51,372
매출채권의 감소(증가)	574,238
재고자산의 증가	(542,271)
기타자산의 감소(증가)	(116,749)
매입채무의 증가(감소)	238,765
미지급금의 증가(감소)	(1,369,540)
기타지급채무 증가(감소)	322,998

총당부채의 증가	41,575
기타	9,371
영업으로부터 창출된 현금	4,314,952

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
분기순이익(손실)	(1,296,209)
법인세비용(수익)	(913,633)
이자비용	223,790
이자수익	(165,819)
배당금수익	(93,326)
감가상각비	2,184,391
무형자산상각비	113,239
퇴직급여	30,825
종속기업및관계기업투자처분이익	(13,807)
외화환산손실	577,364
외화환산이익	(463,632)
기타	(3,786)
매출채권의 감소(증가)	539,331
재고자산의 증가	(1,343,852)
기타자산의 감소(증가)	182,971
매입채무의 증가(감소)	110,706
미지급금의 증가(감소)	14,291
기타지급채무 증가(감소)	(885,819)
총당부채의 증가	165,260
기타	(23,255)
영업으로부터 창출된 현금	(1,060,970)

주요 비현금거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
배당금 관련 미지급금 증가	206,442

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
배당금 관련 미지급금 증가	206,295

현금의 유입과 유출 항목의 순증감액 표기에 대한 설명

회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기투자자산 및 MMT관련 종속
기업투자주식 등으로 인한 현금의 유입과 유출 항목을 순증감액으로 표시하였습니다.

30. 주식기준보상

주식기준보상액의 조정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

주식기준보상액																		
선택형 주식기준보상															주식규제형 주식기준보상			
	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차	10차	11차	12차	13차	14차	선택형 주식기준 보상 합계	1~1차	1~2차	2차
총부여수량 (단 위: 주)	99,600	99,600	99,600	7,747	7,223	8,171	61,487	61,487	61,487	54,020	6,397	6,469	75,163	195,460	843,911			
주식기준보상액 정해 따라 소멸 된 주식선택권의 수량(단위: 주)	-	-	-	-	-	8,171	-	-	-	10,764	-	-	29,851	59,167	107,953			
주식기준보상액 정해 따라 당기 중 소멸된 주식 선택권의 수량 (단위: 주)														39,546				
행사수량 (단위: 주)	99,600	99,600	99,600	7,747	7,223	0	61,487	61,487	61,487	5,193	0	0	0	0	503,424			
미행사수량 (단 위: 주)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,063	6,397	6,469	45,312	136,293	232,534			
부여일	2017.03.24	2017.03.24	2017.03.24	2018.01.01	2018.03.28	2019.02.28	2019.03.22	2019.03.22	2019.03.22	2020.03.20	2020.03.20	2021.03.30	2021.03.30	2022.03.30		2022.03.17	2022.04.27	2023.06.28
악종종목공개 간	2017.03.24 ~ 2019.03.24	2017.03.24 ~ 2020.03.24	2017.03.24 ~ 2021.03.24	2018.01.01 ~ 2019.12.31	2018.03.28 ~ 2020.03.28	2019.02.28 ~ 2021.02.28	2019.03.22 ~ 2021.03.22	2019.03.22 ~ 2021.03.22	2019.03.22 ~ 2022.03.22	2020.03.20 ~ 2023.03.20	2020.03.20 ~ 2023.03.20	2021.03.30 ~ 2023.03.30	2021.03.30 ~ 2023.03.30	2022.03.30 ~ 2024.03.30		부여일 이후 2년 이상 재직	부여일 이후 2년 이상 재직	2023년 1월 1일 이후 3년 이상 재직
행사가능기간	2019.03.25 ~ 2022.03.24	2020.03.25 ~ 2023.03.24	2021.03.25 ~ 2024.03.24	2020.01.01 ~ 2022.12.31	2020.03.29 ~ 2023.03.28	2021.03.01 ~ 2024.02.29	2021.03.23 ~ 2024.03.22	2022.03.23 ~ 2025.03.22	2023.03.23 ~ 2026.03.22	2023.03.21 ~ 2027.03.20	2023.03.21 ~ 2027.03.20	2023.03.31 ~ 2026.03.30	2023.03.31 ~ 2026.03.30	2024.03.31 ~ 2027.03.30		2025년 3월 17일 부터 2029년 3월 17일 까지	2025년 4월 27일 부터 2029년 4월 27일 까지	2026년 1월 1일 당시 지점
행사가격 (단위: 원)	48,400	52,289	56,460	77,440	83,060	73,430	71,560	77,290	83,470	84,730	84,730	136,060	136,060	121,610				
주식선택권으로 발행한 주식의 종류에 대한 기 율																기명식 보통주식	기명식 보통주식	기명식 보통주식
주식기준보상액 정의 결제방식에 대한 기술			현금결제 방식으 로 명시되었습니다. 다.							현금결제 방식으 로 명시되었습니다. 다.				현금결제 방식으 로 명시되었습니다. 다.		자기주식 교부	자기주식 교부	자기주식 교부
부여주식수																최초부여규모 + TSR + 조정비율 / 행사일 추가	최초부여규모 + TSR + 조정비율 / 행사일 추가	최초부여수량 + (조정비율 + 주 가상승률 - KOSPI200 상승 률)
기준주가 (단위: 원)																124,000	108,500	79,975

부여주식수 산정에 적용되는 변수에 대한 기술

TSR(총주주수익률)은 (행사 통지일 주가 - 기준주가 + 부여일부터 권리행사통지일까지의 회사의 주당 총 배당금액)/기준주가로 계산되며, 조정비율은 동종업계 TSR 대비 자사 TSR을 고려합니다.

조정비율은 주가상승률을 고려하며, 최초부여규모 대비 지급수량의 상한은 2배입니다. 주가상승률 100% 상승 및 KOSPI200 상승률 대비 50%p 초과 상승 시 최초부여규모만큼의 주식을 추가로 지급합니다.

1-1차 및 1-2차 주식기준보상 중 일부를 취소하고 2차 주식기준보상에서 대체 부여한 수량이 있습니다.

2년 이상 3년 미만 재직 시 근무기간에 비례하여 부여 수량을 조정합니다.

재무상태에 미치는 주식기준보상거래의 영향에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	공시금액
주가차액보상권 부채 총장부금액	16,728

회계기간에 부여된 주식선택권의 공정가치에 기초하여 간접측정한 재공받은 재화나 용역의 공정가치에 대한 공시

(단위 : 백만원)

	주식기준보상액정							주식결재형 주식기준보상			
	선택형 주식기준보상							주식결재형 주식기준보상			
	3차	10차	11차	12차	13차	14차	선택형 주식기준보상 합계	1-1차	1-2차	2차	주식결재형 주식기준보상 합계
옵션가격결정요인에 대한 기술, 부여한 주식선택권	이항모형	이항모형	이항모형	이항모형	이항모형	이항모형		이항모형	이항모형	이항모형	
주가(평가기준일 종가) (단위: 원)	133,900	133,900	133,900	133,900	133,900	133,900		0	0	0	
기대주가변동성	0.3310	0.3310	0.3310	0.3310	0.3310	0.3310		0.3392	0.3422	0.3481	
주당공정가치(단위: 원)	77,595	59,412	59,412	28,292	28,292	39,805		52,729	42,064	155,443	
배당수익률	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008		0.000	0.000	0.015	
무위험이자율 (국공채 수익률)	0.0354	0.0360	0.0360	0.0355	0.0355	0.0360		0.0265	0.0319	0.0360	
그 밖의 특성이 공정가치를 측정할 때 모형을 반영되었는지 여부와 반영된 경우 그 방법에 관한 정보, 부여한 주식선택권											1-1차, 1-2차 TSR 계산 시 행사기간까지의 배당금액이 가산됨에 따라 배당에 따른 추가하락분이 보전된다고 보아 배당성향은 고려하지 않았습니다.

주식보상비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
주식보상비용	2,796

전분기

(단위 : 백만원)

	공시금액
주식보상비용	2,927

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 정책

- 정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

(1) 제10조의6 (동등배당)

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

(2) 제52조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당할 수 있다.

(3) 제54조의2 (분기배당)

① 회사는 주주에게 자본시장과 금융투자에 관한 법률의 규정에 의한 분기배당을 금전으로 할 수 있다.

② 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 분기배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 자본시장과 금융투자에 관한 법률, 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

⑥ 제53조는 분기배당의 경우에 준용한다.

당사는 2022년 1월 이사회를 통해, 배당의 예측 가능성 확보하고 실적의 변동성을 반영하기 위한 「2022~2024년 주주환원정책」을 다음과 같이 수립하여 공시하였습니다.

* 관련 공시 : 2022년 1월 28일 수시공시의무관련사항(공정공시)

[2022~2024 사업연도의 연간 현금배당 산식]

주당 1,200원 (고정배당금) + 연간 Free Cash Flow의 5% 지급

(연간 Free Cash Flow가 마이너스(-)일 경우, 고정배당금만 지급)

[Free Cash Flow 산식]

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

※ 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제77기 1분기	제76기	제75기
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		1,919,251	-9,112,428	2,229,560
(별도)당기순이익(백만원)		2,171,332	-4,836,170	2,790,457
(연결)주당순이익(원)		2,788	-13,244	3,242
현금배당금총액(백만원)		206,584	825,721	825,181
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		10.8	-	37.0
현금배당수익률(%)	보통주	0.2	0.9	1.5
	우선주	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	300	1,200	1,200
	우선주	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

※ 상기 금액은 연결재무제표 기준이며, 연결당기순이익 및 연결현금배당성향은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익 기준으로 산정하였습니다.

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
7	10	1.2	1.1

※ 배당수익률 : 제76기 0.9%, 제75기 1.5%, 제74기 1.2%, 제73기 1.0%, 제72기 1.1%

※ 평균 배당수익률은 단순 평균법으로 계산하였으며, 최근 3년간은 제74기(2021년)부터 제76기(2023년)까지, 최근 5년간은 제72기(2019년)부터 제76기(2023년)까지 기간입니다.

※ 연속 배당 횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.

※ 당사는 2014년(제67기)부터 연속 결산배당 중이며, 분기배당은 2022년(제75기) 1분기부터 시작하였습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등

※ 연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자 등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2024년 01월 02일	300,000	4.98	A1 (한기평/한신평/Nice신평)	2024년 03월 29일	상환	신한은행
SK하이닉스㈜	회사채	사모	2024년 01월 16일	673,400	5.50	BBB-(S&P) BBB(Fitch) Baa2(Moody's)	2027년 01월 16일	미상환	BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, JP Moorgan, MUFG, KDB, Mizuho
SK하이닉스㈜	회사채	사모	2024년 01월 16일	1,346,800	5.50	BBB-(S&P) BBB(Fitch) Baa2(Moody's)	2029년 01월 16일	미상환	BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, JP Moorgan, MUFG, KDB, Mizuho
SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2024년 01월 16일	150,000	4.89	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 04월 16일	미상환	신한은행
SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2024년 03월 07일	150,000	4.83	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 06월 07일	미상환	신한은행
합 계	-	-	-	2,620,200	-	-	-	-	-

※ 2024년 01월 16일 발행한 회사채는 외화표시사채로서, 2024년 3월 말 환율(\$1 = 1,346.80원)을 적용하여 환산하였습니다

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
-----	-----	-----	-----	---------------	--------

제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)
--------------------	---------------	---------------	--------	---------------	------------------------------------

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16 제출

(작성기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제220-2회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2024년 05월 09일	200,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)
제220-3회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2026년 05월 09일	120,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)
제220-4회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2029년 05월 09일	250,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16 제출

(작성기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제221-2회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2025년 02월 14일	360,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-3회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2027년 02월 14일	130,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제221-4회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2030년 02월 14일	230,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16 제출

(작성기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제223-1회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2024년 04월 12일	550,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제223-2회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2026년 04월 13일	360,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제223-3회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2028년 04월 13일	80,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제223-4회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2031년 04월 13일	190,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16 제출

(작성기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리	사채관리회사
-----	-----	-----	-----	------	--------

				계약체결일	
제224-1회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2026년 02월 13일	430,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제224-2회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2028년 02월 14일	780,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제224-3회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2030년 02월 14일	100,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제224-4회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2033년 02월 14일	80,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16 제출

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일 초과 30일 이하	30일 초과 90일 이하	90일 초과 180일 이하	180일 초과 1년 이하	1년 초과 2년 이하	2년 초과 3년 이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	150,000	380,000	220,000	-	-	-	-
	합계	-	150,000	380,000	220,000	-	-	-	750,000

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일 초과 30일 이하	30일 초과 90일 이하	90일 초과 180일 이하	180일 초과 1년 이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년 초과 2년 이하	2년 초과 3년 이하	3년 초과 4년 이하	4년 초과 5년 이하	5년 초과 10년 이하	10년 초과	합 계
------	-------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	--------	-----

미상환 잔액	공모	1,110,000	520,000	610,000	780,000	80,000	850,000	-	3,950,000
	사모	673,400	2,760,940	673,400	1,346,800	1,346,800	4,716,460	100,000	11,617,800
	합계	1,783,400	3,280,940	1,283,400	2,126,800	1,426,800	5,566,460	100,000	15,567,800

※ 외화표시사채는 2024년 3월 말 환율(\$1 = 1,346.80원)을 적용하여 환산하였습니다

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의		실제 자금사용		차이발생 사유 등
			자금사용 계획		내역		
			사용용도	조달금액	내용	금액	
회사채	제224-1회	2023년 02월 14일	채무상환자금	430,000	채무상환자금	430,000	-
회사채	제224-2회	2023년 02월 14일	채무상환자금	780,000	채무상환자금	780,000	-
회사채	제224-3회	2023년 02월 14일	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-
회사채	제224-4회	2023년 02월 14일	채무상환자금	80,000	채무상환자금	80,000	-

※ 증권신고서 등의 자금사용 계획은 증권신고서 공시 기준 명칭으로 기재하였습니다.

※ 국내 증권신고서를 제출하지 않은 해외사채는 기재 제외하였습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

구분	회차	납입일	주요사항보고서의		실제 자금사용		차이발생 사유 등
			자금사용 계획		내역		
			사용용도	조달금액	내용	금액	

외화표시사채	-	2023년 04월 11일	운영자금	2,237,710	웨이퍼 등 원부자재 구매	2,237,710	-
--------	---	---------------	------	-----------	---------------	-----------	---

※ 상기 회사채는 외화표시사채로, 조달금액 USD 1,700,000,000를 이사회결의일(2023년 04월 03일) 서울외국환중개㈜ 고시 종가 환율 (\$1 = 1,316.3원) 기준으로 환산한 금액입니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

- 해당사항 없음

(2) 최근 3사업연도 중 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

- 해당사항 없음

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

- 당사는 2022년 6월 30일 에스케이위탁관리부동산투자회사에 분당 SK-U타워를 5,072억 원에 매각하고 책임임대차 전환을 완료하였습니다. 임대차 기간은 2022년 6월 30일부터 2027년 6월 30일까지 5년이며 (임대차 보증금 17,330백만원, 월 임차료 1,733백만원), 계약 종료 전 임대차 계약을 5년 연장할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인의 건물 매각 시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수협상권을 보유하고 있습니다.

- 당사는 2023년 9월 25일 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사에 수처리센터를 1,120,315백만원에 매각하고 책임임대차 전환을 완료하였습니다. 임대차 기간은 2023년 9월 25일부터 2033년 9월 25일까지 10년(임대차 보증금 143,448백만원, 월 임차료 5,977백만원)이며, 계약 종료 전 임대차 계약을 10년 연장할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인의 건물 매각 시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수협상권을 보유하고 있습니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

※ 감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항

구 분	강조사항 등	핵심감사사항
제77기 1분기	해당사항 없음	해당사항 없음

제76기	해당사항 없음	가. (별도·연결재무제표) 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가 나. (연결재무제표) 현금창출단위(Solidigm CGU)의 손상평가 다. (별도·연결재무제표) 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토 라. (별도재무제표) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자에 포함된 SK hynix NAND Product Solution Corp. 및 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. 주식 및 대여금 회수가능액 검토
제75기	(연결재무제표) 연결회사는 전기 중 인텔 NAND사업 인수 관련 자산과 부채의 공정가치 평가를 완료할 수 없었으므로 평가액을 잠정치로 보고하였으며, 당기 중 재측정한 공정가치 결과를 반영하여 비교표시된 전기 연결재무제표를 재작성함	가. (별도·연결재무제표) 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가 나. (별도·연결재무제표) 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토 다. (연결재무제표) 현금창출단위의 손상평가 라. (별도재무제표) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자에 포함된 SK hynix NAND Product Solution Corp. 및 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. 주식 회수가능액 검토

나. 부문별 연결재무정보

(1) 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체 제조업 부문의 매출액과 자산 총액이 전체 부문의 90%를 초과하여 지배적 단일 사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보 (법인소재지 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	제77기 1분기	제76기	제75기
본국(대한민국)			
1. 매출액			
외부매출액	485,931	2,033,857	1,225,765
지역간내부매출액	10,406,616	27,805,608	39,010,691
계	10,892,547	29,839,465	40,236,456
2. 영업이익	2,861,457	(4,736,939)	7,814,247
3. 자산	96,569,478	95,082,347	94,335,798
중국			
1. 매출액			
외부매출액	4,091,101	10,110,084	12,210,470
지역간내부매출액	1,647,553	6,414,230	7,326,957
계	5,738,654	16,524,314	19,537,427
2. 영업이익	69,567	64,061	414,142
3. 자산	30,180,519	28,722,168	30,480,233
아시아			

1. 매출액			
외부매출액	1,170,251	4,296,937	5,615,384
지역간내부매출액	5,958	83,589	77,878
계	1,176,209	4,380,526	5,693,262
2. 영업이익	10,135	24,966	22,319
3. 자산	1,477,026	990,707	1,025,339
미국			
1. 매출액			
외부매출액	6,312,614	15,390,229	23,960,980
지역간내부매출액	121,683	404,782	545,219
계	6,434,297	15,795,011	24,506,199
2. 영업이익	59,189	(3,167,009)	(1,552,573)
3. 자산	4,072,199	4,497,917	3,659,967
유럽			
1. 매출액			
외부매출액	369,702	934,612	1,608,969
지역간내부매출액	1,509	99,708	58,923
계	371,211	1,034,320	1,667,892
2. 영업이익	5,009	(1,622)	7,827
3. 자산	503,696	408,973	417,649
합계			
1. 매출액			
외부매출액	12,429,599	32,765,719	44,621,568
지역간내부매출액	12,183,319	34,807,917	47,019,668
계	24,612,918	67,573,636	91,641,236
2. 영업이익			
연결조정	(119,327)	86,230	103,456
계	2,886,030	(7,730,313)	6,809,417
3. 자산			
연결조정	(29,605,403)	(29,371,947)	(26,047,474)
계	103,197,515	100,330,165	103,871,512

다. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정비율
제77기	매출채권	7,180,447	1,940	0.03%

1분기	장·단기 대여금	257,426	0	0.00%
	장·단기 미수금	288,952	39	0.01%
	장·단기 미수수익	12,996	0	0.00%
	장·단기 보증금	255,398	0	0.00%
	장단기성 예치금	1,204	954	79.24%
	계	7,996,423	2,933	0.04%
제76기 연간	매출채권	6,609,990	9,717	0.15%
	장·단기 대여금	283,438	0	0.00%
	장·단기 미수금	274,252	39	0.01%
	장·단기 미수수익	11,340	0	0.00%
	장·단기 보증금	263,423	0	0.00%
	장단기성 예치금	1,153	913	79.18%
	계	7,443,596	10,669	0.14%
제75기 연간	매출채권	5,187,164	1,110	0.02%
	장·단기 대여금	294,904	0	0.00%
	장·단기 미수금	195,831	1,313	0.67%
	장·단기 미수수익	5,352	0	0.00%
	장·단기 보증금	131,766	102	0.08%
	장단기성 예치금	1,200	959	79.92%
	계	5,816,217	3,484	0.06%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제77기 1분기	제76기	제75기
1. 기초 대손충당금 잔액 합계	10,669	3,484	3,366
2. 순대손처리액(①-②±③)	(6,692)	(1,376)	-
① 대손처리액(상각채권액)	(6,692)	(1,376)	-
② 상각채권 회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	(1,044)	8,561	118
4. 기말 대손충당금 잔액 합계	2,933	10,669	3,484

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분		설정 기준
매출채권	1)정상채권	-과거 경험율을 바탕으로 설정

	2)장기채권	-거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정 -담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정 -담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정
--	--------	--

※ 연결대상회사 매출채권 총당금 설정 제외

(4) 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금액	7,180,447	-	-	-	7,180,447
구성비율	100%	0%	0%	0%	100%

라. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제77기 1분기	제76기	제75기	비고
반도체	상 품	7,548	3,336	3,401	-
	제 품	3,552,642	3,598,754	3,838,715	-
	재 공 품	8,075,522	7,565,052	9,094,152	-
	원 재 료	1,420,407	1,505,045	1,817,376	-
	저 장 품	680,597	698,159	785,825	-
	미 착 품	107,923	110,313	125,238	-
	합 계	13,844,639	13,480,659	15,664,707	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계*100]		13.4%	13.4%	15.1%	-
재고자산회전율{회수} [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		2.2회	2.3회	2.4회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고
제품	2024-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체			-
원부자재			-
제품	2023-01-01	삼일회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체			-
원부자재			-

제품	2022-01-01	삼일회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체			-
원부자재			-

(3) 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2024년 1분기말 현재 재고자산에 대한 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	당기말잔액	비고
상 품	7,763	7,763	(215)	7,548	-
제 품	4,456,458	4,456,458	(903,816)	3,552,642	-
재 공 품	8,466,966	8,466,966	(391,444)	8,075,522	-
원 재 료	1,504,356	1,504,356	(83,949)	1,420,407	-
저 장 품	772,833	772,833	(92,236)	680,597	-
미 착 품	107,923	107,923	-	107,923	-
합 계	15,316,299	15,316,299	(1,471,660)	13,844,639	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

마. 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	222,500	-	-	222,500	222,500
단기투자자산	1,119,597	-	1,119,597	-	1,119,597
매출채권(*1)	644,991	-	644,991	-	644,991
장기투자자산	4,018,479	-	-	4,018,479	4,018,479
기타금융자산	230,675	-	230,675	-	230,675
소 계	6,236,242	-	1,995,263	4,240,979	6,236,242
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*2)	8,381,395	-	-	-	-
단기금융상품(*2)	595,410	-	-	-	-
매출채권(*2)	6,533,516	-	-	-	-
기타수취채권(*2)	814,983	-	-	-	-
기타금융자산(*2)	5,618	-	-	-	-
소 계	16,330,922	-	-	-	-
금융자산 합계	22,567,164	-	1,995,263	4,240,979	6,236,242
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	1,545,237	-	1,545,237	-	1,545,237
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*2)	1,747,205	-	-	-	-
미지급금(*2)	5,374,135	-	-	-	-
기타지급채무(*2)	1,200,431	-	-	-	-
차입금	29,505,907	-	28,811,183	-	28,811,183
리스부채(*2)	3,069,409	-	-	-	-
기타금융부채(*2)	3,171	-	-	-	-
소 계	40,900,258	-	28,811,183	-	28,811,183
금융부채 합계	42,445,495	-	30,356,420	-	30,356,420

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 연결재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	222,500	-	-	222,500	222,500
단기투자자산	860,972	-	860,972	-	860,972
매출채권(*1)	470,808	-	470,808	-	470,808
장기투자자산	4,105,704	-	-	4,105,704	4,105,704
기타금융자산	146,578	-	146,578	-	146,578
소 계	5,806,562	-	1,478,358	4,328,204	5,806,562
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*2)	7,587,329	-	-	-	-
단기금융상품(*2)	250,117	-	-	-	-
매출채권(*2)	6,129,465	-	-	-	-
기타수취채권(*2)	832,654	-	-	-	-
기타금융자산(*2)	5,389	-	-	-	-
소 계	14,804,954	-	-	-	-
금융자산 합계	20,611,516	-	1,478,358	4,328,204	5,806,562
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	1,479,017	-	1,479,017	-	1,479,017
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*2)	1,845,537	-	-	-	-
미지급금(*2)	6,436,944	-	-	-	-
기타지급채무(*2)	1,192,988	-	-	-	-
차입금	29,468,632	-	28,563,668	-	28,563,668
리스부채(*2)	3,029,874	-	-	-	-
기타금융부채(*2)	3,210	-	-	-	-
소 계	41,977,185	-	28,563,668	-	28,563,668
금융부채 합계	43,456,202	-	30,042,685	-	30,042,685

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 연결재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법

수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	취 득	처 분	평 가	환율변동	분기말
단기금융상품	222,500	-	-	-	-	222,500
장기투자자산	4,105,704	1,484	(1,755)	(5,426)	(81,528)	4,018,479

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제77기 1분기 (당기)	삼정 회계법인	-	해당 사항 없음	해당 사항 없음
제76기 (전기)	삼정 회계법인	적정	해당 사항 없음	가. (별도·연결재무제표) 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가 나. (연결재무제표) 현금창출단위(Solidigm CGU)의 손상평가 다. (별도·연결재무제표) 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토 라. (별도재무제표) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자에 포함된 SK hynix NAND Product Solution Corp. 및 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. 주식 및 대여금 회수가능액 검토
제75기 (전전기)	삼일 회계법인	적정	(연결재무제표) 연결회사는 전기 중 인텔 NAND사업 인수 관련 자산과 부채의 공정가치 평가를 완료할 수 없었으므로 평가액을 장정치로 보고하였으며, 당기 중 재측정한 공정가치 결과를 반영하여 비교표시된 전기 연결재무제표를 재작성함	가. (별도·연결재무제표) 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가 나. (별도·연결재무제표) 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토 다. (연결재무제표) 현금창출단위의 손상평가 라. (별도재무제표) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자에 포함된 SK hynix NAND Product Solution Corp. 및 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. 주식 회수가능액 검토

※ 감사의견은 별도·연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

나. 회계감사인과의 감사용역계약 체결현황

(단위 :백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제77기 1분기 (당기)	삼정 회계법인	분반기검토 별도재무제표감사 연결재무제표감사 내부회계제도 감사	2,950	28,500	454	4,544
제76기 (전기)	삼정 회계법인	분반기검토 별도재무제표감사 연결재무제표감사 내부회계제도 감사	2,800	28,000	2,800	26,643

제75기 (전전기)	삼일 회계법인	분반기검토 별도재무제표감사 연결재무제표감사 내부회계제도 감사	3,200	27,800	3,200	27,120
---------------	------------	--	-------	--------	-------	--------

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 :백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제77기 1분기 (당기)	-	-	-	-	-
제76기 (전기)	2023.11.23	채권 발행 관련 용역 계약	2023.11.23~2024.01.16	200	삼정회계법인
	2023.10.20	원자재 가격 시장조사 용역 계약	2023.10.20~2023.10.31	95	삼정회계법인
	2023.07.26	전략물자 관리 체계 고도화	2023.07.26~2023.12.29	712	삼정회계법인
	2023.07.17	국제거래에 대한 세무 자료 제출 용역	2023.07.17~2023.12.31	272	삼정회계법인
	2023.04.01	준법경영체계 인증지원 자문	2023.04.01~2023.06.15	134	삼정회계법인
	2023.03.29	외주가공 용역 이전가격 자문	2023.03.29~2023.12.31	25	삼정회계법인
	2023.01.31	법인세 및 지방소득세 세무조정업무 용역계약서	2023.01.31~2023.04.30	45	삼일회계법인
	2023.01.03	사채발행 업무 용역	2023.01.03~2023.01.31	200	삼일회계법인
제75기 (전전기)	2022.12.19	TCFD 기준 기후변화 시나리오 및 재무영향 분석 고도화	2022.12.19~2023.05.18	145	삼일회계법인
	2022.10.31	세무 자문 용역 계약	2022.10.31~2023.03.31	100	삼일회계법인
	2022.09.30	사채수탁 용역 계약	2022.09.30~2023.03.31	10	삼일회계법인
	2022.09.30	경정청구 및 조세불복업무 용역	2022.09.30~2024.09.24	(주1)	삼일회계법인
	2022.09.01	사채관리계약이행상황 보고 관련 확인서 작성	2022.09.01~2023.03.31	10	삼일회계법인
	2022.03.02	2022년 지방세 세무조사 관련 대응	2022.03.02~최종확정 시	65	삼일회계법인

(주1) 환급금 비례 성공 보수

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2024년 02월 19일	회사측: 감사위원회 위원 전원 (사외이사 윤태화, 하영구, 한애라, 김정원) 감사인측: 삼정회계법인 (업무수행이사 외 2명)	대면회의	1. 연차 재무제표감사 주요사항 2. 재무제표 감사수행 결과 3. 내부회계관리제도 감사수행 결과 4. 기타사항

[조정협의회의내용 및 재무제표 불일치정보]

- 해당사항 없음

마. 회계 감사인의 변경

(1) 변경 사유

당사는 2014년부터 2019년까지 연속 6개 사업연도에 대하여 삼정회계법인을 감사인으로 선임하였습니다. 이에 따라, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제2항 및 시행령

제15조에 적용 대상이 되어 2020년부터 주기적 감사인 지정제의 대상이 되었으며, 증권선물 위원회로부터 지정받은 삼정회계법인을 2020년부터 2022년까지 연속 3개 사업연도의 외부 감사인으로 선임하였습니다. 지정감사 기간 종료로 2023년 신규 감사인 선임이 필요하여, 당사는 삼정회계법인을 2023년부터 2025년까지 연속 3개 사업연도의 외부감사인으로 선임 하였습니다.

(2) 감사위원회의 의결

당사는 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 2022년 9월 26일 제9차 감사위원회에서 2023년부터 2025년까지 (제76기~제78기) 사업연 도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

- 당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있습니다.
- 당사는 2019년 1월 23일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2019년 개최한 제71기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하였습니다. 한편, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

[투표제도 현황]

(기준일 : 2024년 03월 31일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	미실시	미실시	제71기(2018년도) 정기주주총회부터 연속 실시

나. 소수주주권

- 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

- 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 관련한 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	728,002,365	-
	우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	39,387,451	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	688,614,914	-
	우선주	-	-

마. 주식사무

<p>정관상 신주인수권의 내용</p>	<p>제10조 (주식의 발행 및 배정) < 개정 2017.3.24 ></p> <p>① 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식. 본 제 2호에 의한 신주 발행은 아래 각 목의 경우를 포함하되 이에 한정되지 아니함. <ul style="list-style-type: none"> 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 나. 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관(여기서 '금융기관'이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 다. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우 라. 회사가 "경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자"에게 신주를 발행하는 경우 마. 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 <p>② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식에 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여
--------------------------	---

	<p>하는 방식</p> <p>4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식</p> <p>③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2 호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.</p> <p>④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.</p>		
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중
주주명부폐쇄시기*	-		
주권의 종류	<p>「주식·사채등의전자등록에관한법률」을 반영하여, 2019년 3월 22일 제71기 정기주주총회에서 주권의 종류와 관련된 당사 정관(제9조)을 아래와 같이 변경하였습니다.</p> <p>- 기존 : 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.</p> <p>- 변경 : 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.</p>		
명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (여의도동) 3층)		
주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지 게재

※ 전자증권제도 도입('19.9월)으로 주주명부폐쇄 기간의 필요성이 없어짐에 따라

주주권 행사 편의성 증대를 위해 '주주명부폐쇄 기간'을 정관상 삭제(제72기 정기주주총회 결의 사항)

바. 주주총회 의사록 요약

- 공시대상기간 중 개최한 주주총회에서 결의된 안건 중 주주제안안건은 없습니다

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용
제76기 정기주주총회 (2024.03.27)	제1호 의안: 제76기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	제2호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 승인	
	제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 안현)	원안대로 승인	
	제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 손현철)	원안대로 승인	
	제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 장용호)	원안대로 승인	
	제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 양동훈)	원안대로 승인	

	제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	
	제8호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인	
제75기 정기주주총회 (2023.03.29)	제1호 의안: 제75기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 한애라)	원안대로 승인	
	제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 김정원)	원안대로 승인	
	제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 정덕균)	원안대로 승인	
	제3-1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 한애라)	원안대로 승인	
	제3-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김정원)	원안대로 승인	
	제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 박성하)	원안대로 승인	
	제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	
제 74기 정기주주총회 (2022.03.30)	제1호 의안: 제74기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	제2호 의안: 정관 변경의 건	원안대로 승인	
	제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	
	제4호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건	원안대로 승인	
	제5-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 곽노정)	원안대로 승인	
	제5-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 노종원)	원안대로 승인	
	제6호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 하영구)	원안대로 승인	
	제7호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 하영구)	원안대로 승인	
	제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
SK스퀘어(주)	최대주주	의결권 있는 주식	146,100,000	0.00	146,100,000	20.07	-
곽노정	특수관계인	의결권 있는 주식	4,016	0.00	4,016	0.00	-
하영구	특수관계인	의결권 있는 주식	1,586	0.00	1,586	0.00	-
한애라	특수관계인	의결권 있는 주식	1,066	0.00	1,066	0.00	-
김정원	특수관계인	의결권 있는 주식	416	0.00	416	0.00	-
정덕균	특수관계인	의결권 있는 주식	416	0.00	416	0.00	-
안현	특수관계인	의결권 있는 주식	0	0.00	2,833	0.00	신규 선임
윤태화	특수관계인	의결권 있는 주식	1,326	0.00	0	0.00	임원 사임
박정호	특수관계인	의결권 있는 주식	22,114	0.00	0	0.00	임기 만료
송호근	특수관계인	의결권 있는 주식	1,326	0.00	0	0.00	임기 만료
조현재	특수관계인	의결권 있는 주식	1,066	0.00	0	0.00	임기 만료
계		의결권 있는 주식	146,133,332	20.07	146,110,333	20.07	-
		기타	-	-	-	-	-

* 의결권 있는 주식은 보통주임

** 기초는 2024년 1월 1일 기준이며, 기말은 2024년 3월 31일 기준임

당사는 작성기준일 이후 2024년 4월 24일자 이사회에서 대표이사 및 사외이사 보수지급을 위한 자기주식 처분을 결의하였으며, 상기 특수관계인 중 대표이사 1인(곽노정) 및 사외이사 6인(하영구, 한애라, 김정원, 정덕균, 손현철, 양동훈)에게 자기주식을 지급하였습니다. 제출일 현재, 당사의 최대주주와 특수관계인 소유주식수는 146,113,064주(지분율 20.07%)입니다.

※ 상기 자기주식 지급으로 인한 특수관계인의 주식소유 현황 변동내역은 하기 표의 각 "임원·주요주주특정증권등소유상황보고서"를 참고하시기 바랍니다.

[임원·주요주주특정증권등소유상황보고서]

보고의무발생일	대상자	비고
2024.04.26	곽노정	임원·주요주주특정증권등소유상황보고서
	하영구	임원·주요주주특정증권등소유상황보고서
	한애라	임원·주요주주특정증권등소유상황보고서
	김정원	임원·주요주주특정증권등소유상황보고서
	정덕균	임원·주요주주특정증권등소유상황보고서

	손현철	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서
	양동훈	임원 · 주요주주특정증권등소유상황보고서

2. 최대주주의 주요 경력 및 개요

가. 최대주주 개요 및 지분율(2024년 03월 31일 기준)

당사의 최대주주는 SK스퀘어 주식회사이며, 그 소유주식수는 146,100,000주(20.07%)로서 특수관계인을 포함하여 146,110,333주(지분율 20.07%)입니다.

나. 최대주주의 기본 정보

(1) 최대주주의 대표자 (2024년 03월 31일 기준)

성명	직위	상근여부	출생년도
박성하	대표이사/사장	상근	1965년

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK스퀘어 주식회사	88,472	박성하	0.01	-	-	SK(주)	30.55
		-	-	-	-	-	-

* 출자자수는 최대주주 및 특수관계인, 1% 이상의 주주를 합산한 숫자입니다

(3) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2021년 11월 29일	박정호	0.00	-	-	에스케이(주)	30.56
2022년 02월 25일	박정호	0.00	-	-	에스케이(주)	30.57
2022년 07월 22일	박정호	0.00	-	-	에스케이(주)	30.03
2023년 02월 17일	박정호	0.00	-	-	에스케이(주)	30.05
2023년 04월 05일	박성하	0.00	-	-	에스케이(주)	30.06
2024년 02월 07일	박성하	0.01	-	-	에스케이(주)	30.60

* SK스퀘어(주)는 SK텔레콤으로부터 인적분할하여 2021년 11월 29일 신규 상장하였습니다.

(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

당사의 최대주주인 SK스퀘어 주식회사의 제4기 1분기 재무현황입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	SK스퀘어 주식회사
자산총계	18,278,395
부채총계	2,064,148
자본총계	16,214,247
매출액	498,278
영업이익	323,785
당기순이익	333,285

* SK스퀘어(주)의 제4기 1분기 연결재무제표기준

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 SK스퀘어 주식회사는 2021년 11월 SK텔레콤으로 부터 인적분할을 통해 설립 되었으며, 동월 유가증권시장에 재상장되었습니다.이후 2022년 1월 SK그룹 계열사로 편입되었습니다.

보고서 작성기준일 현재, 영위하고 있는 주요 사업은 (1) 투자사업, (2) 커머스사업, (3) 플랫폼사업, (4) 모빌리티 사업, (5) 기타사업입니다

(6) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 여부
- 해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주 개요

(1) 최대주주 개요 (2024년 03월 31일 기준)

당사의 최대주주는 에스케이 주식회사이며 기본정보 등은 아래와 같습니다.

구분	내용	비고
설립일	1991년 4월 13일	-
주소	서울특별시 종로구 종로 26	-
전화번호	02-2121-5114	-
홈페이지	https://www.sk-inc.com/	-
연결실체 내 종속기업수	698개사	국내 198개사, 해외 500개사

(2) 회사의 주권상장(또는 등록·지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록·지정)현황	주권상장 (또는 등록·지정)일자	특례상장 유형
유가증권시장 상장	2009년 11월 11일	해당사항 없음

(3) 국내 상장 종속회사수

연결실체 내의 당사를 포함한 상장회사는 아래와 같습니다.

상장여부	회사명	법인등록번호
상장사(15)	SK(주)	110111-0769583
	SK이노베이션(주)	110111-3710385
	SK텔레콤(주)	110111-0371346
	SK스퀘어(주)	110111-8077821
	SK네트웍스(주)	130111-0005199
	SKC(주)	130111-0001585
	SK위탁관리부동산투자회사(주)	110111-7815446
	SK시그넷(주) (舊, (주)시그넷이브이)	205811-0018148
	SK바이오팜(주)	110111-4570720
	(주)드림어스컴퍼니	110111-1637383
	인크로스(주)	110111-3734955
	SK아이이테크놀로지(주)	110111-7064217
	SK오션플랜트(주) (舊, 삼강M&T(주))	191311-0003485
	(주)탐선	160111-0248652
	(주)아이에스시	131111-0057876

1) SK(주), SK이노베이션(주), SK텔레콤(주), SK스퀘어(주), SK네트웍스(주), SKC(주), SK위탁관리부동산투자회사(주), SK바이오팜(주), SK아이이테크놀로지(주), SK오션플랜트(주) (舊, 삼강M&T(주)) 이상 10개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, (주)드림어스컴퍼니, 인크로스(주), (주)아이에스시 이상 3개사는 코스닥 시장, SK시그넷(주) (舊, (주)시그넷이브이), (주)탐선 이상 2개사는 코넥스 시장에 상장되어 있음

2) SK렌터카는 '24.1.31일자로 상장 폐지되었음

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(1) 최대주주의 대표자

(2024년 03월 31일 기준)

성명	직위	상근여부	출생년도
최태원	대표이사 회장	상근	1960년
장용호	대표이사 사장	상근	1964년

* 2022년 3월 29일 제31차 정기주주총회 및 같은 날 개최된 제3차 이사회를 통해 최태원 이사는 사내이사 및 대표이사로 재선임되었음

** 2024년 3월 27일 제33차 정기주주총회 및 같은 날 개최된 제5차 이사회를 통해 장용호 이사는 사내이사 및 대표이사로 재선임되었음

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수	대표이사	업무집행자	최대주주
-----	------	------	-------	------

	(명)	(대표조합원)		(업무집행조합원)		(최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK(주)	170,164	최태원	17.73	-	-	최태원	17.73
		장용호	0.01	-	-	-	-

* 대표이사과 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음

(3) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2023년 04월 05일	최태원	17.73	-	-	최태원	17.73

* 공시대상기간 이전의 변동현황은 기재를 생략하였음

** 2023년 4월 5일 신탁계약으로 취득한 자사주 951,000주를 이익소각하여 총발행주식수가 감소함에 따라 최대주주의 지분율이 17.73%로 증가함

※ 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 변동내역 상세

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2023년 04월 05일	최태원	12,975,472	17.73	-	신탁계약으로 취득한 자기주식 소각으로 총발행주식수 감소에 따른 지분율 증가

* 상기 지분율은 보통주 기준임

(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	SK주식회사
자산총계	216,105,662
부채총계	136,056,894
자본총계	80,048,768
매출액	33,026,813
영업이익	1,537,210
당기순이익	725,252

* SK(주)의 제34기 1분기 연결 재무제표 기준

1) 요약 연결 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제34기 1분기 (2024.03.31)
[유동자산]	69,542,285
현금및현금성자산	24,916,467
재고자산	16,092,364
기타의유동자산	28,533,454
[비유동자산]	146,563,377
관계기업및공동기업투자	27,345,715
유형자산	76,921,166
무형자산및영업권	18,515,841
기타의비유동자산	23,780,655
자산총계	216,105,662
[유동부채]	69,157,388
[비유동부채]	66,899,506
부채총계	136,056,894
[지배기업소유주지분]	21,247,543
자본금	16,143
기타불입자본	6,890,550
이익잉여금	13,646,998
기타자본구성요소	693,852
[비지배지분]	58,801,225
자본총계	80,048,768
부채와자본총계	216,105,662
연결에 포함된 회사 수	698개사
	제34기 1분기 (2024.01.01~2024.03.31)
I. 매출액	33,026,813
II. 영업이익(손실)	1,537,210
III. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)	1,133,366
IV. 계속영업당기연결순이익(손실)	633,948
V. 당기순이익(손실)	725,252
지배기업소유주지분순이익(손실)	157,423
비지배지분순이익(손실)	567,829
VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익	
보통주기본주당이익(손실)	2,852원
우선주기본주당이익(손실)	2,902원
보통주희석주당이익(손실)	2,851원
보통주기본주당계속영업이익(손실)	2,105원
우선주기본주당계속영업이익(손실)	2,105원

보통주희석주당계속영업이익(손실)	2,104원
-------------------	--------

2) 요약 별도 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제34기 1분기 (2024.03.31)
[유동자산]	2,516,553
현금및현금성자산	235,041
재고자산	234
기타유동자산	2,281,278
[비유동자산]	26,520,227
종속·관계·공동기업 투자	22,210,729
유형자산	582,312
사용권자산	101,312
무형자산	2,142,134
기타비유동자산	1,483,740
자산총계	29,036,780
[유동부채]	5,759,797
[비유동부채]	7,130,495
부채총계	12,890,292
자본금	16,143
기타불입자본	3,144,225
이익잉여금	12,752,234
기타자본구성요소	233,886
자본총계	16,146,488
부채와자본총계	29,036,780
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법
	제34기 1분기 (2024.01.01~2024.03.31)
I. 매출액(영업수익)	1,236,876
II. 영업이익	606,350
III. 법인세비용차감전계속영업이익	472,873
IV. 당기순이익	477,969
V. 주당이익	
보통주기본주당이익	8,659원
우선주기본주당이익	8,709원
보통주희석주당이익	8,657원
우선주희석주당이익	8,709원

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

1) 사업의 내용

SK주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴 및 육성하는 '투자 부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다. SK주식회사는 SK그룹의 지주회사로서, 2024년 1분기말 현재 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SK네트웍스 등 총 698개사입니다.

2) 회사가 영위하는 목적사업(정관)

목 적 사 업

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업
3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업
- 3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업
- 3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업
4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업
5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업
9. 의약 및 생명과학 관련 사업
10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공
12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업
13. 환경관련 사업
14. 회사가 보유하고 있는 지식·정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
15. 전기통신업
16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
17. 정보서비스업
18. 소프트웨어 개발 및 공급업
19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업
20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업
21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업
23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업
24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업
25. 통신판매업, 전자상거래업, 도·소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업
26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업
27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업
28. 보험대리점 영업
29. 시설대여업
30. 자동차대여사업
31. 여론조사업
32. 연구개발업
33. 경영컨설팅업
34. 광고대행업을 포함한 광고업
35. 교육서비스업
36. 경비 및 보안시스템 서비스업
37. 검사, 측정 및 분석업
38. 기계·장비 제조업 및 임대업
39. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반 사업 일체

3) 주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업

자회사	주요 목적사업
SK이노베이션(주)	지주사업 및 석유/ 화학/ 배터리 관련 사업
SK텔레콤(주)	정보통신사업
SK스퀘어(주)	지주사업
SK네트웍스(주)	상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업
SKC(주)	지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업, 반도체 소재 사업
SK에코플랜트(주)	환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
SK E&S(주)	가스사 소유 및 복합화력발전 사업
SK바이오팜(주)	신약개발사업
SK Pharmteco, Inc.	의약품 중간체 제조업
SK실트론(주)	전자산업용 규소박판 제조업
SK스페셜티(주) (舊, SK머티리얼즈(주))	특수가스 제조 및 판매
에스케이머티리얼즈 에어플러스(주)	산업가스 제조 및 판매
에스케이트리켄(주)	프리커서 제조 및 판매
에스케이레조낙(주) (舊, 에스케이쇼와덴코(주))	특수가스 제조 및 판매
에스케이머티리얼즈 그룹포틴(주)	배터리 소재 제조 및 판매업
에스케이위탁관리 부동산투자회사(주)	부동산임대업
SK시그넷(주) (舊, (주)시그넷이브이)	전기자동차 충전시스템 설치 및 관련장비 제조, 판매업
SK China Company, Ltd.	컨설팅 및 투자
SK임업(주)	조림사업, 조경사업, 복합임업사업
(주)휘찬	휴양콘도 운영업
SK파워텍(주) (舊, (주)에스파워테크닉스)	반도체 제조업

▷ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 SK(주)의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

- 해당사항 없습니다.

라. 최대주주의 최대주주 관련 사항

성명	학력	직위	기간	경력사항
최태원	고려대학교 물리학과 졸업 (1983) 미국 시카고대학교 대학원 경제학	대표이사 회장 (등기임원)	2021.03 ~ 현재	대한상공회의소 회장
			2016.03 ~ 현재	SK주식회사 대표이사 회장

	석사 및 박사 과정 수료 (1989)	2015.08 ~ 2016.03	SK주식회사 회장
		2022.02 ~ 현재	SK텔레콤 주식회사 회장
		2012.02 ~ 현재	SK하이닉스 주식회사 회장
		2007.07 ~ 현재	SK이노베이션 주식회사 회장
		1997.12 ~ 2015.07	(舊) SK주식회사 회장

* 상기 최대주주는 2016년 3월 18일 제25기 정기주주총회 및 제3차 이사회를 통해 SK주식회사 등
기이사 및 대표이사로 선임되었으며 2019년 3월 27일 제28기 정기주주총회 및 제4차 이사회,
2022년 3월 29일 제31기 정기주주총회 및 제3차 이사회에서 등기이사 및 대표이사로 재선임 되었음

4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2020년 10월 22일	SK텔레콤주	146,102,132	20.07	장내매수 (박정호 사내이사)	-
2021년 05월 03일	SK텔레콤주	146,103,332	20.07	자사주 상여금 (사외이사 6인)	-
2021년 06월 11일	SK텔레콤주	146,104,332	20.07	장내매수 (오종훈 사내이사)	-
2021년 08월 20일	SK텔레콤주	146,104,782	20.07	장내매수 (오종훈 사내이사)	-
2021년 11월 02일	SK스퀘어주	146,104,782	20.07	최대주주 변경	(주1)
2022년 02월 25일	SK스퀘어주	146,131,909	20.07	자사주 상여금 (박정호 사내이사, 이석희 사내이사)	-
2022년 03월 30일	SK스퀘어주	146,121,434	20.07	특수관계자 제외(이석희 사내이사, 오종훈 사내이사) 특수관계자 추가(곽노정 사내이사, 노종원 사내이사)	-
2022년 05월 02일	SK스퀘어주	146,124,674	20.07	자사주 상여금 (사외이사 6인)	-
2022년 05월 03일	SK스퀘어주	146,125,674	20.07	장내매수 (곽노정 사내이사)	-
2023년 02월 24일	SK스퀘어주	146,132,237	20.07	자사주 상여금 (박정호 사내이사, 곽노정 사내이사, 노종원 사내이사)	-
2023년 03월 28일	SK스퀘어주	146,130,570	20.07	특수관계자 제외(노종원 사내이사)	-
2023년 03월 29일	SK스퀘어주	146,129,920	20.07	특수관계자 제외(신창환 사외이사)	-
2023년 08월 04일	SK스퀘어주	146,133,332	20.07	자사주 상여금 (사외이사 7인)	-
2024년 03월 22일	SK스퀘어주	146,132,006	20.07	특수관계자 제외(윤태화 사외이사)	-
2024년 03월 27일	SK스퀘어주	146,110,333	20.07	특수관계자 제외(박정호 사내이사, 송호근 사외이사, 조현재 사외이사) 특수관계자 추가(안현 사내이사)	(주2)

※ 최근 5년간의 최대주주 변동내역 기준

(주1) 상기 에스케이스퀘어주의 보유내역은 2021년 11월 2일부로 에스케이텔레콤주의 회사 인적분할에 따라 신설된 분할신설법인인

에스케이스퀘어주가 기존 에스케이텔레콤주가 보유하던 회사의 지분 전량을 승계한 146,100,000주와 특수관계인의 보유주식 4,782주를 합산한 것임

(주2) 상기 에스케이스퀘어주의 보유내역은 2021년 11월 2일부로 에스케이텔레콤주의 회사 인적분할에 따라 신설된 분할신설법인인

에스케이스퀘어주가 기존 에스케이텔레콤주가 보유하던 회사의 지분 전량을 승계한 146,100,000주와 특수관계인의 보유주식 10,333주를 합산한 것임

5. 주식의 분포

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

6. 주가 및 주식 거래실적

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
곽노정	남	1965년 11월	대표이사 사장		상근	대표이사 미래전략위원회 위원	고려대학교 대학원 박사 SK하이닉스 미래기술연구원 상무 SK하이닉스 청주 FAB담당 전무 SK하이닉스 제조/기술 담당 부사장 SK하이닉스 안전개발제조총괄 사장 한국 반도체산업협회 13대 회장 (現) SK하이닉스 대표이사/사장 (現)	4,016	-	-	2년 1개월 선임('22.03.30)	-
안현	남	1967년 06월	담당		상근	Solution개발 담당 지속경영위원회 위원 미래전략위원회 위원	서울대 대학원 전자공학 박사 SK하이닉스 NAND개발사업전략 담당 SK하이닉스 미래연구추진단 담당 SK하이닉스 Solution개발 담당 (現)	2,833	-	-	1개월 선임('24.03.27)	-
박성하	남	1965년 10월	이사		비상근	기타비상무이사	MIT 경영학 석사 SK㈜ Portfolio Mgmt. 부문장 SUPEX추구협의회 전략지원팀장 SK C&C 대표이사/사장 SK스퀘어 대표이사/사장 (現)	-	-	계열회사 임원 (SK스퀘어)	1년 1개월 선임('23.03.29)	-
장응호	남	1964년 04월	이사		비상근	기타비상무이사 인사·보상위원회 위원	서울대 경제학 학사 SK주식회사 PM2 부문장 SK머티리얼즈 대표이사 사장 SK실트론 대표이사 사장 SK주식회사 대표이사 사장 (現)	-	-	계열회사 임원 (SK㈜)	1개월 선임('24.03.27)	-
허영구	남	1953년 11월	이사		비상근	사외이사 이사회 의장 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위 원 인사·보상위원회 위원 미래전략위원회 위원	미국 노스웨스턴대 석사 전국은행연합회장 금융개혁협의회 위원 블랙스톤어드바이자스코리아 대표이사 (現) SK하이닉스 이사회 의장 (現)	1,586	-	-	5년 1개월 중임('22.03.30)	-
한애라	여	1972년 02월	이사		비상근	사외이사 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위 원 지속경영위원회 위원 인사·보상위원회 위원	하버드대학교 대학원 석사 대법원 재판연구관 김연장 법률사무소 성균관대 법학전문대학원 교수 (現)	1,066	-	-	4년 1개월 중임('23.03.29)	-

정덕균	남	1958년 08월	이사	사외이사	비상근	사외이사 사외이사후보추천위원회 위 원 인사·보상위원회 위원 미래전략위원회 위원	UC 버클리대 전기컴퓨터공학 박사 서울대 전기정보공학부 교수 서울대 반도체공동연구소장 서울대 전기정보공학부 석좌교수 (現)	416	-	-	1년 1개월 선임('23.03.29)	-
김정원	여	1968년 11월	이사	사외이사	비상근	사외이사 감사위원회 위원 지속경영위원회 위원 인사·보상위원회 위원	시카고대 경영학 석사 한국씨티은행 재무기획그룹 부행장 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director 김앤장 법률사무소 고문 (現)	416	-	-	1년 1개월 선임('23.03.29)	-
양동훈	남	1958년 07월	이사	사외이사	비상근	사외이사 감사위원회 위원	시라큐스대 회계학 박사 한국회계학회 제36대 회장 방송통신위원회 회계전문위원장 한국회계학회·삼일회계법인 자명교수 동국대학교 경영대 회계학과 교수/명예교수 (現)	-	-	-	1개월 선임('24.03.27)	-
손현철	남	1961년 03월	이사	사외이사	비상근	사외이사 지속경영위원회 위원 미래전략위원회 위원	UC 버클리대 재료공학 박사 하이닉스반도체 연구원 연세대 공과대 신소재 공학과 교수 (現)	-	-	-	1개월 선임('24.03.27)	-

※ 상기 제직기간은 최초 선임일 기준이며, 일자는 최근 선임일임

※ 임기 만료일은 취임 후 개폐되는 제3차 정기주주총회 종료시임

※ 2024년 3월 27일 제76기 정기주주총회를 통해 안현 사내이사, 손현철 사외이사, 장용호 기타비상무이사, 양동훈 사외이사 겸 감사위원회 위원이 신규 선임됨

나. 등기임원의 겸직 현황

[기준일: 2024년 03월 31일]

겸직임원		겸직회사		비 고
성명	직위(직책)	회사명	직위	
곽노정	대표이사 (사장)	SK hynix Semiconductor (China) Ltd. (해외법인)	대표이사	-
		SK hynix NAND Product Solutions Corp. (해외법인)	이사	-
		SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	이사	-
안현	Solution개발 담당 (담당)	SK hynix memory solutions America Inc. (해외법인)	의장	-
		SK hynix memory solutions Taiwan Ltd. (해외법인)	의장	-
		SK hynix NAND Product Solutions Corp. (해외법인)	부사장	-
박성하	기타비상무이사	SK스퀘어	대표이사	-
장용호	기타비상무이사	SK㈜	대표이사	-
		SK E&S	기타비상무이사	-
		SK이노베이션	기타비상무이사	-
		SK실트론	기타비상무이사	-
		SK China Company, Ltd.	의장	-
		SK팜데코	의장	-
		SK Japan Inc.	이사	-
		SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	이사	-
하영구	사외이사	블랙스톤어드바이저스코리아(유)	대표이사	-
한애라	사외이사	CJ㈜	사외이사	-

김정원	사외이사	(주)루닛	사외이사	-
-----	------	-------	------	---

다. 미등기 임원 현황

(가) 미등기 임원

[기준일: 2024년 03월 31일]

직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	출생년월	담당 업무	주요 경력	최대주주와의 관계	재직기간
회장 (상근)	미등기	최태원	남	1960.12	회장	회장	계열회사 임원 (SK(주))	
부회장 (상근)	미등기	박정호	남	1963.05	부회장	대표이사		
사장 (상근)	미등기	김동섭	남	1963.01	대외협력 담당	대외협력총괄		
사장 (상근)	미등기	김주선	남	1966.06	AI Infra 담당	GSM 담당		
담당 (상근)	미등기	강선국	남	1969.02	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	강욱성	남	1969.01	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	강유중	남	1970.12	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	강지호	남	1973.11	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	강진수	남	1967.07	CEO직속 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	고은정	여	1979.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	권기창	남	1969.11	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	권언오	남	1973.04	AI Infra 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	권오혁	남	1970.03	대외협력 담당임원	SK주식회사		15개월
담당 (상근)	미등기	권재순	남	1969.12	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	김규현	남	1971.07	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김기태	남	1973.01	AI Infra 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	김능구	남	1967.03	BE구매 담당	CEO직속 담당임원		51개월
담당 (상근)	미등기	김동규	남	1972.08	미래전략 담당임원	재무 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김만섭	남	1970.11	제조/기술 담당임원	제조/기술		

담당 (상근)	미등기	김상덕	남	1968.02	Global QRA 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김상훈	남	1973.04	Global QRA 담당임원	품질보증		
담당 (상근)	미등기	김석	남	1970.11	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김선순	남	1970.06	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김성한	남	1968.12	FE구매 담당	구매 담당		
담당 (상근)	미등기	김영식	남	1967.12	제조/기술 담당	제조/기술 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김우현	남	1967.01	재무 담당	SK브로드밴드		27개월
담당 (상근)	미등기	김운용	남	1967.09	미래기술연구원 담당임원	개발제조총괄		
담당 (상근)	미등기	김점수	남	1972.01	NAND개발 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김정배	남	1971.01	제조/기술 담당임원	제조/기술		29개월
담당 (상근)	미등기	김정수	남	1969.07	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김정태	남	1969.07	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김종환	남	1972.09	DRAM개발 담당	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김준한	남	1972.06	Corporate Development 담 당임원	CEO직속 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김천성	남	1973.05	Solution개발 담당임원	Solution개발		
담당 (상근)	미등기	김춘환	남	1967.04	미래기술연구원 담당임원	제조/기술 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김현규	남	1969.09	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	김현중	남	1970.11	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	김형수	남	1974.06	DRAM개발 담당임원	기업문화 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김형환	남	1970.03	제조/기술 담당임원	기업문화 담당임원		
담당 (상근)	미등기	도승용	남	1973.02	DT 담당	DT 담당임원		40개월
담당 (상근)	미등기	도창호	남	1970.01	DT 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	류병훈	남	1980.10	미래전략 담당	SK스퀘어		15개월
담당 (상근)	미등기	류성수	남	1972.03	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		

담당 (상근)	미등기	마금선	남	1968.11	대외협력 담당임원	대외협력총괄		
담당 (상근)	미등기	문기일	남	1969.10	P&T 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	문순기	남	1971.03	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	문승훈	남	1969.08	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	문양기	남	1971.12	Solution개발 담당임원	Solution개발		
담당 (상근)	미등기	문지웅	남	1966.10	대외협력 담당임원	CEO직속 담당임원		51개월
담당 (상근)	미등기	민경현	남	1966.01	대외협력 담당임원	미래전략 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박경	남	1968.07	AI Infra 담당임원	CEO직속 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박명수	남	1970.04	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박명재	남	1980.07	AI Infra 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박문필	남	1973.05	AI Infra 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박민철	남	1971.10	미래전략 담당임원	미래전략		58개월
담당 (상근)	미등기	박상범	남	1969.10	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	박성계	남	1967.06	미래기술연구원 담당임원	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박성조	남	1970.09	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	박성환	남	1968.11	재무 담당임원	재무		
담당 (상근)	미등기	박수만	남	1972.05	CEO직속 담당임원	SUPEX추구협의회		39개월
담당 (상근)	미등기	박용근	남	1969.07	대외협력 담당임원	대외협력총괄		
담당 (상근)	미등기	박준식	남	1969.11	CEO직속 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박진규	남	1968.06	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	박찬동	남	1968.03	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박찬하	남	1969.01	CEO직속 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박창현	남	1968.09	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박철규	남	1966.06	Global QRA 담당임원	DRAM개발 담당임원		

담당 (상근)	미등기	박태진	남	1969.10	제조/기술 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박현	남	1969.06	대외협력 담당임원	대외협력총괄		
담당 (상근)	미등기	박훈	남	1976.01	대외협력 담당임원	산업통상자원부		32개월
담당 (상근)	미등기	배극인	남	1969.08	대외협력 담당임원	동아일보		21개월
담당 (상근)	미등기	백현철	남	1965.03	미래기술연구원 담당임원	제조/기술 담당임원		
담당 (상근)	미등기	서재욱	남	1973.08	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	설광수	남	1970.01	미래기술연구원 담당임원	제조/기술 담당임원		
담당 (상근)	미등기	손동휘	남	1970.06	재무 담당임원	재무		
담당 (상근)	미등기	손상수	남	1968.10	AI Infra 담당임원	CEO직속 담당임원		
담당 (상근)	미등기	손상호	남	1972.03	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	손석우	남	1968.01	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	손수용	남	1970.03	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	손승훈	남	1974.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	손호영	남	1979.12	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	송준호	남	1970.05	Global QRA 담당임원	Intel		49개월
담당 (상근)	미등기	송창록	남	1969.01	CIS개발 담당	CIS Business 담당		
담당 (상근)	미등기	송창석	남	1971.07	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	송현중	남	1965.11	기업문화 담당임원	CEO직속 담당임원		
담당 (상근)	미등기	신상규	남	1970.11	기업문화 담당	SK텔레콤		27개월
담당 (상근)	미등기	신승아	여	1977.12	CEO직속 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	신정호	남	1968.10	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	신현수	남	1971.03	재무 담당임원	경영지원		39개월
담당 (상근)	미등기	심규찬	남	1971.01	CEO직속 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	안대웅	남	1974.09	DT 담당임원	DT		

담당 (상근)	미등기	안정열	남	1972.11	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	안현준	남	1971.12	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	양형모	남	1975.04	재무 담당임원	SUPEX추구협의회		39개월
담당 (상근)	미등기	여동준	남	1969.05	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	오동연	남	1974.09	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	오정환	남	1969.01	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	오태경	남	1974.05	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	오훈상	남	1969.07	CIS개발 담당임원	CIS Business 담당임원		
담당 (상근)	미등기	윤경렬	남	1971.03	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발		56개월
담당 (상근)	미등기	윤재연	남	1976.10	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	윤홍성	남	1971.01	FE구매 담당임원	구매 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이강민	남	1968.12	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	이강욱	남	1968.03	P&T 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이광욱	남	1970.09	CEO직속 담당임원	제조/기술 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이규제	남	1972.11	P&T 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이기화	남	1968.12	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	이동호	남	1968.06	미래전략 담당임원	CEO직속 담당임원		27개월
담당 (상근)	미등기	이동훈	남	1983.05	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	이문환	남	1967.09	FE구매 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이민형	남	1968.10	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	이방실	여	1975.02	미래전략 담당임원	대외협력 담당임원		39개월
담당 (상근)	미등기	이병기	남	1972.02	제조/기술 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이병래	남	1969.05	대외협력 담당임원	SK이노베이션		3개월
담당 (상근)	미등기	이병찬	남	1965.03	FE구매 담당임원	구매 담당임원		

담당 (상근)	미등기	이상권	남	1974.12	AI Infra 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이상락	남	1968.01	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이상엽	남	1969.03	BE구매 담당임원	구매 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이상영	남	1969.01	미래전략 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이상환	남	1971.02	AI Infra 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이성재	남	1969.07	Solution개발 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이성훈	남	1972.02	CEO직속 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이승필	남	1970.03	NAND개발 담당임원	NAND개발		51개월
담당 (상근)	미등기	이웅선	남	1969.02	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	이인노	남	1971.04	제조/기술 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	이일우	남	1971.07	기업문화 담당임원	기업문화		
담당 (상근)	미등기	이일훈	남	1971.09	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	이재서	남	1982.06	CEO직속 담당임원	재무 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이재연	남	1975.10	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	이재준	남	1978.05	Corporate Development 담 당임원	대외협력 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이정석	남	1968.02	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	이주영	남	1977.07	기업문화 담당임원	기업문화		
담당 (상근)	미등기	이창수	남	1974.12	DT 담당임원	DT		
담당 (상근)	미등기	이태학	남	1973.05	Solution개발 담당임원	Solution개발		
담당 (상근)	미등기	이현민	남	1973.10	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	이현철	남	1973.12	FE구매 담당임원	변화추진		
담당 (상근)	미등기	이호석	남	1969.09	제조/기술 담당임원	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이홍덕	남	1970.01	BE구매 담당임원	구매 담당임원		
담당 (상근)	미등기	임성혁	남	1970.08	제조/기술 담당임원	제조/기술		

담당 (상근)	미등기	임형도	남	1968.06	CEO직속 담당임원	SK텔레콤		15개월
담당 (상근)	미등기	장지은	여	1974.06	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	전원철	남	1968.03	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	전유남	남	1974.01	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	정상규	남	1967.12	Solution개발 담당임원	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	정상록	남	1969.07	대외협력 담당임원	SK텔레콤		3개월
담당 (상근)	미등기	정성용	남	1972.12	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	정우표	남	1967.05	NAND개발 담당임원	Intel		57개월
담당 (상근)	미등기	정유인	남	1969.11	DT 담당임원	DT		
담당 (상근)	미등기	정윤식	남	1975.01	재무 담당임원	SUPEX추구협의회		27개월
담당 (상근)	미등기	정은태	남	1969.07	제조/기술 담당임원	CEO직속 담당임원		
담당 (상근)	미등기	정인철	남	1972.01	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	정제모	남	1976.09	기업문화 담당임원	기업문화		
담당 (상근)	미등기	정진수	남	1970.10	제조/기술 담당임원	품질보증 담당임원		
담당 (상근)	미등기	정창교	남	1972.02	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	정철우	남	1965.04	CIS개발 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	정해강	남	1979.12	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	정희삼	남	1978.02	CIS개발 담당임원	CIS Business 담당임원		
담당 (상근)	미등기	조명관	남	1966.05	Global QRA 담당임원	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	조민상	남	1968.09	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	조성봉	남	1976.11	대외협력 담당임원	대외협력		
담당 (상근)	미등기	조영만	남	1968.09	DRAM개발 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	조주현	남	1972.04	CIS개발 담당임원	CIS Business 담당임원		29개월
담당 (상근)	미등기	조주환	남	1968.01	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		

담당 (상근)	미등기	조호진	남	1968.11	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	조훈	남	1972.08	Solution개발 담당임원	Solution개발		51개월
담당 (상근)	미등기	주재욱	남	1971.10	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	지운혁	남	1976.08	Solution개발 담당임원	Solution개발		
담당 (상근)	미등기	진보권	남	1974.12	기업문화 담당임원	SK텔레콤		27개월
담당 (상근)	미등기	진성곤	남	1968.07	CEO직속 담당임원	제조/기술 담당임원		
담당 (상근)	미등기	진일섭	남	1971.05	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	차상엽	남	1967.02	미래전략 담당임원	안전개발제조 담당임원		54개월
담당 (상근)	미등기	차선용	남	1967.08	미래기술연구원 담당	DRAM개발 담당		
담당 (상근)	미등기	천영일	남	1966.10	미래기술연구원 담당임원	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최광문	남	1968.01	제조/기술 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최명섭	남	1972.07	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	최상훈	남	1972.02	기업문화 담당임원	SK하이텍		15개월
담당 (상근)	미등기	최소정	여	1982.04	Corporate Development 담 당임원	SK스퀘어		3개월
담당 (상근)	미등기	최영현	남	1971.06	CEO직속 담당임원	제조/기술 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최용수	남	1969.02	AI Infra 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최우성	남	1974.01	Corporate Development 담 당임원	SK텔레콤		3개월
담당 (상근)	미등기	최우진	남	1971.11	P&T 담당	P&T 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최재건	남	1973.11	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	최정달	남	1964.07	NAND개발 담당	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최정산	남	1967.01	Global QRA 담당	Global QRA 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최준	남	1968.07	Global성장추진 담당	CEO직속 담당임원		27개월
담당 (상근)	미등기	최준기	남	1968.02	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	최창언	남	1972.01	Solution개발 담당임원	NAND개발 담당임원		59개월

담당 (상근)	미등기	최홍석	남	1968.11	DT 담당임원	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	한상신	남	1971.07	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	한영수	남	1969.11	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	한은석	남	1973.06	Corporate Development 담 당	SK윌더스		8개월
담당 (상근)	미등기	허황	남	1973.01	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	현은아	여	1974.11	대외협력 담당임원	SK스퀘어		3개월
담당 (상근)	미등기	홍성관	남	1976.10	Solution개발 담당임원	Solution개발		
담당 (상근)	미등기	황종일	남	1974.05	CEO직속 담당임원	제조/기술		

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 회사에 5년 이상 계속하여 재직해온 경우에는 재직기간 기재를 생략함

(나) 미등기 임원의 변동

최근 보고일 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	출생년월	담당 업무	주요 경력	비고
퇴임	담당 (상근)	미등기	홍진희	남	1972.12	P&T 담당임원	P&T	의원면직

라. 직원 등 현황

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

마. 미등기임원 보수 현황

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금 내역

(기준일: 2024년 03월 31일)

(단위: USD 백만)

대상자의 이름	관계	종류	시작일	만기일	목적	대여 금액	기말 잔액	이자율
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	장기대여	2020-04-16	2024-10-15	운영자금	600	600	3M Sofr+0.75%
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	장기대여	2020-08-18	2025-02-17	운영자금	600	600	3M Sofr+0.75%
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	장기대여	2020-10-20	2025-04-19	운영자금	550	550	3M Sofr+0.75%
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	장기대여	2021-04-20	2025-10-19	운영자금	200	200	3M Sofr+0.75%
SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.	해외법인	장기대여	2022-01-19	2025-07-12	운영자금	1,000	1,000	3M Sofr+1.30%
SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.	해외법인	장기대여	2022-02-09	2025-07-12	운영자금	1,000	1,000	3M Sofr+1.30%
SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.	해외법인	장기대여	2022-02-15	2025-07-12	운영자금	1,000	1,000	3M Sofr+1.30%
SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.	해외법인	장기대여	2022-02-23	2025-07-12	운영자금	1,000	1,000	3M Sofr+1.30%
SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.	해외법인	장기대여	2022-03-03	2025-07-12	운영자금	229	229	3M Sofr+1.30%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	장기대여	2022-08-11	2025-08-11	운영자금	300	300	3M Sofr+0.45%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	단기대여	2023-02-15	2025-02-15	운영자금	300	300	3M Sofr+1.00%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	단기대여	2023-03-15	2025-02-15	운영자금	200	200	3M Sofr+1.00%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	장기대여	2023-05-31	2025-05-31	운영자금	400	400	3M Sofr+0.45%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	장기대여	2023-07-10	2025-05-31	운영자금	400	400	3M Sofr+0.45%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	장기대여	2023-09-14	2025-09-14	운영자금	350	350	3M Sofr+0.45%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	장기대여	2023-10-17	2025-09-14	운영자금	250	250	3M Sofr+0.45%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	장기대여	2023-11-14	2025-09-14	운영자금	200	200	3M Sofr+0.45%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	장기대여	2023-12-19	2025-09-14	운영자금	200	200	3M Sofr+0.45%

※ 회사의 대여에 대하여 종속기업이 회사에 제공한 담보는 없습니다.

※ 상법 제542조의9에 따라 건별 대여 금액이 직전 사업연도 매출액의 100분의 1을 초과하거나, 당사 이사회 내부 규정을 충족하는 경우 이사회 또는 감사위원회 의결을 통해 결정됩니다.

나. 채무보증 현황

이해관계자와의 채무보증 현황은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참고하시기를 바랍니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 자산양수도 내역

(기준일: 2024년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

거래 상대방	관계	거래 대상물	거래일자	거래금액	거래종류	목적	처분손익
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	기계장치류	2024년 01월	300	매각	생산효율화	300
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	기계장치류	2024년 02월	223	매각	생산효율화	223
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	기계장치류	2024년 03월	7,266	매각	생산효율화	1,837
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	기계장치류	2024년 03월	160	매각	생산효율화	89
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	해외법인	기계장치류	2024년 03월	2,628	매각	생산효율화	1,301
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	기계장치류	2024년 02월	13,978	매입	생산효율화	-
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	기계장치류	2024년 03월	6,697	매입	생산효율화	-

- ※ 본사 별도 기준입니다.
- ※ 법인간 매매금액 산정 기준 : 거래금액 + 부대비용
거래금액은 감정평가 및 시장가치를 고려하여 적절히 산정되었습니다.
- ※ 거래일자는 매각의 경우 매각일자, 매입의 경우 매입일자 기준입니다.

나. 출자 및 출자지분 처분 내역

(기준일: 2024년 03월 31일)
 (단위 : 백만원)

계약 상대방	관계	거래일자	출자 및 출자지분 처분 내역					비고
			출자지분의 종류	거래내역				
				기초	증가	감소	기말	
SK Americas, Inc.	관계기업	2024-03-28	보통주	-	13,340	-	13,340	신규 출자
SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.	해외법인	2024-03-29	출자증서	936		936	-	법인 청산(주1)

(주1) 거래일자는 법인 청산 결정일을 기준으로 하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래

(기준일: 2024년 03월 31일)
 (단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액
SK hynix America Inc.(해외판매법인)	매출 · 매입 등	2024.01.01~2024.03.31	반도체 매출 등	4,683,303
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(해외판매 법인)	매출 · 매입 등	2024.01.01~2024.03.31	반도체 매출 등	3,395,190

※ 최근 사업연도 매출총액(별도기준)의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래를 기준으로 하였습니다.

4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 · 변경사항

신고일자	보고서명	신고 내용	신고사항의 진행사항
2022.09.06	장래사업 · 경영계획 (공정공시)	1. 제목: 생산기반 확충을 위한 투자계획 2. 내용: 2022년 10월부터 청주 테크노폴리스 산업단지 내 기존 확보된 부지에 M15의 확장 팝인 M15X(eXtension)를 건설할 계획임. 향후 5년에 걸쳐 공장 건설 및 생산 설비 구축에 총 15조원 규모를 투자할 계획임. - 보고서 작성기준일 이후 당사는 2024년 4월 24일 이사회에서 보다 구체적인 투자금액 및 투자기간을 결정하였습니다. 자세한 내용은 "신규시설투자등(2024.04.24)"을 참고하시기를 바랍니다.	진행중

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

① 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 연결회사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

② 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 연결회사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

당사의 우발부채 등에 관한 보다 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' - '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석' 내 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기를 바랍니다.

나. 채무보증 현황

(1) 연결회사는 공동기업인 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.를 위하여 Wuxi Xinfa Group Co., Ltd. 에게 RMB 701백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.

회사는 종속기업인 SK hynix NAND Product Solutions Corp.에 임대차 보증을 위하여 USD 71백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후에 발생한 주요사항

(1) 2024년 4월 24일 이사회에서 자기주식 처분을 결의하였으며, 처분예정기간 중 총 2,731주의 자기주식을 처분하였습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내역
처분예정주식	보통주 2,731주
처분주식 총수	보통주 2,731주
1주당 처분가액	1주당 170,600원
처분예정기간	2024.04.25 ~ 2024.04.26
처분목적	대표이사 및 사외이사 보수 지급을 위한 자기주식 처분

※ 자세한 내용은 "자기주식처분결과보고서(2024.04.29)"를 참고하시기를 바랍니다.

상기 주요 사항을 반영하여, 제출일 현재 당사가 보유한 자기주식수는 총 39,384,720주입니다. 이는 2023년 4월 11일 당사가 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식 20,336,717주를 포함하여 산정되었습니다. 해당 교환대상 자기주식은 교환사채의 교환권 행사시점에 처분이 확정되며 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

(2) 2024년 4월 24일 이사회에서 생산시설 증설 투자를 결의하였습니다. 보다 자세한 내용은 "신규시설투자등(2024.04.24)" 공시를 참고하시기를 바랍니다.

(3) 2024년 4월 29일 이사회에서 우시산업발전집단 유한공사에 종속기업 SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.의 지분 21.33%를 USD 149,300,000에 양도하기로 결의하였으며, 이후 지분 양도 계약을 체결하였습니다.

나. 녹색경영 현황

당사는 '기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되어 2015년부터 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리/감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다

'온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제24조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2023년 온실가스 예상 배출량은 4,782,107톤 CO₂e (tCO₂e)입니다.

[온실가스 배출량 및 에너지 사용량]

당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다.

구분	2023년(제76기)	2022년(제75기)	2021년(제74기)
온실가스 배출량(tCO ₂ eq)	4,782,107	4,979,251	4,388,175
에너지 사용량(TJ)	94,552	98,028	87,063

※ 대상은 국내 사업장 기준이며, 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량입니다.

※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 합병 등의 사후 정보

- 해당사항 없음

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

2. 계열회사 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

3. 타법인출자 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음